

분 기 보 고 서

(제 70 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
 2017년 09월 30일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2017년 11월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인

면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 : 박 성 욱

본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
(전 화) 031-630-4114
(홈페이지) <http://www.skhynix.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 재무기획본부장 (성 명) 이 명 영
(전 화) 031-8093-4801~6

목 차

I . 회사의 개요

1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등

II . 사업의 내용

1. 사업의 개요
2. 주요 제품, 서비스 등
3. 주요 원재료에 관한 사항
4. 생산 및 설비에 관한 사항
5. 매출에 관한 사항
6. 수주상황
7. 시장위험과 위험관리
8. 파생상품 거래현황
9. 경영상의 주요계약 등
10. 연구개발활동
11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항

IV. 감사인의 감사의견 등

1. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등
2. 회계감사인의 감사의견 등

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 등에 관한 사항
2. 주식의 분포
3. 주식사무
4. 주가 및 주식 거래실적

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등

IX. 계열회사 등에 관한 사항

X. 이해관계자와의 거래내용

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행· 변경상황 및 주주총회 현황
2. 우발채무 등
3. 제재현황 등 그 밖의 사항
4. 녹색경영 현황
5. 합병 등의 사후 정보

[전문가의 확인]

1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 내용이 기재 또는 표시사항을 이용하는자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제2조의2 및 제2조3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2017. 11. 14

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 박 성

공시 책임자 이 명

박성욱
이명영

확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
에스케이하이이엔지(주)	2001.04	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091	사업지원	54,265	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
에스케이하이시스템(주)	2008.03	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091	사업지원	37,050	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
(주)실리콘화일	2002.11	경기도 성남시 분당구 성남대로 343번길9, SK U타워 16층	전자·전기부품 개발 및 제조	34,438	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
행복모이(주)	2016.10	충청북도 청주시 흥덕구 화계동 청주테크노폴리스 일반산업단지 에프6-2	사업지원	2,988	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix America Inc.(SK-HYA)	1983.03	3101 North First Street, San Jose, CA 95134, U.S.A	반도체판매	1,584,043	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix U.K Ltd.(SK-HYU)	1995.07	243 Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0RH, UK	반도체판매	146,327	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Deutschland GmbH (SK-HYD)	1989.03	Am Prime Parc 13, Kelsterbacher Str. 16, D-65479 Raunheim, Germany	반도체판매	83,388	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Asia Pte.Ltd. (SK-HYS)	1991.09	8 Temasek Boulevard #11-03, Suntec City Tower3, Singapore 038988	반도체판매	337,506	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Semiconductor India Private Limited(SK-HYS)	2006.11	Unit 10, Level 8, Innovator Building, ITPB (International Technology Park Bangalore), Whitefield Road, Bangalore 560066, India	반도체판매	866	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix Semiconductor HongKong Ltd.(SK-HYH)	1995.04	Suite 4401-02 & 11-12, 44/F, One Island East, 18 Westlands Road, Taikoo Place, Quarry Bay, Hong Kong	반도체판매	932,437	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Japan Inc.(SK-HYJ)	1996.09	23F SHIROYAMA TRUST TOWER, 4-3-1 Toranomon, Minatoku, Tokyo	반도체판매	251,274	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SK-HYT)	1996.07	Lite-On Technology Building 11F., No. 392, Ruiguang Road, Neihu Dist., Taipei City 11492 Taiwan, R.O.C	반도체판매	310,933	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.(SK-HYCS)	2001.08	19F, ARCH SHANGHAI Tower 2, No.533 Lou Shan Guan Road, Shanghai, 200051 China	반도체판매	46,177	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SK-HYCL)	2005.04	Lot K7, Wuxi High-tech Zone Comprehensive Bonded Zone in New District, Wuxi, Jiangsu Province, China(214028)	웨이퍼생산 및 판매	3,476,086	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원이상, 지배회사 자산총액의 10% 이상)
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SK-HYMC)	2006.04	Lot K7, Wuxi Export Processing Zone in Wuxi New District, Wuxi, Jiangsu Province, China	웨이퍼생산 및 판매	270,693	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd. (SK-HYOQL)	2013.09	Xiyong Comprehensive Bonded Zone B Block v2-4/02, Shapingba strict, Chongqing, China	웨이퍼생산 및 판매	350,305	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK APTECH Ltd. (SKAPTECH)	2013.09	Wanchai, Hong Kong	해외현지투자 지주회사	166,556	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당 (자산총액 750억원 이상)
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.(SK-HYCW)	2010.08	Lot K7, Wuxi Export Processing Zone in Wuxi New District, Wuxi, Jiangsu Province, China	반도체판매	633	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix Italy S.r.l. (SK-HYT)	2012.05	V.le Colleoni, 15 20864 Agrate Brianza (MB)	기술센타	3,232	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix memory solutions Inc. (SK-HMS)	2012.08	3103 North First Street, San Jose, CA 95134, U.S.A	기술센타	72,346	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix Flash Solution Taiwan Ltd. (SK-HYST)	2013.08	6F-1. Mo. 6. Taiyuen 1st(Taiyuen Hi-tech Industrial Park) Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan	기술센타	8,644	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
Softeq Flash Solutions LLC. (SOFTEQ)	2014.06	Kalvaryiskaya, 42 Fifth Floor Minsk, Belarus, 220073	기술센타	4,888	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
SK hynix Ventures Hong Kong Limited (SKH Ventures)	2016.03	Suite 4401-02 & 11-12, 44/F, One Island East, 18 Westlands Road, Taikoo Place, Quarry Bay, Hong Kong	해외투자법인	2,441	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
MMT 특정금전신탁	-	-	특정금전신탁	0	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)	2017.05	충청북도 청주시 흥덕구 대신로 215	반도체소재제조	-	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당사항 없음

※ 주요 종속회사 판단기준: 직전 사업연도말 자산총액 750억원 이상 또는 지배회사 자산총액의 10% 이상

※ 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)의 경우 올해 신설된 회사로 최근 사업연도말 자산총액은 '-'로 표기함

[연결대상회사의 변동현황]

사업 연도	연결에 포함된 종속회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사	전기대비 연결에서 제외된 사유
제70기 3분기	에스케이하이닉스(주) 등 24개사	-	-	-

사업 연도	연결에 포함된 종속회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사	전기대비 연결에서 제외된 사유
제70기 2분기	에스케이하이이엔지(주) 등 24개사	에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)	-	-
제70기 1분기	에스케이하이이엔지(주) 등 23개사	-	-	-
제69기	에스케이하이이엔지(주) 등 23개사	SK hynix Ventures Hong Kong Limited (SKH Ventures) 행복모아(주)	Hynix Semiconductor Manufacturing America Inc. (HSMA)	청산
제68기	에스케이하이이엔지(주) 등 22개사	-	-	-
제67기	에스케이하이이엔지(주) 등 22개사	(주)실리콘화일 Softeq Flash Solutions LLC.(SOFTEQ)	SK hynix Europe Holding Ltd.(SK-ME)	청산

※ 연결대상회사의 변동현황은 한국채택국제회계기준임.

※ MMT 특정금전신탁은 연결에 포함된 회사수에서 제외하였음.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규 연결	-	-
	-	-
연결 제외	-	-
	-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭

당사의 명칭은 에스케이하이닉스 주식회사이며, 영문으로는 SK hynix Inc.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 SK하이닉스 또는 SK hynix 라고 표기합니다.

다. 설립일자

당사는 1949년 10월 국도건설 주식회사로 설립되어 1983년 2월 현대전자산업주식회사로 상호를 변경하였으며, 이후 2001년 3월 주식회사 하이닉스반도체로, 2012년 3월 에스케이하이닉스 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 회사가 발행한 주식은 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 거래되고 있으며, 종목코드는 '000660'입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소: 경기도 이천시 경충대로 2091

전화번호: 031-630-4114

홈페이지: <http://www.skhynix.com>

마. 주요 사업의 내용

현재 당사의 주력 생산제품은 DRAM, NAND Flash 및 MCP(Multi-chip Package)와 같은 메모리 반도체 제품이며, 2007년부터는 시스템 LSI 분야인 CIS(CMOS Image Sensor) 사업에 재진출하여 종합반도체 회사로 그 영역을 넓혀가고 있습니다.

당사 정관에 근거하여 현재 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

- 반도체소자 제조 및 판매
- 반도체소자 기타 이와 유사한 부품을 사용하여 전자운동의 특성을 응용하는 기계, 기구 및 이에 사용되는 부품과 재료 등의 제작, 조립 및 판매
- 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업
- 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업
- 기계부분품 제조업 및 금형제조업
- 기술연구 및 용역수탁업
- 전자 전기기계, 기구의 임대업
- 특수통신(위성통신 등) 방송관련 기기 제작, 판매, 임대업 및 서비스업
- 정보서비스업
- 출판업
- 무역업
- 부동산 매매 및 임대업
- 발전업
- 건설업
- 전자관 제조업
- 창고업
- 주차장업
- 위성통신사업
- 전기통신회선설비 임대사업
- 전자상거래 및 인터넷 관련사업
- 전기 각호와 관련되는 사업 및 투자

사업부문별 보다 자세한 사항은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

- (1) 기업집단의 명칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)
- (2) 기업집단에 소속된 회사 (2017. 09. 30 기준 계열사 : 101개사)

업종	상장 여부	회사명	법인등록번호
지주회사 (1)	상장사 (1)	SK주)	110111-0769583
에너지/화학 (40)	상장사 (6)	SK이노베이션주)	110111-3710385
		SKQ주)	130111-0001585
		주)부산도시가스	180111-0039495
		SK에미칼주)	130111-0005727
		SK가스주)	110111-0413247
		SK머티리얼즈주)	190111-0006971
	비상장사 (34)	SK E&S주)	110111-1632979
		SK에너지주)	110111-4505967
		SK종합화학주)	110111-4505975
		SK루브리컨츠주)	110111-4191815
		SK인천석유화학주)	120111-0666464
		SK트레이딩인터내셔널주)	110111-5171064
		주)대한송유관공사	110111-0671522
		SK모바일에너지주)	161511-0076070
		SK배터리시스템즈주)	160111-0337801
		울산아로마틱스주)	110111-4499954
		한국벡슬렌(유)	230114-0003328
		유베이스매뉴팩처링아시아주)	230111-0168673
		코원에너지서비스주)	110111-0235617
		충청에너지서비스주)	150111-0006200
		영남에너지서비스주)	175311-0001570
		전북에너지서비스주)	214911-0004699
		위례에너지서비스주)	110111-4926006
		나래에너지서비스주)	135711-0092181
		전남도시가스주)	201311-0000503
		강원도시가스주)	140111-0002010
		파주에너지서비스주)	110111-4629501
		보령LNG터미널주)	164511-0021527
		SK더블유주)	154311-0026200
		미쓰이케미칼앤드에스케이씨폴리우레탄주)	230111-0233880
		금호미쓰이화학주)	110111-0612980
		엔티스주)	130111-0021658
		이니츠주)	230111-0212074
		SK유화주)	135811-0120906
		SK어드밴스드주)	230111-0227982

업종	상장 여부	회사명	법인등록번호
		당진에코파워(주)	165011-0035072
		SK에어가스(주)	230111-0134111
		SK트리켄(주)	164711-0060753
		SK쇼와덴코(주)	175611-0018553
		SKC하이테크앤마케팅(유)	161514-0001344
정보통신/전기전자 (21)	상장사 (4)	SK텔레콤(주)	110111-0371346
		SK하이닉스(주)	134411-0001387
		(주)아이리버	110111-1637383
		SKC솔믹스(주)	134711-0014631
	비상장사 (17)	SK텔링크(주)	110111-1533599
		SK플래닛(주)	110111-4699794
		SK브로드밴드(주)	110111-1466659
		SK커뮤니케이션즈(주)	110111-1322885
		피에스앤마케팅(주)	110111-4072338
		네트웍오앤에스(주)	110111-4370708
		엔트릭스(주)	110111-5770105
		원스토어(주)	131111-0439131
		SK테크엑스(주)	110111-5990547
		휴먼서비스(주)	110111-6420460
		(주)실리콘화일	110111-2645517
		SK하이닉스시스템IQ(주)	150111-0235586
		SK텔레시스(주)	110111-1405897
		SKC인프라서비스(주)	134111-0414065
		SK매직(주)	110111-5125962
		SK인포섹(주)	110111-2007858
		(주)에이앤티에스	110111-3066861
	상장사 (3)	SK네트웍스(주)	130111-0005199
		SK디앤디(주)	110111-3001685
		(주)에스엠코어	110111-0128680
		SK건설(주)	110111-0038805
		SK마리타임(주)	110111-0311392
		내트럭(주)	110111-3222570
		서비스탑(주)	160111-0281090
		서비스에이스(주)	110111-4368688
		(주)엔에스오케이	110111-3913187
		에프앤유신용정보(주)	135311-0003300

업종	상장 여부	회사명	법인등록번호
건설/물류/서비스 (31)	비상장사 (28)	SK엠앤서비스(주)	110111-1873432
		(주)헬로네이처	110111-4867898
		SK하이신택(주)	134411-0037746
		SK하이이엔지(주)	134411-0017540
		행복모아(주)	150111-0226204
		SK네트웍스서비스(주)	135811-0141788
		카라이프서비스(주)	160111-0306525
		SK핀크스(주)	224111-0003760
		목감휴게소서비스(주)	110111-6257954
		SK매직서비스(주)	134811-0039752
		대전맑은물(주)	110111-4273960
		SK티엔에스(주)	110111-5833250
		SK해운(주)	110111-6364212
		SK신택(주)	131411-0232597
		지허브(주)	230111-0205996
		비앤엠개발(주)	110111-5848712
		행복나래(주)	110111-2016940
		SK임업(주)	134811-0174045
		SK엔카닷컴(주)	110111-5384146
		에프에스케이엘앤에스(주)	131111-0462520
		(주)포인트코드	110111-1888548
금융 (1)	상장사 (1)	SK증권(주)	110111-0037112
기타 (7)	상장사 (2)	(주)나노엔텍	110111-0550502
		SK바이오랜드(주)	110111-1192981
	비상장사 (5)	제주유나이티드FC(주)	224111-0015012
		SK와이번스(주)	120111-0217366
		SK플라즈마(주)	131111-0401875
		SK바이오팜(주)	110111-4570720
		SK바이오텍(주)	160111-0395453

(*) 사명 변경 : SK(주) (舊 SK C&C(주)), 엔티스(주) (舊 SK사이텍(주)), SK인포섹(주) (舊 인포섹(주)),

SK배터리시스템즈(주) (舊 SK컨티넨탈이모션코리아(주)), 카라이프서비스(주) (舊 스피드모터스(주)),

나래에너지서비스(주) (舊 하남에너지서비스(주)), 비앤엠개발(주) (舊 엠케이에스개런티(유)),

미쓰이케미칼앤에스케이씨폴리우레탄(주) (舊 에스엠피씨(주)),

SK에어가스(주) (舊 SKC에어가스(주)), SK바이오랜드(주) (舊 (주)바이오랜드),

파주에너지서비스(주) (舊 피엠피(주)), SK엠앤서비스(주) (舊 엠앤서비스(주))

SK매직서비스(주) (舊 매직서비스(주)), SK마리타임(주) (舊 SK해운(주)),

사. 신용평가에 관한 사항

본 보고서 제출일 현재 당사의 신용등급은 아래와 같습니다.

구분	평가기관	현등급	최종평가일
국내	NICE신용평가	AA-	2017.06.30
	한국기업평가	AA-	2017.11.09
	한국신용평가	AA-	2017.11.07
해 외	Moody's	Baa3	2017.11.06
	S&P	BBB-	2017.01.20

2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 중요한 변동상황

(1) 회사의 주된 변동내용

1949. 10	국도건설 주식회사 설립
1983. 02	현대전자산업주식회사로 상호 변경
1996. 12	기업공개 및 상장
1997. 03	대표이사 김영환 외 이사 5인 변경 선임 이사 5인, 감사 1인 변경 선임
1999. 05	LG그룹과 LG반도체 주식 양수도 계약 체결
1999. 07	LG반도체 대주주 지분 인수
1999. 10	현대반도체(주)(구, (주)LG반도체) 흡수합병
2000. 03	박종섭 대표이사 외 이사 1인, 감사위원 2인 변경 선임
2000. 05	전장사업부문 (주)현대오토넷으로 분사
2000. 08	모니터사업부문 "현대이미지퀘스트(주)"로 분사
2001. 03	주식회사 하이닉스반도체로 상호 변경 박상호 대표이사 선임 외 이사 2인, 감사위원 2인 변경 선임
2001. 05	통신단말기 사업부문 "현대큐리텔"로 분사 통신 ADSL 사업부문 "현대네트웍스"로 분사
2001. 07	통신 네트워크 사업부문 "현대시스콤"으로 분사

2001. 08 현대그룹으로부터 계열분리
 2001. 10 채권금융기관 공동관리 시작
 2001. 12 현대큐리텔, '팬택 컨소시엄'에 지분 매각
 2002. 01 현대시스콤, '쓰리알'에 지분 매각
 2002. 05 시러스 로직社와 파운드리 전략적 장기공급 계약체결
 박종섭 대표이사 사임
 2002. 06 최대주주 변경(현대상선(주) → (주)한국외환은행)
 2002. 07 우의제 대표이사 선임 외 이사 2인, 감사위원 2인 변경 선임
 2002. 12 현대네트웍스, '엠비엔'에 지분 매각
 2003. 02 박상호 대표이사 사임
 2003. 04 STMicro社와 낸드플래시 메모리 공동 개발 및 파운드리 공급 계약 체결
 2003. 06 환경/안전/보건 기술연구소 설립
 2004. 06 매그나칩반도체 유한회사와 비메모리 사업부문 영업양도계약 체결
 2004. 08 중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시와 중국 현지공장설립 협력계약 체결
 2004. 10 비메모리 사업부문 영업양도
 2004. 11 STMicro社와 중국 현지 합작공장설립을 위한 협력계약 체결
 2005. 03 황학중, 김덕수, 민형욱, 이준호 사외이사 선임
 박시룡, 장윤중 사외이사 임기만료 퇴임
 2005. 07 채권금융기관 공동관리 조기종료
 현대이미지케스트(주), (주)빅터스캐피탈코리아에 지분 매각
 2005. 10 (주)현대오토넷 지분매각 완료
 출자전환주식 공동관리협의회 1차 공동 지분매각(해외유통GDR발행 및 국내 블록세일)
 2006. 03 권오철 이사, 손방길 사외이사 선임, 정형량 이사 임기만료 퇴임
 2006. 04 중국 현지생산법인(HSMC) 설립
 2006. 06 출자전환주식 공동관리협의회 2차 공동 지분매각(해외유통GDR발행 및 국내 블록세일)
 2006. 09 300mm 연구소(R3 R&D Fab) 개소
 2007. 03 김종갑 대표이사 외 이사 1인 신규 선임, 사외이사 8인(감사위원회 위원 4인 포함) 선임
 -. 이사 선임: 김종갑, 최진석
 -. 사외이사 선임: 박종선, 김경한, 조동성, 김형준
 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 황학중, 민형욱, 손방길, 손성호
 우의제 대표이사 임기만료 퇴임
 이사 1인(오춘식), 사외이사 4인(김범만, 김수창, 이선, 이준호) 임기만료 퇴임
 2007. 04 청주 신규 M11(300mm) 공장 착공
 2007. 07 공정거래 자율준수프로그램 도입
 2007. 10 환경운동연합과 '환경경영검증위원회' 협약 체결
 2007. 11 '일하는 이사회'를 위한 신(新)이사회 제도 도입
 2008. 02 김경한 사외이사 중도 퇴임

2008. 03 사외이사 8인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
 -. 사외이사 선임: 박종선, 조동성, 김형준, 정홍원, 최장봉
 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 손성호, 홍형표, 백경훈
 사외이사 3인(황학중, 민형욱, 손방길) 임기만료 퇴임

2008. 06 정홍원 사외이사 중도 퇴임

2009. 03 권오철 이사 재선임 외 이사 1인 신규 선임, 사외이사 8인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
 -. 이사 선임: 권오철, 박성욱
 -. 사외이사 선임: 박종선, 조동성, 김형준, 최장봉, 한부환
 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 손성호, 홍형표, 백경훈

2009. 11 중국 후공정 합작사 HITECH 설립

2010. 03 최대주주 변경((주)한국외환은행 → 한국정책금융공사)
 최대주주 변경(한국정책금융공사 → 미래에셋자산운용투자자문(주))
 권오철 대표이사외 이사 1인 신규 선임, 김종갑 이사 재선임
 사외이사 9인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
 -. 이사 선임: 김종갑, 권오철, 김민철
 -. 사외이사 선임: 박종선, 전인백, 한부환, 최장봉, 정병태, 김형준
 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 백갑중, 송재용, 김창호

2010. 06 중국 후공정 합작공장 HITECH 준공

2010. 08 최대주주 변경(미래에셋자산운용투자자문(주) → 한국정책금융공사)

2010. 10 최대주주 변경(한국정책금융공사 → 국민연금공단)

2011. 03 사외이사 9인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
 -. 사외이사 선임: 한부환, 전인백, 정병태, 이달곤, 김갑희, 정상환
 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 백갑중, 송재용, 조현명

2011. 09 정상환 사외이사 중도 퇴임

2012. 02 최대주주 변경(국민연금공단 → 에스케이텔레콤(주))
 사외이사 5인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
 -. 이사 선임: 최태원, 하성민, 박성욱
 -. 사외이사 선임: 김두경, 박영준, 윤세리, 김대일, 이창양
 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 김두경, 김대일, 이창양

2012. 06 미 컨트롤러 업체 LAMD(Link_A_Media Devices) 인수 본계약 체결

2012. 09 플래시 솔루션 디자인 센터 설립

2013. 03 김준호 사내이사 1인 신규 선임

2014. 03 이사 2인(감사위원회 위원 1인 포함) 선임
 -. 이사 선임: 임형규
 -. 사외이사 선임: 최종원
 -. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 최종원

2014. 09 중국 충칭 후공정 생산법인 (SK-HYQQL) 준공

2015. 03 이사 5인(감사위원회 위원 3인 포함) 선임
 -. 이사 선임: 박성욱
 -. 사외이사 선임: 김두경, 박영준, 김대일, 이창양

	- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 김두경, 김대일, 이창양
2016.03	이사 2인(사내이사) 선임 - 이사 선임: 김준호, 박정호
2017.03	이사 4인(감사위원회 위원 2인 포함) 선임 - 이사 선임: 이석희 - 기타비상무이사 선임: 박정호 - 사외이사 선임 : 최종원, 신창환 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임: 최종원, 신창환
2017.07	에스케이하이닉스 시스템아이씨(주) 공식 출범

(2) 종속회사의 주된 변동내용

1983. 03	미국 현지법인(HSA) 설립
1989. 03	독일 현지법인(HSD) 설립
1991. 08	싱가폴 현지법인(HSS) 설립
1995. 04	홍콩 현지법인(HSH) 설립
1995. 07	영국 현지법인(HSE) 설립 영국 현지판매법인(HSU) 설립
1995. 08	미국 생산법인(HSMA) 설립
1996. 07	대만 현지법인(HST) 설립
1996. 09	일본 현지법인(HSJ) 설립
2001. 05	사업지원 서비스부문 "(주)현대아스텍" 분사
2001. 07	LCD 사업부문 "(주)현대디스플레이테크놀로지"로 분사
2001. 08	중국 현지판매법인(HSCS) 설립
2001. 12	"에스알씨(주)" 분사
2002. 11	"(주)현대디스플레이테크놀로지" TFT-LCD 사업부문 매각
2005. 04	중국 합작법인(HSSL) 설립 에스알씨(주)→(주)큐알티반도체 사명 변경 (주)현대아스텍→(주)아스텍 사명 변경
2006. 04	중국 현지생산법인(HSMC) 설립
2006. 10	중국 현지생산법인(HSMC) 준공
2007. 01	인도 현지법인(HSIS) 설립
2008. 03	(주)아스텍에서 (주)하이닉스인재개발원 분할 (주)아스텍에서 (주)하이닉스로 분할 (주)아스텍에서 (주)하이로지텍으로 분할 (주)아스텍에서 (주)하이닉스엔지니어링으로 분할
2010. 01	(주)하이닉스엔지니어링에서 (주)아미파워로 분할
2010. 08	중국 현지판매법인(HSCW) 설립

2011. 09	"(주)현대디스플레이테크놀로지" 청산, 주요종속회사 제외 "프로모스엔에이치유한회사, 티와이프로주식회사, 외환은행특정금전신탁" 청산, 주요종속회사 제외
2012. 06	낸드플래시 개발업체 아이디어플래시(Ideafash S.r.l.) 인수, 이탈리아 기술센터(SK Hynix Italy S.r.l.) 전환 설립
2012. 10	(주)하이닉스엔지니어링, (주)큐알티반도체 흡수합병 (주)하이스텍, (주)하이로지텍/(주)하이닉스인재개발원 흡수합병
2012. 10	(주)하이닉스엔지니어링→에스케이하이이엔지(주) 사명 변경 (주)하이스텍→에스케이하이스텍(주) 사명 변경
2013. 09	아미파워(주) 청산, 주요종속회사 제외 중국 충칭 후공정 생산법인 (SK-HYQCL) 설립
2014. 04	에스케이하이이엔지(주) 에서 큐알티(주) 분할 설립 주식교환으로 실리콘화일(주) 인수
2014. 06	벨라루스 소재 연구개발법인 Softeq Flash Solutions LLC. 인수
2014. 07	SK hynix Europe Holding Ltd.(SK-HYE) 청산, 종속기업 제외
2014. 09	큐알티(주) 지분 전량 매각
2016. 03	SK hynix Ventures Hong Kong Ltd. 설립 Hynix Semiconductor Manufacturing America Inc. (HSMA) 청산, 종속기업 제외
2016. 10	행복모아(주) 설립
2017. 05	에스케이하이닉스 시스템아이씨(주) 설립

나. 상호의 변경

1983. 02	현대전자산업주식회사로 상호 변경
2001. 03	주식회사 하이닉스반도체로 상호 변경
2012. 03	에스케이하이닉스 주식회사로 상호 변경

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환·이전, 중요한 영업의 양수·양도 등

1999. 10	현대반도체주(구, (주)LG반도체) 흡수합병
2004. 10	비메모리 사업부문 영업양도
2011. 11	에스케이텔레콤, 하이닉스반도체 지분인수계약
2014. 01	(주)실리콘화일과 포괄적 주식교환계약
2016. 10	(주)실리콘화일과 CIS영업부문에 대한 영업양수
2017. 07	에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)에 Foundry사업과 관련된 자산 등 포괄적 양도

라. 생산설비의 변동

2006. 10	중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시에 C2(300mm), C1(200mm)공장 준공
2008. 07	미국 유진 공장 E1(200mm) 가동 중단
2008. 08	청주 신규 NAND Flash 전용 M11공장(300mm) 준공
2008. 09	이천 M7(200mm) 및 청주 M9(200mm) 공장 가동 중단
2008. 12	중국 C1(200mm) 공장 가동 중단
2010. 06	중국 후공정 합작공장 HITECH 준공
2012. 06	청주 신규 NAND Flash 전용 M12공장(300mm) 준공
2014. 09	중국 후공정 생산법인 (SK-HYQQL) 준공
2015. 08	이천 M14(300mm) 준공

마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

2005. 01	전력 소모 30% 줄인 서버용 메모리 모듈 개발
2005. 01	대만 프로모스社와 전략적 제휴를 위한 본계약 체결
2005. 07	2GB DDR2-667 노트북용 모듈 업계 최초 인텔社 인증 획득
2005. 07	당사 출자전환 주식 공동관리 협의회와 '특별 약정' 체결
2005. 11	JEDEC 표준형 8GB DDR2 R-DIMM과 2GB DDR VLP R-DIMM 개발
2005. 12	512Mb GDDR4 DRAM 개발
2006. 03	80나노 512Mb DDR2 DRAM 인텔社 인증 획득
2006. 12	200Mbps 512Mb 모바일 DRAM 개발
	60나노급 1Gb DDR2 기반 1GB DDR2 800Mbps 모듈 개발
2007. 03	ECC회로 적용한 185Mbps 512Mb 모바일 DRAM 개발
2007. 04	퓨전메모리 제품 DOC(Disk On Chip) H3 양산
2007. 05	80나노 DDR3 1Gb DRAM 단품 및 모듈 인텔社 인증 획득
	초박형(25 μ m) 20단 낸드플래시 MCP(Multi-chip Package) 개발
2007. 08	200Mbps 1Gb 모바일 DRAM 개발
	이노베이티브 실리콘社와 신개념 메모리 'ZRAM' 라이선스계약 체결
2007. 09	초박형(25 μ m) 24단 낸드플래시 MCP(Multi-chip Package) 개발
2007. 10	오보닉스社와 차세대 메모리 'PRAM' 기술 라이선스 계약 체결
2007. 11	1Gb GDDR5 개발
	50나노급 1Gb DDR2 DRAM 인텔社 인증 획득
	실리콘화일社와 CMOS 이미지 센서(CIS) 사업 추진을 위한 협력 계약 체결
2008. 01	50나노급 1GB/2GB DDR2 모듈 인텔社 인증 획득

2008. 03 피델릭스社와 전략적 제휴를 위한 협력계약 체결

2008. 04 그란디스社와 'STT-RAM' 라이선스 및 공동개발계약 체결

2008. 05 프로모스社와 포괄적 제휴 협력 계약 체결

2008. 06 파이슨社와 낸드플래시 응용제품 기술에 대한 사업협력계약 체결
실리콘화일社 지분취득 결정 및 기존 파운드리 계약범위 확대
3중셀(X3) 기술 기반 32Gb 낸드플래시 개발

2008. 07 씨엔에스테크놀로지社와 시스템반도체 공동개발 및 파운드리 협력계약 체결

2008. 08 뉴모닉스社와 낸드플래시 기술 및 제품 공동 개발 협력계약 체결
16GB 서버용 모듈 개발

2008. 12 8단 적층 낸드플래시 개발
50나노급 2Gb 고용량 모바일 DRAM 개발

2009. 01 DDR3 서버용 모듈 4GB ECC UDIMM 인텔社 인증 획득

2009. 02 40나노급 DDR3 DRAM 개발

2009. 05 뉴모닉스社 및 파이슨社와 낸드플래시 응용제품용 컨트롤러 3자 공동개발 계약 체결
중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)시에 무석산업발전집단유한공사와 합작 반도체 후 공정 전문회사 설립을 위한 본계약 체결

2009. 06 4GB 1333Mbps 노트북용 모듈 외 10건 인텔社 DDR3 전용 플랫폼 인증획득

2009. 07 대만 프로모스社와 전략적 제휴 협력계약 종결

2009. 08 50나노급 4Gb 모바일 DRAM 인텔社 인증 획득

2009. 10 2세대 1Gb DDR3 개발

2009. 12 40나노급 2Gb GDDR5 개발

2010. 01 40나노급 2Gb 모바일 DRAM 개발

2010. 02 20나노급 64Gb 낸드플래시 개발

2010. 09 휴렛팩커드(HP)社와 Re램 공동개발 계약 체결

2010. 12 30나노급 4Gb DDR3 개발

2011. 03 30나노급 2Gb DDR4 개발

2011. 07 도시바社와 STT-MRAM 공동개발 및 합작사 설립을 위한 공동생산 계약 체결

2012. 03 30나노급 2Gb DDR3 저탄소제품 인증 획득

2012. 04 스펀션社와 특허사용 크로스라이선스 및 SLC낸드플래시 공급계약 체결

2012. 06 IBM社와 PC램 공동개발 및 기술 라이선스 계약 체결

2012. 08 20나노급 64Gb 낸드플래시 저탄소제품 인증 획득

2012. 09 20나노급 4Gb 그래픽 DDR3 개발

2013. 06	20나노급 8Gb LPDDR3 개발 램버스社와 포괄적 특허 라이선스 계약 체결
2013.07	삼성전자와 반도체 특허 크로스라이선스 계약 체결
2013.10	20나노급 6Gb LPDDR3 개발
2013.12	20나노급 8Gb LPDDR4 개발
2014.04	20나노급 8Gb DDR4기반 128GB 모듈 개발
2014.05	20나노급 모바일 DRAM 저탄소 제품 인증 획득
2014.09	차세대 와이드 IO2 모바일 DRAM 개발
2014.10	최대용량 비휘발성 하이브리드 DRAM 모듈 개발
2015. 02	도시바와 NIL 기술 공동 개발 계약 체결
2015. 02	사업연속성경영시스템(ISO22301) 인증 획득
2015. 08	샌디스크와 특허 라이선스 연장 및 공급 계약 체결
2017. 01	16Gb 기반 8GB LPDDR4X 출시
2017. 04	72단 256Gb TLC 3D 낸드플래시 개발
2017. 04	20나노급 8Gb 기반 GDDR6 DRAM 개발
2017. 07	20나노급 8Gb HBM2 Gen 1 개발
2017. 09	도시바 반도체 사업 지분 인수를 위한 타법인 지분 출자 결의

3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일)

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		주식의 종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	
2012년 01월 27일	전환권행사	보통주	855	5,000	23,328	2012.01.27~2012.02.13
2012년 02월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	101,850,000	5,000	23,000	
2012년 02월 15일	전환권행사	보통주	4,159	5,000	23,328	2012.02.15~2012.02.23
2012년 04월 06일	전환권행사	보통주	3,000	5,000	23,328	
2012년 05월 02일	주식매수선택권행사	보통주	93,500	5,000	22,800	우리사주매수선택권행사
2012년 05월 04일	전환권행사	보통주	428	5,000	23,328	
2012년 08월 20일	전환권행사	보통주	21	5,000	23,328	
2012년 10월 30일	주식매수선택권행사	보통주	30,300	5,000	22,800	우리사주매수선택권행사

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		주식의 종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
2012년 12월 07일	전환권행사	보통주	3,016	5,000	23,328	2012.12.07~2012.12.18
2013년 02월 13일	전환권행사	보통주	9,527	5,000	23,328	2013.02.13~2013.03.28
2013년 04월 01일	전환권행사	보통주	551,689	5,000	23,328	2013.04.01~2013.06.27
2013년 07월 02일	전환권행사	보통주	15,483,908	5,000	23,328	2013.07.02~2013.08.05
2014년 04월 22일	-	보통주	1,358,537	5,000	-	주식교환
2014년 05월 27일	전환권행사	보통주	4,562,354	5,000	34,394	2014.05.27~2014.06.26
2014년 07월 01일	전환권행사	보통주	10,285,078	5,000	34,394	2014.07.01~2014.09.29
2014년 10월 01일	전환권행사	보통주	1,595,505	5,000	34,394	2014.10.01~2014.10.06

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

2017년 9월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 9,000,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 5,721,980,209주입니다. 보통주 이외에 발행한 다른 종류의 주식은 없습니다. 당기말 현재의 유통주식수는 보통주 706,001,795주입니다.

(기준일: 2017년 09월 30일)

(단위: 주)

구 분		주식의 종류			비고
		보통주	우선주	합계	
I. 발행할 주식의 총수		9,000,000,000	-	9,000,000,000	-
II. 현재까지 발행한 주식의 총수		5,721,980,209	-	5,721,980,209	-
III. 현재까지 감소한 주식의 총수		4,993,977,844	-	4,993,977,844	-
	1. 감자	4,990,449,799	-	4,990,449,799	2003.03.31, 주식병합(21:1)
	2. 이익소각	3,528,045	-	3,528,045	2000.03.31, 이익소각
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	-	-	-
IV. 발행주식의 총수 (II-III)		728,002,365	-	728,002,365	-
V. 자기주식수		22,000,570	-	22,000,570	2014.04.22 주식교환 및 2015.07.23~10.01 장내취득
VI. 유통주식수 (IV-V)		706,001,795	-	706,001,795	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일: 2017년 09월 30일)

(단위: 주)

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)		
배당 가능 이익 범위 이내 취득	직접 취득	장내 직접 취득	보통주	22,000,000	-	-	-	22,000,000	-
			우선주	-	-	-	-	-	
		장외 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	
		공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	
		소계(a)	보통주	22,000,000	-	-	-	22,000,000	-
			우선주	-	-	-	-	-	
	신탁 계약에 의한 취득	수탁자 보유수량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	
		현물보유수량	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	
		소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-
			우선주	-	-	-	-	-	
기타 취득(c)			보통주	570	-	-	570	주식교환	
			우선주	-	-	-	-	-	
총 계(a+b+c)			보통주	22,000,570	-	-	22,000,570	-	
			우선주	-	-	-	-	-	

5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	728,002,365	-
	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	22,000,570	-
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배 제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
	우선주	-	-
	보통주	-	-

구 분	주식의 종류	주식수	비고
의결권이 부활된 주식수(E)	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	706,001,795	-
	우선주	-	-

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

정관에 의거한 배당에 관한 당사의 중요한 정책은 다음과 같습니다.

(1) 제52조(이익배당)

- ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
- ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
- ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 배당 할 수 있다.

(2) 제54조(중간배당)

- ① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
- ② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.
- ③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사를 포함한다) 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
- ④ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
- ⑤ 제53조(배당금 지급청구권의 소멸시효)는 중간배당의 경우에 준용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제70기 3분기	제69기	제68기
주당액면가액(원)		5,000	5,000	5,000
(연결)당기순이익(백만원)		7,422,719	2,953,774	4,322,356

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제70기 3분기	제69기	제68기
(별도)당기순이익(백만원)		7,248,436	2,655,022	4,019,080
(연결)주당순이익(원)		10,511	4,184	6,002
현금배당금총액(백만원)		-	423,601	353,001
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	14.3	8.2
현금배당수익률(%)	-	-	1.3	1.6
	-	-	-	-
주식배당수익률(%)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주당 현금배당금(원)	-	-	600	500
	-	-	-	-
주당 주식배당(주)	-	-	-	-
	-	-	-	-

※ 상기 금액은 연결 재무제표 기준이며, 연결 당기순이익 및 연결 현금배당성향은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익을 사용함.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위 합니다. 시장 조사 기관인 가트너(Gartner, 2017년 9월, 금액기준)에 따르면, 지난 2016년도 세계 반도체 시장규모는 US\$3,435억에 이르렀으며, 이 중 메모리 제품은 US\$801억의 시장규모로 전체 반도체 시장의 약 23% 수준에 달하였습니다. 메모리 제품 중 DRAM은 전체 메모리 반도체 시장의 51%를 차지하는 US\$410억을 기록하였으며, 그 뒤를 이어 낸드플래시가 US\$354억으로 44%, 기타 메모리가 US\$37억으로 5%의 비중을 차지하였습니다.

아래 표에 나타난 바와 같이 반도체 산업은 우리 나라 수출에 있어서 12.6%의 비중을 차지하는 매우 중요한 기간 산업 중 하나입니다. 2016년 반도체 수출은 DRAM 시장 가격 하락 등으로 인해 전년 대비 -1.1% 성장하였습니다.

※ 전체 수출 중 반도체 비중

(단위: 백만USD, %)

구분	2016	2015	2014	2013	2012	2011
총수출	495,426	526,757	572,665	559,632	547,870	555,214
반도체	62,228	62,916	62,647	57,143	50,430	50,146
전년비 증감율	-1.1%	0.4%	9.6%	13.3%	0.6%	-1.1%
비중	12.6%	11.9%	10.9%	10.2%	9.2%	9%

출처 : 한국무역협회, 2017년 9월

이러한 반도체는 메모리 반도체와 비메모리 반도체로 구분됩니다.

가) 메모리 반도체

정보를 저장하고 기억하는 기능을 하는 메모리 반도체는 일반적으로 '휘발성(Volatile)' 과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 휴대전화에 전화번호가 저장되는 것처럼 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 플래시메모리를 생산하고 있습니다.

메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자 효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우 중요한 산업으로서 기술력 및 원가 경쟁력을 갖춘 소수의 IDM(Integrated Device Manufacturer) 업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세입니다.

[DRAM(Dynamic Random Access Memory)]

DRAM은 전원이 켜져 있는 동안에만 정보가 저장되는 휘발성(Volatile) 메모리로 주로 컴퓨터의 메인 메모리(Main Memory), 동영상 및 3D 게임 구현을 위한 그래픽 메모리(Graphics Memory)로 사용되고 있으며, 가전제품의 디지털화에 따라 스마트TV, 스마트 냉장고 그리고 프린터 등에도 사용이 확대되고 있습니다. 또한 각종 이동통신 기기의 폭발적 성장에 따라 스마트폰 및 태블릿PC 등에도 모바일용 DRAM의 채용량이 급증하고 있습니다.

[플래시메모리(Flash Memory)]

플래시메모리는 전원이 공급되지 않아도 저장된 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로 크게 노어(NOR)형(Code저장형)과 낸드(NAND)형(Data저장형)으로 나눌 수 있습니다. 이중 당사가 생산하는 낸드 플래시는 순차적(Sequential) 정보 접근이 가능한 비휘발성 메모리 칩으로서, 디지털 비디오나 디지털 사진과 같은 대용량 정보를 저장하는데 매우 적합합니다.

낸드플래시 제품이 주로 적용되는 분야는 디지털 카메라, USB드라이브, MP3플레이어, 차량용 네비게이션, SSD(Solid State Drive), Flash Array 그리고 스마트폰, 태블릿PC와 같은 모바일 기기 등입니다. 한편, 최근 플래시 메모리는 일반적인 범용 메모리 보다는 고객지향적인 제품의 수요가 늘어나고 있어 이런 추세에 부합하는 적극적인 응용 제품개발 및 철저한 고객대응의 중요성이 커지고 있습니다.

나) 비메모리 반도체

비메모리 반도체는 정보 처리를 목적으로 제작되는 반도체로 특성에 따라, 아날로그, 로직, 마이크로, 디스크리트, 센서로 분류가 되며, 자사는 이중 CIS를 생산하고 있습니다.

[CIS(CMOS Image Sensor)]

계산과 추론 등 정보처리기능을 담당하는 비메모리 반도체 중에서도, 이미지 센서는 빛 에너지를 감지하여 그 세기의 정도를 영상 데이터로 변환해 주는 반도체 소자로서 디지털 촬영 기기에서 필름 역할을 하고 있습니다. 이미지센서는 제조 과정과 신호를 읽는 방법에 따라 CCD(Charge Coupled Device)와 CM

OS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 두 가지 타입으로 나뉩니다. 최근 CMOS 이미지 센서의 기술이 크게 향상되고 디지털 촬영기기가 소형화됨에 따라, 크기가 작고 전력 소모가 적은 CMOS 이미지 센서의 활용 범위가 점차 확대되고 있으며, 특히 CIS의 사용 분야 중 스마트폰과 태블릿PC향의 출하량과 매출 비중이 각각 50%를 넘어 고성장 추세입니다

(2) 산업의 성장성

반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되고 있습니다. 2014년 전체 반도체는 8.6%, 메모리 반도체 분야는 16.7%의 높은 성장을 기록하여 2013년에 이어 2년 연속 최대 매출을 보였습니다. 그러나 2015년 전체 반도체는 -2.2%, 메모리 반도체 분야는 -1.3% 성장하였습니다. 2016년은 전체 반도체 시장이 2.6%의 성장을 보였으며 NAND Flash 매출 증가로 인해 메모리 반도체 시장도 1.1% 성장하였습니다. (Gartner, 2017년 9월, 금액기준).

메모리 반도체 시장의 생산(공급) 측면은 점진적 둔화가 예상됩니다. 공정 미세화 기술은 한계에 다다르고 있으며, 생산 및 연구 개발을 위한 투자 비용이 급증하고 있는 반면, 고객들의 요구 성능과 품질 수준은 더욱 다양화, 고도화되고 있습니다. 이에 기존과 같은 외형 경쟁을 위한 무리한 공급 확대는 제한적일 것으로 전망됨에 따라, 향후 메모리 반도체 산업은 안정적 수요와 제한적인 공급으로 인해 메모리 시장 성장의 기회가 더욱 증대할 것으로 예상됩니다.

[DRAM]

시장 조사기관인 가트너(Gartner, 2017년 9월, 금액기준)에 따르면, DRAM 시장은 세계 경제의 점진적 회복 및 모바일 시장 확대, 수급 안정 등의 요인으로 2013년 \$349억(+33%), 2014년 \$461억(+32%)의 큰 폭의 매출 성장을 기록하였습니다. 2015년과 2016년에는 과잉공급으로 인한 평균 판매 가격(ASP: Average Selling Price) 하락으로, 각각 \$446억(-3.3%), \$410억(-8.1%)의 매출을 기록하였습니다. 분야별로 살펴 보면, PC 시장은 수요 정체로 인한 저성장 기조가 유지되어 DRAM 수요를 견인하는데 어려움을 겪고 있으나, 개인용 컴퓨터의 이동성(Mobility)에 대한 요구가 증가함에 따라 울트라북 등 노트북 컴퓨터로의 교체 및 신규 수요가 확대될 전망입니다. 한편, 수요가 지속적으로 증가하고 있는 모바일 기기는 DRAM 수요를 견인하는 주요 분야로서, 스마트폰과 태블릿 PC에서 채용하는 DRAM 용량은 2017년 각각 2.8GB와 2.2GB에서 2021년에는 5.1GB와 3.2GB으로 증가될 것(Gartner, 2017년 9월)으로 예상됩니다. 또한, 고화질 콘텐츠 유통 증가와 주요 게임 콘솔의 출시에 따라 이를 빠르게 처리할 수 있는 그래픽 메모리의 수요도 증가할 전망입니다. 상기와 같이 디지털 기기의 증가에 따른 DRAM 수요 증가뿐만 아니라, 대용량 콘텐츠 처리를 위한 기기당 탑재량 증가에 따라 DRAM 수요는 앞으로도 지속 증가할 것으로 예상됩니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 디지털 미디어의 성장과 더불어 스마트폰, 태블릿 PC, 디지털 카메라, MP3 플레이어 그리고 기타 멀티미디어 가전에 사용되는 플래시카드와 USB 드라이브, SSD와 같은 정보저장장치(Storage Devices)등에 널리 사용되고 있습니다.

가트너(Gartner, 2017년 9월, 금액기준)의 전망에 따르면 낸드플래시 시장은, 모바일 및 SSD 등 스토리지 분야 적용 확대를 통해 2015년 3.5%(\$308억), 2016년 14.9%(\$354억)의 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다. 이는 스마트폰, 태블릿 PC를 포함한 휴대용 기기 및 PC용 SSD, 기타 응용복합 제품 등 향후 낸드플래시의 수요를 견인할 제품 시장의 지속적 성장 전망에 기반한 것입니다.

향후에는 Cloud Computing 및 IoT 시대가 전개되며 Data Center의 Storage 용량 확대와 실시간 정보 처리의 필요성이 높아질 것이며, 이에 따라 Enterprise용 SSD가 일부 HDD를 대체하고 NAND 시장은 또 다른 도약을 할 수 있을 것으로 예상됩니다.

[CIS (CMOS Image Sensor)]

이미지센서는 1990년대 중반 디지털 카메라에 장착되어 일반 소비자에게 선보인 이후 PC 카메라, 자동차 블랙박스, 휴대폰카메라, 감시카메라 등 다양한 분야에 활용되어 시장 규모도 크게 증가하는 추세입니다. 특히 스마트폰, 태블릿 PC의 카메라 시장의 수요 증가로 시장이 지속 성장할 것으로 보입니다. 가트너(Gartner, 2017년 9월, 금액기준)의 전망에 따르면 이미지센서 시장은 2017년 US\$116억에서 2021년 US\$150억 규모로 연평균 6.8%의 성장이 예상되며, 특히 당사가 생산 중인 CMOS이미지센서 시장은 다양한 응용기기로의 확대 적용과 수요 증가로 전체 이미지 센서 시장에서의 비중이 2017년 94%에서 2021년 98%까지 확대되며 연평균 8.0%의 성장이 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미구주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다. 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄었습니다.

[DRAM]

DRAM은 PC 수요에 상당 부분 의존하여 기업의 PC교체 사이클의 영향을 크게 받아왔습니다. 그러나 최근에는 스마트폰 및 태블릿 PC 등 모바일 기기의 폭발적 성장에 따라 DRAM의 주요 수요처가 PC에서 서버 및 모바일로 분산되고 있어, 경기 변동성이 과거에 비해 악화되는 모습을 보이고 있습니다.

한편, 수요의 계절성으로서는 미구주 지역의 신학기, 크리스마스 특수 등 하반기 수요 증가가 뚜렷했으

나, 최근에는 아시아 시장의 성장과 스마트폰 신제품 출시 시기의 분산으로 인한 판매시장의 다변화로 전통적인 수요의 계절성이 일부 약화되는 모습도 나타나고 있습니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 과거 MP3 플레이어, 메모리카드 등의 수요증가에 힘입어 급속한 성장을 해왔습니다. 또한 최근에는 IT 기기가 스마트화되고 고성능화 됨에 따라 낸드플래시의 주 소비형태가 Controller와 Raw NAND가 결합되는 eMMC와 SSD 등으로 바뀌고 있으며 보다 높은 부가가치를 가지게 되었습니다. 아울러, 이들 eMMC와 SSD제품도 DRAM과 같이 스마트폰, 태블릿PC, 노트북, PC, Server, Storage, Flash Array 등의 다양한 제품에 장착되기 시작하며, 과거에 비해 경기변동성은 줄어든 것으로 예상됩니다.

[CIS (CMOS Image Sensor)]

이미지 센서 시장은 스마트폰, DSLR 등 전통적인 수요처의 강세가 지속되는 가운데, 자동차용 블랙박스, 후방카메라, 스마트TV 등 다양한 산업군과의 Convergence를 통해 시장이 더욱 확대되고 있습니다. 또한 이미지 센서 중 자사가 생산중인 CMOS 이미지센서는 휴대폰, 캠코더, PC 등 멀티미디어 기기 시장의 영향을 크게 받는 제품으로서 소비재의 특성상 경기변동과 기술변화에 민감할 뿐만 아니라 라이프 사이클이 짧은 특징을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

반도체 사업의 핵심 경쟁력은 1. 기술 및 원가 경쟁력, 2. 시장 대응 능력(고객확보, 제품 포트폴리오) 3. 설비투자 능력 등이 있습니다. 최근 대량생산이 용이한 표준제품 위주에서 응용분야가 점차 다양화, 융복합화 됨에 따라 시설투자와 생산성 향상을 통한 원가경쟁력 중심에서 제품 가치 증대를 통한 수익성 중심으로 경쟁의 패러다임이 빠르게 전환되고 있습니다.

지금까지는 적극적 투자에 의한 생산능력 확대와 생산원가 절감이 핵심 경쟁 요소 였지만, 공정 미세화의 난이도 증가와 투자 대비 수익에 대한 불확실성 증대 등 사업환경이 변화하였습니다. 따라서, 앞으로는 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감과 제품의 부가가치 증대를 위해 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용복합제품의 개발이 중요한 사업 경쟁력이 될 것입니다. 아울러 DRAM분야에서의 TSV(Through Silicon Via) 및 New Memory의 원활한 초기시장진입과 eMMC나 SSD 제품의 시장확대를 위해서는 관련 기술업체와의 협업과 더불어 고객 만족도가 중요해짐에 따라 마케팅 및 고객 지원 활동도 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다. 이외에도 적기에 시장요구에 부합하는 제품을 출시(Time to Market)할 수 있는 시장 대응력 및 재무 건전성 확보 등이 요구되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2017년 3분기는 서버와 모바일을 중심으로한 우호적인 시장 환경 속에서 가격의 상승 흐름이 이어진 가운데, 기술 경쟁력과 수익성 위주의 제품 운영을 통해 견조한 실적을 기록하였습니다.

당사의 연결 기준 매출은 전년 동기 대비 약 90.9% 증가한 약 8조 1천 1억 원을 기록하였으며, 연결기준 영업이익은 전년 동기 대비 약 414.8% 증가한 약 3조 7천 3백 7십 2억 원을 기록하였습니다. 연결기준 당기순이익은 전년 동기 대비 약 411.2% 증가한 약 3조 5백 5십 5억 원을 기록하였습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		제70기 3분기 (2017.07.01~ 2017.09.30)	제70기 2분기 (2017.04.01~ 2017.06.30)	전분기 대비 증감	제69기 3분기 (2016.07.01~ 2016.09.30)	전년 동기 대비 증감
매출액	당분기 실적	8,100,085	6,692,278	21.0%	4,243,646	90.9%
누계실적	누계 실적	21,081,881	12,981,796	-	11,840,289	78.1%
영업이익	당분기 실적	3,737,193	3,050,701	22.5%	725,957	414.8%
누계실적	누계 실적	9,255,492	5,518,299	-	1,740,607	431.7%
당기순이익	당분기 실적	3,055,530	2,468,511	23.8%	597,752	411.2%
누계실적	누계 실적	7,422,720	4,367,190	-	1,331,909	457.3%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[제70기 3분기]

(단위: 백만원)

구 분	매출액	매출액 비중 (%)	주 요 제 품
반도체 부문	21,081,881	100.0%	DRAM, NAND Flash, MCP 등
합계	21,081,881	100.0%	-

※ 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '반도체 제조업(분류번호: 261)'에 해당하며, 반도체부문의 매출액이 총매출액의 90%를 초과하므로 반도체부문으로 기재함.

(2) 시장점유율

구 분	'17년 2분기	'17년 1분기	'16년	'15년	'14년	'13년	'12년
DRAM	27.1%	27.7%	26.0%	27.3%	27.1%	26.6%	24.7%

구 분	'17년 2분기	'17년 1분기	'16년	'15년	'14년	'13년	'12년
NAND Flash	11.5%	13.1%	11.8%	12.6%	10.8%	10.7%	9.9%

출처: IDC 2017년 9월, 매출액 기준

(3) 시장 경쟁요소 및 회사의 경쟁력

(가) 메모리반도체 사업

[DRAM]

피씨 메모리(PC Memory)는 게이밍 피씨(Gaming PC), 2-in-1 노트북(Notebook) 및 크롬북(Chromebook)의 판매 증가가 메모리 수요 증대를 이끌 것으로 전망됩니다. 게이밍 피씨의 경우 게이밍 앱(Gaming App)증가 및 다양화에 따른 사용자 수 증가, HMD(Head Mount Device) 및 VR(Virtual Reality)등의 신규 장비 등장과 함께 피씨 내 작지만 확고한 위치를 자리잡아 가고 있습니다. 2-in-1 노트북의 경우는 기능성과 편리성을 갖추고 있어 기존 울트라북(Ultrabook) 수요를 이어갈 것으로 전망됩니다. 크롬북은 북미에서 교육용으로 판매가 증가하고 있습니다. 저렴한 가격, 무료 OS, 다양한 교육용 프로그램이 제공 되기에 학교 및 정부에서 대량으로 구매를 추진하고 있어 전망이 밝습니다. 3분기에는 Intel의 신규 플랫폼인 카비레이크(KabyLake) 및 AMD의 새로운 프로세서인 라이젠(Ryzen)의 출시와 개학시즌 수요가 맞물려 피씨 메모리 수요가 증가하였습니다. 이 흐름은 4분기까지 이어질 것으로 전망되어 2017년 연말까지 피씨 메모리 지속적인 수요 증가가 전망 됩니다.

서버 메모리(Server Memory)는 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing), Big Data 등의 확산으로 데이터 트래픽이 기하급수적으로 증가하면서 지속적인 수요 증대가 전망됩니다. 특히, 퍼블릭 클라우드로의 전환가속화에 따른 대형 클라우드 서비스 업체들의 대규모 투자가 Server 수요를 견인하고 있습니다. AI (Artificial Intelligence) / Machine learning 등 BI (Business Intelligence) 향상을 위한 Analytics Application 성장이 본격화 되면서 고속/고용량 메모리 수요가 증가할 것으로 전망합니다. 따라서 자사는 해당 수요에 대응할 수 있는 고속/고용량 서버 모듈(Module) 제품을 공급하고 있습니다. 또한, Intel의 신규 플랫폼인 Skylake가 출시됨에 따라 하반기 신규/업그레이드 목적의 메모리 수요 증대도 전망됩니다.

그래픽스 메모리(Graphics Memory)는 게임, 동영상 및 3D 그래픽 기술의 발전과 함께 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 특히, 그래픽스 가속 기능을 기반으로 한 인공지능 분야는 최근 급속히 성장하여 IT 기업의 중요한 전략 분야로 발전하고 있습니다. 당사는 주요 그래픽 칩셋 업체들과의 전략적 관계강화를 통하여 데스크탑, 노트북용, HPC용 등 PC 그래픽 및 차세대 Game Console 분야에서도 주도적인 위치를 공고히 하고 있습니다. 차세대 메모리 솔루션이라 할 수 있는 HBM(High Bandwidth Memory) 및 세계 최고 속도의 20나노급 8Gb(기가비트) GDDR6 그래픽 D램을 개발하여 고객의 최고급 그래픽 카드

예상 출시 시점인 2018년 초에 맞춰 제품을 양산할 계획입니다.

컨수머 메모리(Consumer Memory) 시장은 메모리 시장 가격의 지속적인 상승으로 시장 수요의 약 50%를 차지하는 TV와 셋톱박스(Set-top Box) 업체가 원가 상승에 따른 판매 부진 또는 일부 업체의 적자 전환이 발생하였습니다. 이에 따라, 2017년에는 전체 TV와 셋톱박스 세트 판매 증가는 제한된 가운데 업체들의 고수익 High-end 제품 판매에 집중하며 TV와 셋톱박스용 메모리 수요가 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.

반면, 신규 5G 네트워크 인프라와 자동차용 인포테인먼트/자율주행 그리고 음성인식 기능을 활용한 스마트홈 관련 수요가 지속적인 호조를 보이며 향후 컨수머 메모리 시장 수요를 주도할 것으로 예상됩니다. 당사는 다양한 응용분야의 특성에 맞추어 저용량부터 고용량 (2Gb ~ 32Gb), Legacy 메모리인 DDR3부터 저전압/고속의 LPDDR4/4X 및 극한 환경에 특성화된 IT(Industrial Temperature)/AT(Automotive Temperature) 제품을 개발하여 다양한 컨수머 고객 요구에 적극적으로 대응하고 있습니다.

모바일 메모리(Mobile Memory)는 스마트폰 기기 발전이 주 성장 동력인 가운데, 무선통신 환경 발전과 정보통신 융합 가속화로 다양한 종류의 Connected Device에도 채용이 확대되며 중장기 메모리 성장을 견인할 것으로 전망하고 있습니다. 스마트폰 시장은 성숙기에 이르러 기기 성장률은 둔화되고 있으나, 교체 수요의 고사양 제품으로의 이동 추세와 모바일 메모리 수요 성장을 주도하고 있습니다. 사용자의 스마트폰을 이용한 다양한 콘텐츠/서비스 이용 확대와 향후 개인 보유 기기 증가에 따른 스마트폰의 Hub Device로서의 역할 고도화로 스마트폰 기기의 높은 성능이 지속 요구될 것이며, 스마트폰 제조업체간 경쟁 격화에 따른 제품 차별화 노력으로 모바일 메모리 Contents는 연간 두자리 수의 높은 성장률을 유지할 것으로 전망되고 있습니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 데이터 저장 용도로 쓰이는 대표적인 메모리 반도체로서, 빠른 테크놀로지의 진화로 매년 높은 성장률을 기록하였습니다. 낸드플래시 시장이 이렇게 성장을 지속하는 이유는 최첨단 IT기기 및 다양한 소비자 가전에서 낸드플래시 채용률 및 채용 용량이 지속적으로 높아지고 있기 때문입니다.

과거에는 플래시카드, USB 드라이브, MP3 플레이어, PMP 등이 낸드플래시 메모리의 주요 수요처였으나, 최근에는 스마트폰, 태블릿 PC 등의 모바일 분야에서 멀티 미디어 기능의 확대에 따른 채용량 증가로 낸드플래시 메모리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 스마트TV, 스마트 카 등의 신개념 도입으로 인하여 과거에 저 용량의 낸드플래시 메모리만 사용했던 분야에서도 고 용량 낸드플래시 메모리에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

그리고, 낸드플래시를 기반으로 한 SSD(Solid State Drive)와 같은 다양한 형태의 Storage Solution이

노트북은 물론이고 서버 시장에서도 주요 제품군으로 자리잡고 있어, 향후 낸드플래시 메모리 시장의 지속적인 성장을 견인할 것으로 전망되고 있습니다.

이와 같은, 낸드플래시 시장에서 당사는 저 용량부터 고 용량까지 다양한 단품 및 응용 복합 제품을 기반으로 고객의 수요에 보다 적극적으로 대응하고 있으며, 응용 분야별 선택과 집종을 통하여 낸드플래시 경쟁력을 확보하고 시장 지배력을 높여 가고 있습니다. 또한, 높은 기술력을 바탕으로 Floating Gate 방식의 10nm대 Planar NAND 및 3D NAND를 개발, 빠른 NAND 시장 변화에 발 맞추어 대응하고 있습니다.

(나) 비메모리반도체 사업

회사는 지난 2007년 11월, 제품 포트폴리오를 더욱 다양화하고, 기존 메모리 사업 역량을 활용하여 안정적인 수익성과 높은 투자효율성이 기대되는 CIS 사업에 재진출하였습니다.

[CIS (CMOS Image Sensor)]

CIS는 모바일 폰, 노트북, 태블릿, 디지털 카메라 등 다양한 디지털 기기에서 필름 역할을 하는 반도체 소자이며, 2016년부터 2021년까지 연평균 약 7.5%의 성장률을 보일것으로 예상하고 있습니다. (출처: Techno-Systems Research, 출하량 기준)

CIS는 모바일 폰과 노트북, 태블릿에 가장 많이 사용되고 있으며, 화질이 크게 향상되면서 의료 기기, DSLR 및 캠코더, 자동차, 보안 장비, 게임기, 가전 제품 등으로 응용 범위가 점점 확대되고 있습니다. 전체 Application 중 수량 및 매출 비중이 가장 큰 모바일의 경우, 화상 통신 및 Selfie를 위한 전면 카메라(Front Facing Camera)와 사진 촬영을 위한 후면 카메라(Rear View Camera)용으로 두 개의 이미지 센서가 장착되고 있으며, 2016년부터는 후면 카메라에 듀얼 카메라 채택이 증가되면서 기기당 이미지 센서 탑재 비율이 더욱 증가하고있는 추세입니다.

최근 스마트폰 시장에서는 전면 카메라에 5M/8M 제품, 후면 카메라에는 13M/16M 제품이 보편화 되고 있으며, Flagship model에는 화질을 더욱 개선한 12M 제품과 20M 이상의 초고해상도 제품이 채용되고 있습니다. 한편, 노트북용 이미지센서 시장은 HD 제품이 주류를 이루고 있으며 일부 저가 model에는 VGA 제품으로 전환 되는 경향을 보이고 있습니다. 나아가 태블릿 역시 5M~13M의 제품이 전면 카메라와 후면 카메라에 채용되고 있습니다.

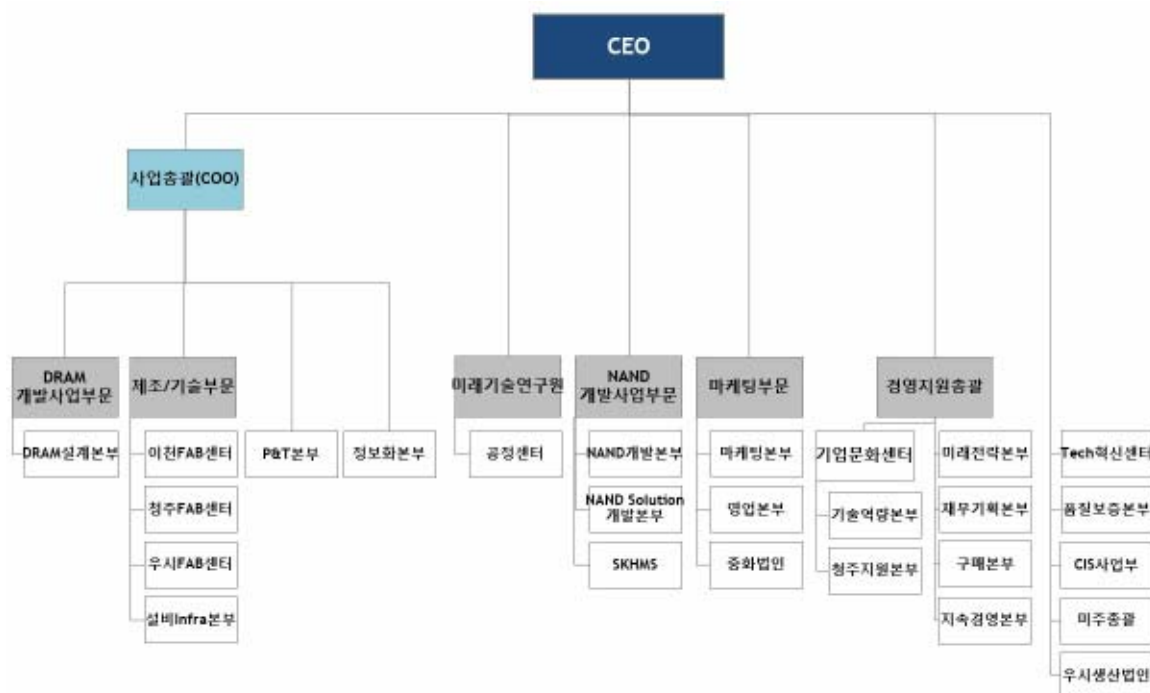
당사는 이미지센서 시장중 가장 많은 비중을 점유하고 있는 모바일폰 시장과 이와 유사한 성능을 요구하고 있는 노트북, Tablet 시장에 집중하고 있으며, 2012년 4분기에 BSI(Back-Side Illumination) 기술을

개발 완료하여 2013년부터 BSI를 적용한 5M, 8M 제품의 안정적 생산과 고객대응으로 마켓 포지션을 강화하고 있습니다. 2016년에는 advanced BSI 기술을 적용한 13M 제품 개발을 완료하여 시장에 성공적으로 진입함으로써 제품 라인업을 13M까지 확대하였고, 2017년에는 고화소 시장으로의 진입을 위해 300mm 공정 Setup과 16M 이상 제품 라인업 구축을 위한 제품 개발에 집중하고 있습니다. 하반기에 300mm 첫 제품인 16M 엔지니어링 샘플 출시와 더불어 원가 절감을 위한 Non-Stack 16M, 저조도 화질 개선을 위한 Quad-Cell 제품, 13M/16M 고객 Customized 제품 등 다양한 300mm 제품들이 '18년 출시를 목표로 개발 되고 있으며, 이를 바탕으로 고화소 시장 확대를 추진하고 있습니다.

시장의 니즈에 맞추어 제품을 개발하는 것 이외에도, AP 업체와 협업을 통한 제품 기획과 판매가 최근 활발히 이루어지고 있으며, 모바일 디바이스의 Slim Bezel 특성을 맞추기 위해 Size 및 두께를 낮추는 소형화 추세에도 발맞추어 가고 있습니다.

그리고 고객과 시장 확대를 위하여 국내, 중국, 일본 뿐 아니라 미구주 지역 등에서도 다양한 마케팅 활동과 고객 지원활동을 진행하고 있으며, 고객 확대와 애플리케이션 다양화로 CIS시장에서의 입지를 강화해 나갈 계획입니다.

(4) 조직도 (제출일 기준)



전사 조직도

다. 사업부문별 재무정보

당사는 반도체제조업부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하는 지배적 단일 사업부문으로서 부문별 기재를 생략합니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
반도체 부문	제품 외	DRAM, NAND Flash, MCP 등	산업용 전자기기	SK하이닉스	21,081,881 (100%)
합계					21,081,881 (100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

2017년 3분기에는 서버와 모바일을 중심으로 견조한 수요가 지속된 반면, 공급 측면에서의 제한된 증가로 인해 가격이 상승세를 보였으며 하반기에도 안정적인 시황이 지속될 것으로 기대합니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

당사의 메모리반도체 부문 생산공정에 투입되는 원재료는 크게 웨이퍼(Wafer), 리드프레임(Lead Frame) 및 섭스트레이트(Substrate), PCB(Printed Circuit Board) 그리고 기타 재료 등으로 구성됩니다.

웨이퍼는 집적회로(Integrated Circuit, IC)를 제작하기 위해 반도체 물질의 단결정을 성장시킨 기둥 모양의 규소(Ingot)를 얇게 절단하여 원판모양으로 만든 것으로서 반도체 소자를 만드는 데 사용되는 핵심 재료입니다.

Lead Frame은 반도체 IC를 구성하는 또 다른 주요 요소이며 반도체 칩과 PCB 기판간의 전기신호를 전달하면서 외부의 습기, 충격 등으로부터 칩을 보호하고 지지해주는 골격 역할을 하는 부품입니다.

Substrate는 리드프레임과 같은 기능을 하지만 전기신호를 전달하는 역할을 하는 다리를 기존의 금속 다리가 아닌 공(Ball) 모양의 연결부분을 이용한 부품입니다.

PCB는 그 위에 저항, 콘덴서, 코일, 트랜지스터, 집적회로, 대규모 집적회로(Large-Scale Integration), 스위치 등의 부품을 장치하고 납땜하여 회로기능을 완성시키는 인쇄 배선판입니다. 그 외 가스 및 화학약품 등이 반도체 제조 공정에 투입되는 원재료로 소요됩니다.

가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	투입액	비율	비고
반도체 부문	원재료	Wafer	fab 생산	395,091	11%	-
		Lead Frame& Substrate	package	119,926	3%	-
		PCB	module	100,451	3%	-
		기타	-	1,345,301	38%	-
		소계		1,960,769	56%	-
	저장품	S/P, 부재료	-	1,536,924	44%	-
	합 계			3,497,693	100%	-

나. 주요 원재료의 매입처 및 원재료 공급시장과 공급의 안정성

당사는 일본, 독일, 미국, 한국 등에 생산시설을 보유한 5개사로부터 반도체 공정의 주요 원자재인 300mm 웨이퍼 완제품을 수입 하고 있습니다. 당사는 당사와 거래하는 매입처 등과 일상적인 영업활동 이외의 특수한 관계를 갖고 있지 않습니다. 당사가 거래하고 있는 상기 5개사는 전체 300mm 웨이퍼 시장의 90% 이상을 차지하고 있습니다.

웨이퍼는 그 원재료가 되는 폴리 실리콘의 수급 동향에 따라 300mm 웨이퍼 완제품 가격이 큰 영향을 받습니다. 특히, 폴리 실리콘은 웨이퍼 이외에도 태양전지(Solar Cell)의 원료로도 사용되기 때문에 태양전지의 수요에 따라 폴리 실리콘의 일시적 부족현상이 발생하면 웨이퍼의 공급에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서, 당사는 주요 원재료인 웨이퍼의 원활한 확보를 위해 폴리 실리콘 시장의 가격 동향은 물론, 동일한 원재료를 사용하는 태양전지 수급동향을 지속적으로 모니터링하고 있습니다.

최근 반도체 공정에 사용되는 웨이퍼 수요 증가 추세에 따라 당사는 웨이퍼 시장의 수급 동향을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 당사 주요 매입처와의 중장기적 협력 관계 강

화를 통해 안정적 생산 지원 및 대응력을 강화해 나갈 것입니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사는 4조3교대로 운영되고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2017년 3분기 총 가동일은 273일로, 각 지역별 FAB의 가동인원 및 가동율을 고려하여 계산한 당사의 평균가동시간은 월 12,881,960시간입니다.

생산능력은 "해당 기간 최대생산 일의 생산량 x 누적일수 x 평균원가"의 방법으로 산출하고 있으며, 2017년 3분기 생산능력은 10,211,930백만원 입니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	제70기 3분기	제69기	제68기
반도체 부문	10,211,930	12,054,238	11,594,878

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

나. 생산실적 및 가동률

당사의 2017년 3분기 생산실적은 10,211,930백만 원으로 집계되었으며, 동 기간 생산설비의 평균가동률은 100%를 유지하였습니다.

(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	제70기 3분기	제69기	제68기
반도체 부문	10,211,930	12,054,238	11,594,878

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 가동률

(단위 :시간, %)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률
반도체 부문	115,937,640	115,937,640	100%

※가동률은 각 지역별 제조 인원을 고려하여 계산함.

다. 생산설비의 현황

당사의 시설 및 설비의 장부가액은 작성기준일 현재 21조 9,772억 원이며, 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합계
2017.01.01								
취득원가	575,755	3,287,424	909,991	43,439,176	3,555	1,085,379	1,537,934	50,839,214
감가상각누계액		(749,076)	(374,742)	(29,993,593)	(2,514)	(649,669)		(31,769,594)
손상차손누계액		(23,699)	(19,104)	(243,540)		(59)		(286,401)
정부보조금		(274)		(5,535)		(8)		(5,817)
기초순장부금액	575,755	2,514,376	516,145	13,196,508	1,042	435,643	1,537,934	18,777,402
기중변동액								
취득	179	109,443	189,173	4,663,913	117	95,366	1,763,527	6,821,718
처분	(119)		(2,962)	(154,081)		(80)	(40,799)	(198,041)
손상차손								
감가상각		(83,245)	(35,391)	(3,175,358)	(284)	(114,409)		(3,408,687)
대체	496	312,103	108,187	835,852		6,346	(1,262,985)	
환율변동 등	(643)	(1,875)	(1,096)	(12,543)		(1,289)	2,212	(15,234)
기말순장부금액	575,668	2,850,802	774,056	15,354,292	875	421,577	1,999,889	21,977,158
2017.09.30								
취득원가	575,668	3,706,109	1,189,484	45,225,910	3,276	1,169,374	1,999,889	53,869,710
감가상각누계액		(831,351)	(396,324)	(29,700,381)	(2,402)	(747,758)		(31,678,215)
손상차손누계액		(23,699)	(19,104)	(166,396)		(36)		(209,234)
정부보조금		(258)		(4,841)		(3)		(5,103)
기말순장부금액	575,668	2,850,802	774,056	15,354,292	875	421,577	1,999,889	21,977,158

라. 투자계획

2017년 3분기 당사의 입고 기준 투자집행 실적은 다음과 같습니다.

[입고기준]

(단위 : 십억원)

구 분	투자대상자산	투자효과	투자 기간	기투자액 (누적)	비 고
보완투자 등	기계장치 외	생산능력증가	2017.01.01~ 2017.09.30	6,894	-
합 계				6,894	-

5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제70기 3분기	제69기	제68기
반도체 부문	제품 외	DRAM, 낸드플래시, MCP 등	21,081,881	17,197,975	18,797,998
합 계			21,081,881	17,197,975	18,797,998

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

국내에서는 마케팅부문 내 영업6팀 관할 하에 대리점 6개사를 운영하고 있습니다. 해외 판매법인인 미국, 독일, 영국, 일본, 싱가포르, 인도, 대만, 중국 등 총 8개 국가에 10개 법인이 소재하고 있으며 산하에 18개 사무소 및 10개 대리점을 두고 있습니다.

(2) 판매경로

당사의 판매 경로는 크게 직판 거래와 대리점 거래로 나눌 수 있습니다. 직판 거래는 당사에 서 일반 기업체 등 실 수요자에게 직접 판매를 하는 것이고, 대리점 거래는 당사가 대리점을 통해서 일반 기업체 등의 실 수요자에게 판매하는 것입니다.

(3) 판매방법 및 조건

내수 판매는 국내 대리점 등의 수주 현황에 의거하여 현금 또는 어음 결제조건으로 납품하고 있으며, 수출은 MASTER L/C 및 LOCAL L/C에 의거하여 신용장 또는 D/A, D/P 거래 등으로 납품하고 있습니다.

(4) 판매전략

당사 판매 전략은 비즈니스 포트폴리오 최적화, 수익 구조 개선, 고객 관계 유지, 지역별 포지셔닝 등 4가지를 근간으로 하고 있습니다.

비즈니스 안정성을 위해서 포트폴리오의 최적화를 추진하고 있으며 매출 확대를 위해 제품 구성을 다양화 하고 있습니다. 수익 구조 개선을 위해서 고부가가치 제품 판매를 확대하고 시장 통찰 능력을 강화하여 미래 시장 발굴을 추진하고 있습니다. 고객 관계 유지를 위해서 고객 가치 제안 활동을 강화하고 특화된 제품을 제공하여 고객 만족 제고를 추진하고 있습니다. 지역별 특성을 고려하여 차별화된 제품 전략으로 지역별 전략 고객 매출 확대를 추진하고 있습니다.

(5) 주요 매출처

반도체는 IT 컨수머 제품 전체에 걸쳐 그 수요처가 다양하며, 당사는 세계 유수의 모바일 및 컴퓨팅 관련 전자 업체에 제품을 공급하고 있습니다. 낸드플래시는 IT 컨수머 제품 전체에 걸쳐 그 수요처가 다양하기 때문에, 세계적인 모바일 디바이스 및 IT 제품 제조업체, 그리고 SSD와 같은 대용량 저장장치와 메모리 카드 생산업체 등을 고객으로 확보하고 있습니다.

6. 수주상황

당사는 주요 고객사들과 월별/분기별 상호 합의에 따른 공급 물량 및 가격을 결정하고 있으며, 장기공급 계약에 따른 수주 현황은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당분기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 해당통화 백만)				
구 분	자 산		부 채	
	외화금액	원화환산	외화금액	원화환산
USD	7,256	8,320,563	4,359	4,998,126
EUR	15	19,704	155	209,370
JPY	4,347	44,358	38,744	395,352

당분기말 현재 각 외화에 대한 환율 10% 변동을 가정한 화폐성 외화자산 및 외화부채의 환율변동위험은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	10% 상승시	10% 하락시
USD	332,244	(332,244)
EUR	(18,967)	18,967
JPY	(35,099)	35,099

(2) 이자율위험

연결실체의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율 위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

연결실체는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시 향후 3개월간 연결실체의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자비용과 이자수익으로 인한 법인세비용차감전순이익은 각각 5,475백만원 만큼 증가 또는 감소하였을 것입니다.

(3) 가격위험

연결실체는 당분기말 현재 공정가치로 평가하는 매도가능지분상품을 보유하고 있지 않습니다. 따라서 연결실체는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있지 않습니다.

나. 회사의 위험관리 정책

(1) 위험관리의 일반적 전략

[주요 시장위험요소]

당사는 외화표시 자산 및 부채에 대해 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영 안정성 제고를 목표로 한 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 또한 당사는 영업 측면에서 매출의 90% 이상이 USD로 이루어져 있어, USD 수입이 지출보다 많은 현금을 가지고 있으므로 수입에서 지출을 차감한 잔존 외화 현금흐름이 환리스크 관리의 주 대상입니다.

[위험관리규정]

당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환위험 관리규정 제정, 외환관리위원회 구성 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 그 주요 내용은 ①외환거래는 환 리스크를 회피하고 안정적 경영 수익을 확보하기 위해 실행되어야 하며, ②실수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하고, ③환위험 관리의 정책은 자연적 헤지(Natural Hedge)를 기본으로 하되 필요시 선물환 등 외부적 관리기법을 일부 시행하고, ④회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 외환관리위원회가 설정한 지침에 따라 관리하고 있습니다.

(2) 위험관리조직 및 운영 현황

당사는 외환관리에 관한 의사결정기구로서 외환관리위원회를 운영하고 있으며, 외환관리위원회의 주요 업무는 다음과 같습니다.

- ① 외환 관리 정책, 전략 심의 및 의결
- ② 외환 관리 규정의 제정 및 개정
- ③ 외환관리 목표와 허용 손실한도의 설정
- ④ 외환위험 헤지 범위 및 헤지 비율, 관리수단 등의 조정
- ⑤ 외환포지션, 환율 변동 영향, 환율 전망 등 환관련 정보의 공유

8. 파생상품 거래현황

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타금융부채로 인식되어 있는 파생금융부채의 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
이자율스왑	-	288

(2) 당분기와 전분기 중 파생상품 거래와 관련하여 금융수익 및 금융비용으로 인식한 평가손익 및 거래손익은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)								
구 분	평가이익		평가손실		거래이익		거래손실	
	3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적
이자율스왑	(188)	-	-	-	492	902	304	913

② 전분기

(단위: 백만원)								
구 분	평가이익		평가손실		거래이익		거래손실	
	3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적
이자율스왑	128	248	-	-	292	876	406	1,218

9. 경영상의 주요계약 등

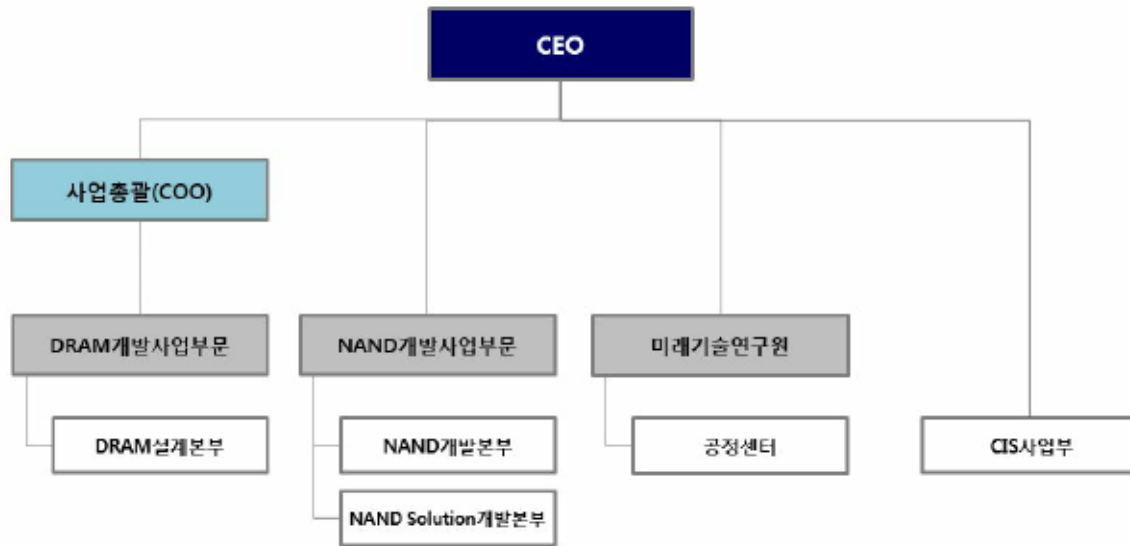
계약 상대방	항목	내용	비고
삼성전자	계약 유형	특허 크로스 라이선스 계약	-
	계약 기간	2013년 6월 1일 이후	
	목적 및 내용	삼성전자가 보유하고있는 반도체 관련 모든 특허에 대한 사용권을 확보하여 향후 잠재적 분쟁 가능성 원천적 해소	
	기타 주요내용	-	
Rambus Inc.	계약 유형	특허 크로스 라이선스 계약	-
	계약 기간	2013년 7월 1일 ~ 2024년 6월 30일	
	목적 및 내용	라이선스 계약을 통해 반도체 전 제품 기술 관련 램버스 보유 특허에 대한 사용권한을 확보하여 향후 분쟁 가능성 해소	
	기타 주요내용	특허 및 반독점 소송 등 램버스와 진행중인 모든 소송 취하	
실리콘화일	계약 유형	주식교환계약	-
	계약 체결일	2014년 1월 28일	
	목적 및 내용	주식의 포괄적 교환을 통해 실리콘화일을 완전자회사로 편입하여 CIS 사업의 경영 효율성 증대	
	기타 주요내용	주식교환일: 2014년 4월 22일 주식교환비율: 에스케이하이닉스 보통주 : 실리콘화일 보통주 =1 : 0.2232438	
Softeq Flash Solutions LLC	계약 유형	주식 인수	-
	계약 체결일	2014년 5월 15일	
	목적 및 내용	NAND Flash 개발 역량 향상을 위해 인수	
	기타 주요내용	-	
Violin Memory	계약 유형	자산 인수	-
	계약 체결일	2014년 5월 29일	
	목적 및 내용	NAND 솔루션 역량 강화를 위해, Violin사의 PCIe Card 부문 자산 및 인력을 인수	
	기타 주요내용	PCIe Card 관련 특허에 대한 Cross-License 체결	
Toshiba	계약 유형	공동 개발 계약	
	계약 기간	2015년 2월 5일 이후	

계약 상대방	항목	내용	비고
	목적 및 내용	차세대 노광기술(Nano Imprint Lithography) 개발	-
	기타 주요내용	-	
Sandisk Corporation	계약 유형	특허 크로스 라이선스 계약 등	-
	계약 기간	2015년 8월 ~ 2023년 3월	
	목적 및 내용	1) 기존 특허 cross license 계약 연장 2) 동 기간 동안 당사의 DRAM 제품을 판매하는 장기 공급계약 체결 3) 양사간 진행 중인 영업비밀 소송은 취하하기로 합의함	
	기타 주요내용	-	
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)	계약 유형	영업 양도	-
	계약 기간	2017년 7월 1일 (영업/자산 양도 시점)	
	목적 및 내용	Foundry 사업의 책임 경영을 통한 수익성 및 사업가치 제고	
	기타 주요내용	1) Foundry 사업과 관련된 자산 등의 포괄적 양도 2) 이사회 의결일 : 2017년 5월 24일	
BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP	계약 유형	특수목적법인(SPC)에 대한 출자 (신규 설립)	-
	계약 기간	2017년 9월 28일 이후	
	목적 및 내용	Bain Capital이 General Partner로서 구성한 특수목적법인(SPC)이 도시바의 반도체 사업 지분을 인수하며, 당사는 이에 대한 Limited Partner로서 투자에 참여	
	기타 주요내용	Anti-trust Filing 승인 등 선행조건을 충족 시 계약 완료	
BCPE Pangea Cayman2 Limited	계약 유형	특수목적법인(SPC)이 발행한 전환사채 취득	-
	계약 기간	2017년 9월 28일 이후	
	목적 및 내용	Bain Capital과의 특수목적법인(SPC)의 전환사채를 취득하고, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환 시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보 가능	
	기타 주요내용	Anti-trust Filing 승인 등 선행조건을 충족 시 계약 완료	

10. 연구개발활동

가. 연구개발 담당조직 (제출일 기준)

당사는 보고서 제출일 현재, 미래기술연구원과 DRAM개발사업부문(DRAM설계본부), NAND 개발사업부문(NAND개발본부, NAND Solution개발본부) 및 CIS사업부에서 연구개발 활동에 주력하고 있습니다.



연구개발 조직도

나. 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목		제70기 3분기	제69기	제68기	비 고
연구개발 비용	원 재 료 비	65,406	78,024	66,011	-
	인 건 비	612,244	586,745	641,937	-
	감 가 상 각 비	219,351	252,648	207,237	-
	위 탁 용 역 비	157,138	227,589	218,174	-
	기 타	747,081	724,226	623,136	-
	연구개발비용 합계	1,801,221	2,098,654	1,756,494	-
회계처리	판매비와 관리비	1,389,797	1,518,299	1,409,422	-
	제조경비	-	-	-	-
	개발비(무형자산)	411,424	350,932	347,072	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷ 당기매출액× 100]		8.5%	10.9%	9.3%	-
매출액		21,081,881	17,197,975	18,797,998	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

다. 연구개발 실적

구 분	연구과제명	기대효과
제70기 3분기	1) 3D 256Gb TLC	업계 최초로 개발한 72단 3D NAND FLASH로, 기존 48단 제품 대비 동위 단위면적당 셀의 수가 많아 고용량 확보에 유리함. SSD와 모바일 기기에 적용 예정이며 향후 매출 기여 예상됨.
	2) 2znm 8Gb GDDR6	2znm Tech. 기반의 GDDR6 제품으로 384개의 정보입출구(I/O)를 활용해 초당 최대 768GB의 그래픽 데이터 처리가 가능. 향후 인공지능 및 가상 현실 등의 솔루션 등에 활용되며 매출 확대 효과 발생 예상됨.
	3) 3D PCIe NVMe Client SSD	72단 3D NAND를 적용한 PCIe Client SSD 제품으로, 기존 36단 제품을 72단으로 전환함으로써 수익성 개선에 기여 전망
	4) 3D UFS 2.1	원가와 성능을 개선한 2세대 UFS 컨트롤러를 탑재하고, 기존 적용하던 36단 3D NAND를 48단으로 전환해 향후 수익성 개선에 기여 전망
	5) 3D eMMC 5.1	기존 적용하던 36단 3D NAND를 72단으로 전환하고, 자체 개발한 eMMC 컨트롤러를 적용해 매출 확대에 기여 예상
	6) 2znm 8Gb HBM2 Gen1	TSV 기술을 활용해 대역폭을 크게 늘림으로써 초당 204GB의 Data 처리가 가능한 초고속/저전력 제품. 고객과의 협업 체계 구축으로 향후 매출 확대 기여 예상

구 분	연구과제명	기대효과
제69기	1) 2znm 4Gb LPDDR4	2znm Tech. 파생제품 첫번째로 개발 완료한 프로젝트이며, 2ynm 제품 대비 원가 경쟁력을 갖춘 제품으로 2016년 High End Mobile Phone 시장에서 자사 수익성에 기여할 예정이며, Automobile/Consumer/Computing 등 LPDDR4 제품을 활용한 타 어플리케이션 신규 시장 진입으로 향후 매출 확대 효과 발생 예상됨.
	2) 2znm 6Gb LPDDR4	2ynm 6Gb LPDDR4 후속 공정 제품으로 2016년부터 Premium Mobile Phone 시장대응으로 자사 수익성 향상 및 '16년 LPDDR4X 신규 시장 SoC Validation 및 고객샘플 적기 대응으로 향후 매출 기여 예상됨.
	3) 3D eMMC5.1	3D NAND를 사용한 첫 번째 eMMC 솔루션 개발 완료 프로젝트로, 2D 대비 원가 경쟁력 확보한 3D NAND 통해 수익성 개선 예상함.
	4) 1xnm SATA Enterprise SSD	1xnm NAND 적용한 Enterprise용 SSD 제품 개발 완료. Enterprise SSD 시장 확대 통한 매출 및 수익성 확보할 것으로

구 분	연구과제명	기대효과
		로 기대함.
	5) 3D PCIe Enterprise SSD	3D NAND를 사용한 Enterprise용 PCIe SSD 제품 개발 완료 . 3D NAND 및 PCIe NVMe 적용한 첫 제품이기예 매출 확대와 수익성 개선 예상함.
	6) 8MP, 1/4" (90nm BSI, 1.12 um, Raw Sensor)	Hi-842 대비 픽셀특성향상, Analog 성능향상, 기능추가(2D-LSC)개선 제품으로 Smartphone의 front & main camera 시장진입으로 2016년 1Q부터 고객사 양산물량 공급으로 매출 확대 기여할 것으로 예상함.
	7) 5MP, 1/5"(90nm BSI, 1.12 um, Raw Sensor)	대형고객 진입을 목표로 픽셀성능 및 센서성능을 개선한 제품으로 1분기부터 매출 확대에 기여할 것으로 예상함.
	8) 2znm 8Gb DDR4	컴퓨팅 시장에서 DDR4의 고용량 DIMM(32GB, 64GB) 및 High Speed 제품 (2666Mbps)에 대한 수요가 커지는 시점에서 수익성 극대화 및 시장 적기대응을 위한 제품 개발로, 서버 및 PC용 대응 및 수익성 기대
	9) 2znm 8Gb GDDR5	게임 콘솔용 GDDR5 판매 확대 및 안정적 시장 확보 및 Graphics High Density / High Speed 수요 전환 대응을 통한 수익성 확보 기대
	10) 2znm 4Gb DDR3x16	2znm 4Gb DDR3x16 의 후속 공정 개선을 통한 디지털TV/ 셋톱박스 등의 시장 장기 공급 대응으로 수익성 확보 기대
	11) 2znm 8Gb LPDDR3N	2znm 8Gb LPDDR3 후속 Tech Version 제품. Net Die 극대화에 따른 Cost 경쟁력을 바탕으로 자사 수익성 극대화에 기여가 예상됨. 또한 Speed Target 2133Mbps 확보로 주요 PC 업체용 대응이 가능하여 2znm 8Gb LPDDR3 대비 매출 확대가 예상됨.
	12) 3D UFS 2.0	3D NAND(36단)를 적용한 UFS2.0 제품 개발 완료. 기존 2D 탑재 제품 대비 성능과 특성이 개선되어 모바일 시장에서 High performance 요구 고객 중심으로 매출 확대 예상
	13) 3D SATA Client SSD	3D NAND(48단)을 적용한 SATA Client SSD 제품으로, 3D TLC NAND를 적용한 자사 최초 SATA Client SSD 제품. 주요 PC업체 진입을 통한 매출 확대 및 수익성 개선 예상
	14) 1ynm 128Gb TLC	기존 1xnm급 NAND제품의 미세화를 통해 원가경쟁력을 극대화한 제품. 개선된 성능과 특성으로 Mobile / SSD등에 널리 채용될 예정
	15) 8MP, 1/4" (90nm BSI, 1.1 2um, Raw Sensor)	Hi-843 대비 픽셀, Analog/Digital 성능 향상 및 die size 축소로 품질/가격 경쟁력 향상한 제품. 모바일 폰의 전/후방 카메라 시장 진입으로 내년 초부터 매출 확대 기여 예상

구 분	연구과제명	기대효과
	16) 5MP, 1/5"(90nm BSI, 1.12 um, Raw Sensor)	Hi-553 대비 픽셀, Analog/Digital 성능 향상 및 net die 증가로 품질/가격 경쟁력 향상한 제품. 모바일 시장 진입으로 향후 매출 확대에 기여 예상
	17) 5MP, 1/4"(90nm BSI, 1.4 um, Raw Sensor)	Hi-545대비 성능은 동등 수준 이상을 유지하며 net die를 극대화한 제품으로 향후 매출 기여 기대
	18) 13MP, 1/3"(90nm BSI, 1.1 2um, Raw Sensor)	13M 고화소 제품으로, Hi-1331대비 성능이 향상되었으며 올 하반기에 고객사들의 인증을 거쳐 향후 매출 발생 예상
	19) 2zm 4Gb DDR4	2ym 4Gb DDR4 의 후속 공정 미세화 제품으로 '17년 이후 DDR4 기반의 디지털TV, 셋톱박스 등의 시장 확대로 매출 확대 예상
	20) 2znm 8Gb LPDDR4X	고용량, 고속, 저전력 특성의 LPDDR4 파생제품으로서 플래그십 스마트폰 모델 탑재를 통한 매출 기여 예상. 향후 그래픽 등 다른 응용처에 대한 대응도 예상 중
	21) 2znm 2Gb LPDDR4	DRAM 양산 제품 최소로 2znm 기술에서 On-die ECC (Error Correction Code) Scheme 탑재한 제품으로, 모뎀과 오토모티브 등의 응용처를 통한 매출 예상
	22) 2znm 6Gb LPDDR4E	2znm 6Gb LPDDR4 의 파생제품으로 '17년 상반기부터 고사양 스마트폰에 대한 양산물량 공급으로 매출 확대 기여
	23) 3D PCIe NVMe Client SSD	3D NAND(36단)을 적용한 PCIe Client SSD 제품으로 제품 판매를 통한 매출 기여와 함께 2D에서 3D로 NAND 기술 전환 통해 수익성 개선 예상

구 분	연구과제명	기대효과
제68기	1) 2yna노급 6Gb LPDDR3	미세공정 전환을 통한 수익성 개선 제품으로 High-end Smartphone & Tablet 向 LPDDR3 제품 개발을 통한 매출 확대에 기여할 것으로 예상
	2) 1yna노급 64Gb TLC	3 bit cell 기술을 기반으로 개발된 저가 시장 대응용 제품임, 우수한 원가 경쟁력을 바탕으로 USB, Card 시장부터 Mobile시장까지 진입할 예정임
	3) 1yna노급 1st PCIe Client SSD	1yna노급 NAND를 채용한 PCIe 컨트롤러 탑재 1st Client SSD 제품으로 SATA에 이은 PCIe SSD 시장 진출 기반을 마련하였고, SSD 라인업이 보강되어 고객 확대에 기여할 것으로 예상됨.
	4) 1yna노급 2nd eMMC5.0	1yna노급 NAND를 채용한 eMMC 5.0 제품 개발 완료. 기존 제품 대비 Sequential Write(연속 쓰기)와 Sustain Performance를 개선하였으며, 차세대 eMMC5.1 기능 일부를 추

구 분	연구과제명	기대효과
		가 반영하여 Mid-high 시장의 수익성 개선에 기여 할 것으로 예상됨.
	5) 2M, 1/5" (130nm, 1.75um, , Raw Sensor)	기존 2M SoC Sensor에서 Image Signal Processor를 제외한 Raw Sensor 제품으로서 보급형 스마트폰 시장의 Low Cost Solution 요구를 만족시킴으로서 2M SOC 시장을 대체해 갈 것으로 예상됨.
	6) 2ynano급 2Gb DDR3(x16)	Embedded Application 4Gb 수요의 점진적 확대에도 불구하고 2015년 이후에도 DTV/STB 2Gb 수요가 견조할 것으로 예상되며, 미세공정 전환을 통한 수익성 개선이 예상됨
	7) 1xnano급 1st eMMC5.1	1xnano급 NAND를 채용한 eMMC5.1 제품으로 eMMC5.1 초기 시장에 진입할 제품이 준비됨에 따라 모바일 솔루션 시장에서의 매출과 수익성 확보에 기여할 것으로 예상함
	8) 1xnano급 2nd Client SSD	1xnano급 NAND를 채용한 Client SSD로 TLC NAND를 적용한 채널형 제품으로 기존 MLC NAND를 활용한 SSD 대비 원가 경쟁력 확보하였으며, OEM 시장에 이어 Channel 시장 매출 확대로 SSD 수익성이 개선될 것으로 예상됨
	9) 8MP, 1/4" (90nm BSI, 1.12um, Raw Sensor)	설계 개선을 통해 원가경쟁력을 증대시킨 수익성 개선 제품으로 중국 등 Mid-end 스마트폰의 전후방 카메라와 태블릿 시장 진입으로 하반기 이후 매출 확대에 기여할 것으로 예상
	10) 2znano급 4Gb DDR3	2znano급 DRAM 제품으로 원가경쟁력 증대로 수익성 개선이 예상되며 4Gb DDR3 시장 지속 대응 예정.
	11) 1xnano급 1st UFS2.0	1xnano급 NAND를 채용한 UFS2.0 제품 개발 완료. UFS 시장 초기에 제품 출시하여 High-end 시장에서의 경쟁력 강화될 것으로 예상됨.
	12) 36단 128Gb MLC	NAND 차세대 기술로 주목받고 있는 3D 적층 기술을 적용한 자사의 첫 상용화 제품으로, 우수한 특성과 신뢰성을 가졌으며 향후 모바일 시장을 중심으로 매출에 기여할 것으로 예상됨.
	13) 1xnm급 PCIe NVMe Client SSD	PCIe NVMe 인터페이스 적용한 Client SSD 개발 완료. Client 시장이 SATA에서 NVMe 시장으로 전환되고 있어 Client 시장 점유율 확대에 기여할 것으로 기대함.
	14) 1xnm급 SATA Client SSD	1xnm급 NAND 채용한 3번째 SATA Client SSD 개발 완료. 기존 SATA 컨트롤러 대비 여러 정정능력 개선한 컨트롤러 사용. TLC NAND 비즈니스 규모 확대하여 수익성 개선될 것으로 예상함.
	15) 5MP, 1/5" (90nm BSI, 1.1	Hi-551 대비 설계 개선을 통해 원가경쟁력을 증대시킨 수익

구 분	연구과제명	기대효과
	2um, Raw Sensor)	성 개선 제품으로 중국 및 국내 Mid-end 스마트폰의 front & main 카메라 시장 진입으로 4분기부터 매출 확대 기여.

구 분	연구과제명	기대효과
제67기	1) 2x나노급 Enterprise향 SSD	자체 개발한 컨트롤러 및 펌웨어를 채용한 자사 최초 2x나노급 Enterprise향 SSD 제품으로, Power Loss Protection 기능을 탑재하여 순간적으로 전원이 차단되어도 모든 데이터를 안전하게 보호할 수 있으며, 어떠한 환경에서도 지속적인 성능 및 Latency를 유지하도록 하여 서버 시스템에 최적화 되어 있음. 향후 지속적인 성장이 예상되는 데이터 센터에 사용하는 솔루션으로 자사 SSD 사업 확대를 통한 매출 및 수익성 확보에 기여할 것으로 기대됨.
	2) 4G LPDDR2	모바일 2ynano 기술로 개발된 제품으로서 2x나노 Tech 모바일 DRAM이 사용되고 있는 시장의 Tech migration을 통한 Low cost 전략 제품임. 기존 대비 Net die 70% 증가로 매출 증대와 수익성 향상에 기여할 것으로 예상됨.
	3) 5M 1/4" (90nm, 1.40um pixel, FSI)	중국 시장에서 판매되고 있는 기존 제품 대비 수익성 증대를 위해 Net die를 11% 증가시킨 제품으로 원가 절감을 통한 제품 경쟁력 향상으로 매출과 수익성 확대에 기여할 것으로 보임.
	4) 5M 1/4" (90nm, 1.40um pixel, BSI)	중국 및 한국 시장의 중저가 스마트폰향으로 전면 및 후면 카메라에 5M 제품의 채용이 확대되고 있어 중저가폰의 고화질 제품으로의 판매 확대가 예상됨
	5) 5M 1/5" (90nm, 1.12um pixel, BSI)	5M 제품의 픽셀 크기 축소되는 추세에 맞추어 이를 적용한 제품으로서 향후 매출과 수익성 확대에 기여할 것으로 예상됨.
	6) 1x나노급 Client SSD	자사 SSD 제품에 10나노급 NAND를 채용하여 기존 20나노급 SSD 제품 대비 원가 경쟁력을 확보함으로써 수익성 향상에 기여할 것으로 기대됨.
	7) 1.0M 1/6" (90nm, 1.75um Pixel, BSI)	Notebook향 기존 제품의 원가를 개선한 제품으로 90나노 BSI Tech을 적용하여 기존 제품 대비 감도를 향상하였고 생산 효율성을 개선함으로써 향후 수익성 향상에 기여할 것으로 예상됨.
	8) 2ynm 4Gb DDR3(x16)	2014년 이후 4Gb 시장 수요 수익 창출을 위한 Embedded 향 제품 개발. 원가 경쟁력 확보하였으며 고객 Sample 조기 대응으로 Consumer, Graphics, Computing 등으로 응용처 확대가 예상되어 매출과 수익성 확대에 기여할 것으로 예상됨.

구 분	연구과제명	기대효과
	9) 2ynm 4Gb GDDR5	DRAM 2yna노 기술을 적용한 Graphic 제품으로, 2014년 4분기 이후 Graphics 시장이 2Gb에서 4Gb로 전환되는 상황에서 생산 효율화를 통한 수익성 향상에 기여할 것으로 예상됨.
	10) 2ynm 8Gb LPDDR4	Mobile 2yna노 기술로 개발된 차세대 Mobile DRAM 제품으로서 고사양 smartphone 및 tablet 시장의 12.8GB/s 이상 High bandwidth를 요구하는 제품에 채용 예정임. Mobile 외 Computing향 제품에 채용될 것으로 예상되는 제품으로 향후 매출 및 수익성 확보에 기여할 것으로 예상됨
	11) 2xnm 2Gb HBM	TSV 기술 이용한 제품으로 Graphics에서 Post GDDR5 대체하는 신규 제품을 세계 최초로 개발 완료하였으며, 업계 최초 1.2V 동작 전압에서 초당 128GB 데이터 처리 가능한 고성능 제품임. 향후 HPC, Network 등 다양한 응용처로 확장되어 매출과 수익성 확대에 기여 할 것으로 보임.
	12) 5M, 1/4" (90nm, 1.40um Pixel, SoC)	5M SoC 첫 제품으로서 보급형 스마트폰 시장을 목표로 개발된 제품으로 중국 시장에 진입 매출 확대에 기여할 것으로 기대됨.
	13) 2ynm 6Gb LPDDR4	Mobile 2yna노 기술로 개발된 차세대 Mobile DRAM 제품으로 고사양 스마트폰 및 태블릿향 제품 중 3GB를 요구하는 제품에 채용될 것으로 예정으로 LPDDR4 초기 시장 진입에 기여할 것으로 예상됨
	14) 2ynm 4Gb LPDDR3	미세공정전환을 통한 수익성 개선 제품으로 mid-end 급 Smartphone 向 위주로 Buisiness 전개 예상 됨.
	15) 2ynm 8Gb DDR4	8Gb Base로 개발된 DRAM 2ynm DDR4 제품으로 Premium Server 시장 선도를 위해 전략적으로 개발되었으며 TSV 및 3DS 패키징 기술력을 바탕으로 주요 고객사에 인증이 완료되었음.
	16) 2ynm 4Gb DDR4	DRAM 2yna노 기술로 개발된 DDR4 제품으로 Intel Broadwell System 기반 DDR4 Server 수요 증가 및 고객 채용을 예상하며 15년 이후 DDR4 초기 시장을 선점하여 DRAM 매출 및 수익성 확보에 기여할것으로 예상됨.
	17) 1xnm 64Gb MLC	기존 1yna노 제품의 원가경쟁력을 강화한 제품으로 Wafer 1장당 얻을 수 있는 Chip수를 개선하였음에도 불구하고 특성과 신뢰성이 개선하여 매출증대에 큰 기여를 할 것으로 예상됨
	18) 1xnm 128Gb TLC	자사 최초의 TLC 제품으로 1yna노 기술을 기반으로 개발됨

구 분	연구과제명	기대효과
		. 동일 Cell에 3bit를 저장하는 방식으로 기존의 2bit를 저장 하던 MLC 대비 높은 Bit growth를 실현한 제품으로 원가경쟁력 향상에 크게 기여할 것으로 기대됨.
	19) 1xnm 2nd Client SSD	1x나노급 NAND를 채용한 자사 SATA Controller 탑재 SSD 제품으로 고용량 NAND를 채용하여 1T이상의 SSD 시장 대응이 가능하며, 주요 OEM 고객 인증으로 매출 및 수익성 확보에 기여 할 것으로 예상됨
	20) 3D 1st 128Gb MLC	공정 미세화 한계 극복하고자 3차원 구조로 Cell 적층하는 기술 적용한 자사 첫 제품이며, 기존 2차원 구조 대비 높은 신뢰성과 특성을 가진 3D 시장진입의 교두보 확보할 수 있는 기술을 확보하였다는 의미가 있음.

11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 최근 3년간 신용등급

[국내]

평가일	평가대상 유가증권 등	신용등급	평가회사	신용평가 등급범위	평가구분
14.05.30	회사채	A+	한기평	AAA~D	정기평가
14.06.18	회사채	A+	한신평	AAA~D	정기평가
14.06.20	회사채	A+	NICE신평	AAA~D	정기평가
14.06.19	기업어음	A1	한기평	A1~D	본평가
14.06.18	기업어음	A1	한신평	A1~D	본평가
14.06.20	기업어음	A1	NICE신평	A1~D	본평가
14.12.12	기업어음	A1	한기평	A1~D	정기평가
14.12.18	기업어음	A1	한신평	A1~D	정기평가
14.11.13	기업어음	A1	NICE신평	A1~D	정기평가
15.05.27	회사채	AA-	한기평	AAA~D	정기평가
15.05.27	회사채	AA-	한신평	AAA~D	정기평가
15.05.28	회사채	AA-	NICE신평	AAA~D	정기평가
15.06.25	기업어음	A1	한기평	A1~D	본평가
15.06.25	기업어음	A1	한신평	A1~D	본평가
15.06.26	기업어음	A1	NICE신평	A1~D	본평가
15.08.13	회사채	AA-	한기평	AAA~D	본평가
15.08.13	회사채	AA-	한신평	AAA~D	본평가
15.08.13	회사채	AA-	NICE신평	AAA~D	본평가

평가일	평가대상 유가증권 등	신용등급	평가회사	신용평가 등급범위	평가구분
15.11.13	기업어음	A1	한기평	A1~D	정기평가
15.11.13	기업어음	A1	한신평	A1~D	정기평가
15.11.13	기업어음	A1	NICE신평	A1~D	정기평가
15.11.13	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	본평가
15.11.13	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	본평가
15.11.13	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	본평가
16.02.03	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	본평가
16.02.04	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	본평가
16.02.04	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	본평가
16.05.17	기업어음	A1	한기평	A1~D	본평가
16.05.16	기업어음	A1	한신평	A1~D	본평가
16.05.17	기업어음	A1	NICE신평	A1~D	본평가
16.05.17	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	본평가
16.05.16	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	본평가
16.05.17	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	본평가
16.12.15	기업어음	A1	한기평	A1~D	정기평가
16.12.08	기업어음	A1	한신평	A1~D	정기평가
16.12.16	기업어음	A1	NICE신평	A1~D	정기평가
17.05.19	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	정기평가
17.06.08	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	정기평가
17.06.30	회사채	AA-	NICE신평	AAA ~ D	정기평가
17.11.07	회사채	AA-	한신평	AAA ~ D	수시평가
17.11.09	회사채	AA-	한기평	AAA ~ D	수시평가

[해 외]

평가일	평가대상 유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사	신용평가등급 범위	평가구분
14.11.21	발행회사	BB+	S & P	AAA ~ D	수시평가
14.12.12	발행회사	Ba1	Moody's	Aaa ~ C	수시평가
16.05.13	발행회사	BB+	S & P	AAA ~ D	수시평가
16.11.07	발행회사	Ba1	Moody's	Aaa ~ C	수시평가
17.01.20	발행회사	BBB-	S & P	AAA ~ D	수시평가
17.11.06	발행회사	Baa3	Moody's	Aaa ~ C	수시평가

[참고] 국내 신용평가사 (NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가) 등급정의

신용등급	등급의 정의
AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준임

신용등급	등급의 정의
AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있음
A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음
BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있음
BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음
B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적임
CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있음
CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높음
C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높음
D	현재 채무불이행 상태에 있음

※ AA ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-"기호를 부여함.

[참고] 국내 신용평가사(NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가) 기업어음의 등급정의

신용등급	등급의 정의
A1	적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임
A2	적기상환능력이 우수하나, 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임
A3	적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임
B	적기상환능력이 적정시되나, 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음
C	적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼
D	상환 불능상태임

※ A2 ~ B등급까지는 상대적 우열에 따라 "+" 또는 "-"기호를 부여함.

[참고] 해외 신용평가사 Moody's 등급 정의

신용등급	등급의 정의
Aaa	최소한의 신용 리스크를 보이며, 최고의 신용상태를 가진 것으로 판단됨.
Aa	신용상태가 우수한 것으로 판단되며 신용리스크가 매우 낮음.
A	중상위 등급으로 간주되며 신용 리스크가 낮음.
	신용 리스크가 보통 수준임. 이들은 중위 등급으로 간주되며 그에 따라 일부

신용등급	등급의 정의
Baa	투기적 특징을 가질 수 있음.
Ba	투기적 요소가 있는 것으로 판단되며 신용 리스크가 상당한 수준임.
B	투기적인 것으로 간주되며 신용 리스크가 높음.
Caa	신용상태가 불량한 것으로 판단되며 신용 리스크가 매우 높음.
Ca	투기성이 매우 높고 부도상태이거나 부도에 매우 근접해 있을 가능성이 높으며 원리금 회수 가능성이 어느 정도 있음.
C	채권의 최하 등급. 일반적으로 부도상태이고 원리금 회수 가능성이 거의 없음.

※ Aa부터 Caa까지 각 일반 등급 분류에 1,2,3의 숫자를 부여함. 숫자 1은 해당 등급 분류 내에서 상위에 있음을, 숫자 2는 중위에, 숫자 3은 하위에 있음을 나타냄.

[참고] 해외 신용평가사 S&P 등급 정의

신용등급	등급의 정의
AAA	채무상환능력이 극히 높음. 최상 등급임.
AA	채무상환능력이 매우 높음, 상위 등급과 크게 차이는 없으나 최고 수준은 아님.
A	채무상환능력이 높음, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움.
BBB	채무상환능력은 충분하나, 상위 등급의 기업에 비해서는 경기침체와 시장환경변화의 영향을 받기 쉬움.
BB	가까운 장래에 채무불이행이 발생할 가능성은 비교적 적으나, 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 충분히 고려됨
B	현재로서는 채무상환능력이 있으나, 상위 등급의 기업에 비해 경영상태, 재무상황, 경제상황이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 높음.
CCC	현재 채무불이행 가능성이 있으며, 채무이행 능력은 경영, 재무, 경제 상황이 호의적일 경우에만 있다고 보여짐.
CC	채무불이행 가능성이 현재로서 상당히 높음.
D	채무만기시 1건 이상의 채무를 상환하지 못한 기업을 의미함.

※ AA등급에서 CCC등급까지는 해당 등급에서의 상대적인 위치에 따라 '+', '-'를 추가로 부여할 수 있음.

나. 회사의 고객관리 정책

당사는 IT 산업을 대표하는 글로벌 기업으로서 당사 매출기여도가 매우 높고 당사 판매 전략과 부합하는 고객을 '전략 고객(Strategic Account, S/A)'으로 정하여 관리하고 있습니다. 당사의 S/A 고객은 본 보고서 작성일 현재 총 15개사로 각 응용 분야별 전략 고객의

관리를 통하여 안정적인 매출 기반을 확보함은 물론 제품 구성을 다양화하여 수익성을 극대화하고 있습니다.

다. 지식재산권 보유현황

2017년 9월 30일 현재 당사는 반도체와 관련하여 총 12,183건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록권리는 해마다 증가하나, 매분기 기등록된 권리를 평가하여 등록유지 또는 포기여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 변동할 수 있습니다.

당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담조직에 의해 관리되고 있으며, 당해 전문인력은 지식재산권 개발, 출원/등록 및 사후관리 및 관련 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다.

특허권 및 상표권은 각국 특허법 및 상표법에 근거하여 보호되고 있습니다. 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이고, 상표권은 등록일로부터 10년이며 상표권은 갱신등록절차를 통해 존속기한을 연장할 수 있습니다.

라. 정부나 지방자치단체의 법률 규정 등에 의한 규제사항

'산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 제11조'에 의하여 국가핵심기술로 지정된 반도체 제조기술을 해외로 이전하는 경우, 수출자는 산업통상자원부에 신고할 의무를 지고 있습니다. 이에 당사는 제품개발 경쟁력 강화를 위한 해외 생산공장 및 기술센터에 반도체 기술 이전 시 관련법 및 절차를 준수 이행하고 있습니다.

마. 환경보호 정책 및 현황

(1) SHE경영시스템 인증

당사는 국제 인증규격인 OHSAS18001(안전보건경영시스템) 및 ISO14001(환경경영시스템)과 국내인증규격인 KOSHA18001(안전보건경영시스템)을 취득하여 유지관리 하고 있으며, 이를 통해 SHE 경영활동의 객관성 확보 및 효과를 극대화하기 위한 활동들을 수행하고 있습니다. SHE 경영시스템 내부 전문심사원을 양성하여 기업활동으로 인해 발생하는 환경안전보건 영향요인을 모니터링 하고, 또한 이를 효율적으로 관리하기 위해 전담조직을 구성하여 체계적으로 관리하고 있습니다.

당사는 환경 및 안전보건 분야의 지속적인 개선을 추구하며, 환경영향을 최소화하고 건강하고 안전한 사업장을 구축하기 위한 노력을 지속적으로 수행해 나갈 것입니다.

(2) 기후변화 협약 대응

당사는 기후변화와 관련된 유무형의 위험과 기회 관리를 위해 기후변화 관련 규제를 준수하며 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한 기후변화로 인해 발생할 수 있는 비용 및 제품 품질 관리를 위한 전략을 마련하고 고객 및 정부의 신뢰도를 지속적으로 확보하여 환경에 대한 새로운 가치를 창출할 수 있도록 전사적 수준의 대응을 하고 있습니다.

[온실가스 배출권거래제 대응]

SK하이닉스는 2015년부터 시행되고 있는 온실가스 배출권거래제에서 할당된 목표량을 달성하기 위해 온실가스 저감 활동을 펼치고 있습니다. 온실가스 배출권거래제는 정부가 각 기업에게 온실가스를 배출할 수 있는 배출권을 부여하고 기업들은 시장원리에 의해 형성된 배출권 가격을 토대로 각 기업별 한계저감비용에 따라 배출권을 매입하거나 매도하는 제도입니다. SK하이닉스는 배출권 부족분(초과 배출량)의 구매 비용을 최소화하기 위해 온실가스 저감장치(스크러버) 측정 기술을 개발/운영하여 배출량 저감을 유도하고 있으며, 배출권 거래를 포함한 배출권 관리, 배출권 감축 등의 전사 TF 활동을 추진하고 있습니다.

[CDP(탄소정보 공개 프로젝트) 탄소경영 최우수기업 5년 연속 선정, 명예의 전당 입성]

당사는 탄소정보 공개 프로젝트(CDP: Carbon Disclosure Project) 한국위원회가 선정하는 탄소경영 최우수 그룹인 '탄소경영 글로벌 리더스 클럽'에 5년 연속 편입되어 국내 최초, 국내 유일 기업으로 명예의 전당에 입성하였습니다.

(3) 친환경제품을 위한 노력

[전과정 평가(Life Cycle Assessment, LCA)/Eco-efficiency/탄소성적]

당사는 매년 DRAM 및 NAND Flash 메모리의 주요 제품에 대하여 전과정평가를 수행하고 있습니다. 회사는 2013년 환경부로부터 20나노급 4G DDR3 제품에 대하여 업계 최초 환경성적표지 인증을 획득하였으며, 2014년에는 20나노급 64Gb NAND Flash 제품까지 인증을 확대 하는 등 지속적으로 LCA 평가결과에 대한 제 3자 인증을 확대하고 있습니다. 특히 2016년에는 국내 최초로 20나노급 4Gb DDR3 제품에 대하여 미국 UL社로부터 물 발자국 인증을 획득하였습니다. 2017년에는 정부에서 주도하는 물발자국 시범사업에 참여하여 8Gb LPDDR3 제품을 통해 반도체 최초인증 추진하고 있습니다. 이번 물발자국 인증 뿐만 아니라 향후 지속적인 추진을 통해 단계적으로 인증 제품을 확대하여 SK hynix의 대표적인 모든 제품군에 대해 물발자국 인증을 받을 수 있도록 할 계획입니다.

또한, 당사는 2009년부터 환경부 탄소성적표지 인증 제품을 매년 확대하고 있습니다. 특히, 2016년 SSD 128GB 제품으로 SSD분야의 최초 인증을 획득하였으며, 2017년에는 8Gb DDR4, 8Gb LPDDR3 제품으로 탄소성적표지 인증을 추진하고 있습니다.

(4) 기타 환경보호 정책

2009년 5월, 환경경영에 대한 투명성 및 진정성을 확보하기 위해 국내 대표적 NGO인 환경운동연합 및 환경경영 전문가로 환경경영검증위원회를 구성하여, 당사 환경경영성과에 대한 검증을 진행하고 그 결과를 환경경영검증위원회 보고서로 발행하였습니다.

2010년도 부터는 검증위원회에서 자문위원회로 변경, 환경경영자문위원회를 개최하여 오고 있으며, 당사의 전반적인 환경경영 및 환경전략관련 의견을 수렴 후, 경영활동에 반영하고 있습니다. 또한 2015년도에는 외부 전문가로 구성된 산업보건검증위원회를 발족하여 당사의 작업환경 및 복지제도 등 보건분야 진단을 통해 127개 개선과제를 도출하였고 현재 검증위 개선과제 127개 중 123건을 완료하였으며, 잔여 4개 과제는 2017년내 완료를 목표로 진행중에 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 :백만원)

구 분	제70기 3분기	제69기	제68기
[유동자산]	14,557,910	9,838,982	9,760,030
· 현금및현금성자산	1,123,119	613,786	1,175,719
· 단기금융상품	5,191,503	3,521,893	3,615,554
· 매출채권	5,260,576	3,251,652	2,628,448
· 재고자산	2,557,403	2,026,198	1,923,376
· 기타	425,309	425,453	416,933
[비유동자산]	26,172,543	22,377,044	19,917,876
· 관계기업 및 조인트벤처투자	376,459	131,016	122,609
· 매도가능금융자산	55,378	147,779	131,354
· 유형자산	21,977,158	18,777,402	16,966,252
· 무형자산	2,236,944	1,915,591	1,704,896
· 기타	1,526,604	1,405,256	992,765
자산총계	40,730,453	32,216,026	29,677,906
[유동부채]	5,642,787	4,160,849	4,840,698
[비유동부채]	4,183,168	4,031,647	3,449,505
부채총계	9,825,955	8,192,496	8,290,203
[지배기업 소유주지분]	30,896,683	24,016,955	21,386,863
· 자본금	3,657,652	3,657,652	3,657,652
· 자본잉여금	4,143,736	4,143,736	4,143,736
· 기타포괄손익누계액	(184,564)	(79,103)	(1,600)
· 기타자본항목	(771,365)	(771,913)	(771,913)
· 이익잉여금	24,051,224	17,066,583	14,358,988
[비지배지분]	7,815	6,575	840
자본총계	30,904,498	24,023,530	21,387,703
매출액	21,081,881	17,197,975	18,797,998
영업이익	9,255,492	3,276,746	5,336,100
연결총당기순이익	7,422,719	2,960,483	4,323,595
지배기업의 소유주지분	7,420,763	2,953,774	4,322,356
비지배지분	1,956	6,709	1,239
기본주당순이익	10,511 원	4,184 원	6,002원
연결에 포함된 회사수	24개사	23개사	22개사

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

※ 제70기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2017년 9월 30일 기준이며, 포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2017년

9월 30일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.
 ※ MMT 특정금전신탁은 연결에 포함된 회사수에서 제외하였습니다.

나. 요약 별도재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제70기 3분기	제69기	제68기
[유동자산]	11,898,210	7,933,301	8,421,984
· 현금및현금성자산	776,764	476,917	1,014,939
· 단기금융상품	3,719,294	2,487,942	2,808,102
· 매출채권	4,941,262	2,896,443	2,800,904
· 재고자산	2,116,207	1,698,723	1,407,614
· 기타	344,683	373,276	390,425
[비유동자산]	27,765,547	23,465,792	20,320,214
· 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	5,439,803	4,588,062	4,229,002
· 매도가능금융자산	51,208	143,590	130,645
· 유형자산	19,144,987	16,071,281	13,853,549
· 무형자산	1,885,342	1,546,733	1,299,257
· 기타	1,244,207	1,116,126	807,761
자산총계	39,663,757	31,399,093	28,742,198
[유동부채]	5,599,302	4,351,661	4,750,892
[비유동부채]	4,160,080	3,955,919	3,308,841
부채총계	9,759,382	8,307,580	8,059,733
[자본금]	3,657,652	3,657,652	3,657,652
[자본잉여금]	4,183,564	4,183,564	4,182,016
[기타포괄손익누계액]	-	-	-
[기타자본항목]	(771,365)	(771,913)	(771,913)
[이익잉여금]	22,834,524	16,022,210	13,614,710
자본총계	29,904,375	23,091,513	20,682,465
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
매출액	20,827,540	16,733,111	18,780,792
영업이익	9,001,128	3,012,419	5,076,507
당기순이익	7,248,436	2,655,022	4,019,080
기본주당순이익	10,267원	3,761 원	5,581 원

※ 한국채택국제회계기준에 따라 별도기준으로 작성되었습니다.
 ※ 제70기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2017년 9월 30일 기준이며, 포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2017년 9월 30일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 70 기 3분기말 2017.09.30 현재

제 69 기말 2016.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 70 기 3분기말	제 69 기말
자산		
유동자산	14,557,910	9,838,982
현금및현금성자산	1,123,119	613,786
단기금융상품	5,191,503	3,521,893
매출채권	5,260,576	3,251,652
기타수취채권	34,943	25,611
재고자산	2,557,403	2,026,198
당기법인세자산	1,665	489
기타유동자산	388,701	399,353
비유동자산	26,172,543	22,377,044
관계기업 및 공동기업투자	376,459	131,016
비유동매도가능금융자산	55,378	147,779
기타수취채권	43,066	39,490
기타금융자산	595	423
유형자산	21,977,158	18,777,402
무형자산	2,236,944	1,915,591
투자부동산	2,494	2,573
이연법인세자산	781,408	792,368
기타비유동자산	699,041	570,402
자산총계	40,730,453	32,216,026
부채		
유동부채	5,642,787	4,160,849

	제 70 기 3분기말	제 69 기말
매입채무	745,056	696,144
단기미지급금	1,501,816	1,606,417
기타지급채무	1,034,172	685,154
차입금	633,151	704,860
기타금융부채	0	288
총당부채	66,622	42,822
당기법인세부채	1,620,360	374,666
기타유동부채	41,610	50,498
비유동부채	4,183,168	4,031,647
기타지급채무	3,478	27,426
장기차입금	3,670,387	3,631,118
확정급여부채	441,614	306,488
이연법인세부채	5,156	4,732
기타비유동부채	62,533	61,883
부채총계	9,825,955	8,192,496
자본		
지배기업의 소유지분	30,896,683	24,016,955
자본금	3,657,652	3,657,652
자본잉여금	4,143,736	4,143,736
기타자본	(771,365)	(771,913)
기타포괄손익누계액	(184,564)	(79,103)
이익잉여금	24,051,224	17,066,583
비지배지분	7,815	6,575
자본총계	30,904,498	24,023,530
자본과부채총계	40,730,453	32,216,026

연결 포괄손익계산서

제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 70 기 3분기		제 69 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	8,100,085	21,081,881	4,243,645	11,840,289
매출원가	3,398,157	9,241,783	2,792,288	7,819,077
매출총이익	4,701,928	11,840,098	1,451,357	4,021,212
판매비와관리비	964,735	2,584,606	725,401	2,280,605
영업이익	3,737,193	9,255,492	725,956	1,740,607
금융수익	252,745	750,110	235,662	623,886
금융비용	159,536	739,685	243,216	690,151
지분법투자관련 손익	3,524	8,027	2,419	16,600
기타영업외수익	24,472	62,695	10,869	24,869
기타영업외비용	15,542	54,320	27,526	70,449
법인세비용차감 전순이익	3,842,856	9,282,319	704,164	1,645,362
법인세비용	787,327	1,859,600	106,413	313,453
당기순이익	3,055,529	7,422,719	597,751	1,331,909
법인세차감후 기 타포괄손익	84,920	(118,698)	(293,993)	(361,532)
확정급여제도 의 재측정요소	(4,210)	(12,521)	(2,161)	(6,436)
해외사업장환 산외환차이(세후 기타포괄손익)	86,708	(101,252)	(285,079)	(347,977)
관계기업의 기 타포괄손익에 대 한 지분	2,422	(4,925)	(6,753)	(7,119)
총포괄이익	3,140,449	7,304,021	303,758	970,377
당기순이익의 귀				

	제 70 기 3분기		제 69 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
속				
지배기업의 소유주지분	3,054,248	7,420,763	596,774	1,327,109
비지배지분	1,281	1,956	977	4,800
총 포괄손익의 귀속				
지배기업의 소유주지분	3,139,284	7,302,781	303,475	966,382
비지배지분	1,165	1,240	283	3,995
주당이익				
기본주당순이익	4,326	10,511	845	1,880
희석주당순이익	4,326	10,511	845	1,880

연결 자본변동표

제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	자본							
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계		
2016.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,143,736	(771,913)	(1,600)	14,358,988	21,386,863	840	21,387,703
당기순이익					1,327,109	1,327,109	4,800	1,331,909
확정급여제도의 재측정요소					(6,436)	(6,436)		(6,436)
기타포괄손익				(7,119)		(7,119)		(7,119)
환율변동				(347,172)		(347,172)	(805)	(347,977)
총포괄손익 합계				(354,291)	1,320,673	966,382	3,995	970,377
배당금지급					353,001	353,001		353,001
자기주식 거래로 인한 증감				390		390	(889)	(499)
주식선택권 부여								0
2016.09.30 (기말자본)	3,657,652	4,143,736	(771,913)	(355,501)	15,326,660	22,000,634	3,946	22,004,580
2017.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,143,736	(771,913)	(79,103)	17,066,583	24,016,955	6,575	24,023,530
당기순이익					7,420,763	7,420,763	1,956	7,422,719
확정급여제도의 재측정요소					(12,521)	(12,521)		(12,521)
기타포괄손익				(4,925)		(4,925)		(4,925)
환율변동				(100,536)		(100,536)	(716)	(101,252)
총포괄손익 합계				(105,461)	7,408,242	7,302,781	1,240	7,304,021
배당금지급					423,601	423,601		423,601
자기주식 거래로 인한 증감								0
주식선택권 부여			548			548		548

	자본							
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계		
2017.09.30 (기말자본)	3,657,652	4,143,736	(771,365)	(184,564)	24,051,224	30,896,683	7,815	30,904,498

연결 현금흐름표

제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 70 기 3분기	제 69 기 3분기
영업활동현금흐름	9,904,080	3,569,159
영업으로부터 창출된 현금흐름	10,572,132	4,512,315
이자의 수취	22,329	36,356
이자의 지급	(92,061)	(97,338)
배당금의 수취	(613,161)	20,744
법인세의 납부	14,841	(902,918)
투자활동현금흐름	(9,048,646)	(3,629,309)
단기금융상품의 감소	4,068,413	5,253,772

	제 70 기 3분기	제 69 기 3분기
단기금융상품의 증가	(5,726,559)	(4,001,673)
기타수취채권의 감소	14,171	10,590
기타수취채권의 증가	(17,568)	(10,376)
매도가능금융자산의 처분	1,916	2,294
매도가능금융자산의 취득	(21,798)	(16,323)
기타금융자산의 감소	1	0
기타금융자산의 취득	(168)	0
파생상품거래로 인한 현금 유입	902	876
파생상품거래로 인한 현금 유출	(1,201)	(1,218)
유형자산의 처분	221,136	109,806
유형자산의 취득	(6,852,671)	(4,600,747)
무형자산의 처분	985	1,577
무형자산의 취득	(622,245)	(375,594)
관계기업투자의 취득	(113,960)	(2,293)
재무활동현금흐름	(362,299)	135,246
차입금의 차입	752,944	2,081,562
차입금의 상환	(691,642)	(1,593,315)
배당금의 지급	(423,601)	(353,001)
현금및현금성자산의 환율변 동효과	16,198	(36,112)
현금및현금성자산의 순증감	509,333	38,984
기초 현금및현금성자산	613,786	1,175,719
기말 현금및현금성자산	1,123,119	1,214,703

3. 연결재무제표 주석

제 70 기 3분기 2017년 9월 30일 현재
제 69 기 3분기 2016년 9월 30일 현재

에스케이하이닉스 주식회사와 그 종속기업

1. 회사의 개요

(1) 지배기업의 개요

에스케이하이닉스 주식회사(이하 "지배기업")는 1996년에 주식을 한국거래소에 상장한 공개법인으로, 1949년 10월 15일에 설립되어 메모리반도체의 제조 및 판매업을 주업으로 하고 있습니다. 지배기업은 경기도 이천시 부발읍 경춘대로 2091에 본사와 경기도 성남시 등에 사무소를 두고 있습니다. 지배기업과 그 종속기업(이하 "연결실체")은 경기도 이천시와 충청북도 청주시, 중국 우시(Wuxi)와 충칭(Chongqing)에 생산공장을 설치·가동하고 있습니다.

한편, 2017년 9월 30일 현재 지배기업의 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분	소유주식수(주)	지분율(%)
SK텔레콤(주)	146,100,000	20.07
주식관리협의회(*):		
하나은행	4,707,573	0.65
국민연금공단 및 기타주주	555,194,222	76.26
자기주식	22,000,570	3.02
합 계	728,002,365	100.00

(*) SK텔레콤(주)가 주식관리협의회와 2011년 11월 14일에 체결한 에스케이하이닉스 주식회사 주식매매계약에 의하여 주식관리협의회는 거래종결일(2012년 2월 14일) 이후 잔여 주식을 보유하는 동안 지배기업의 이사 및 감사의 선임에 관하여 SK텔레콤(주)의 의사에 따라 의결권을 행사하여야 합니다.

또한, 주식관리협의회는 동 주식에 대한 의결권을 행사함에 있어서 직접적인 이해관계가 없는 안건에 대하여 합리적으로 거부할 만한 사유가 없는 한 SK텔레콤(주)의 의사에 따라 의결권을 행사하여야 합니다.

한편, 당분기말 현재 지배기업의 주식은 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에, 주식예탁증서는 록셈부르크 증권거래소에 상장되어 있습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명	소재지	주요영업활동	결산월	소유지분율(%)	
				당분기말	전기말
에스케이하이이엔지(주)	국 내	사업지원 및 서비스	12월	100	100
에스케이하이시스템(주)	국 내	사업지원 및 공사 등	12월	100	100
(주)실리콘화일	국 내	전자·전기부품 개발 및 제조	12월	100	100
행복모아(주)	국 내	사업지원 및 제조	12월	100	100
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)(*1)	국 내	파운드리 사업	12월	100	-
SK hynix America Inc.(SK-HYA)	미 국	해외판매법인	12월	97.74	97.74
SK hynix Deutschland GmbH(SK-HYD)	독 일	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix U.K. Ltd.(SK-HYU)	영 국	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Asia Pte. Ltd.(SK-HYS)	싱가포르	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.(SK-HYS)(*2)	인 도	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.(SK-HYH)	홍 콩	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.(SK-HYCS)	중 국	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Japan Inc.(SK-HYJ)	일 본	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SK-HYT)	대 만	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SK-HYCL)	중 국	해외제조법인	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SK-HYMC)	중 국	해외제조법인	12월	100	100
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.(SK-HYCW)	중 국	해외판매법인	12월	100	100
SK hynix Italy S.r.l.(SK-HYT)	이탈리아	해외연구개발법인	12월	100	100
SK hynix memory solutions Inc.(SK-HMS)	미 국	해외연구개발법인	12월	100	100
SK hynix Flash Solution Taiwan(SK-HYFST)	대 만	해외연구개발법인	12월	100	100
SK APTECH Ltd.(SKAPTECH)	홍 콩	지주회사	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.(SK-HYQCL)(*3)	중 국	해외제조법인	12월	100	100
Soiteq Flash Solutions LLC.(SOFTEQ)	벨라루스	해외연구개발법인	12월	100	100
SK hynix Ventures Hong Kong Limited(SKH Ventures)	홍 콩	해외투자법인	12월	100	100
MMT(특정금전신탁)	국 내	특정금전신탁	12월	100	100

(*1) 당분기 중 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)를 설립하였습니다.

(*2) 종속기업인 SK hynix Asia Pte. Ltd.(SKHYS)의 종속기업입니다.

(*3) 종속기업인 SK APTECH Ltd.(SKAPTECH)의 종속기업입니다.

(3) 당분기 중 연결대상 종속기업의 변동내역은 다음과 같습니다.

구분	기업명	사유
신규설립	에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)	신규 설립에 따른 종속기업 편입

(4) 당분기말과 전기말 현재 주요 종속기업의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
종속기업명	당분기말			전기말		
	총자산	총부채	총자본	총자산	총부채	총자본
SK hynix America Inc.(SK-HYA)	2,501,072	2,141,640	359,432	1,584,043	1,279,493	304,550
SK hynix Asia Pte. Ltd.(SK-HYS)	680,548	599,452	81,096	337,506	253,918	83,588
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.(SK-HYH)	1,242,854	1,116,148	126,706	932,437	810,556	121,881
SK hynix Japan Inc.(SK-HYJ)	466,423	401,017	65,406	251,274	184,504	66,770
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SK-HYT)	446,892	445,230	1,662	310,933	290,174	20,759
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SK-HYCL)	3,504,997	222,895	3,282,102	3,476,086	232,117	3,243,969
SK hynix Deutschland GmbH(SK-HYD)	101,859	59,734	42,125	83,388	45,575	37,813
SK hynix U.K. Ltd.(SK-HYU)	317,106	302,537	14,569	146,327	128,807	17,520
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.(SK-HYQQL)	373,330	180,267	193,063	350,305	171,088	179,217

(5) 당분기와 전분기 중 주요 종속기업의 요약 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
종속기업명	당분기			전분기		
	매출액	분기순손익	총포괄손익	매출액	분기순손익	총포괄손익
SK hynix America Inc.(SK-HYA)	7,616,352	69,963	69,963	3,446,475	24,221	24,221
SK hynix Asia Pte. Ltd.(SK-HYS)	1,895,313	1,743	1,743	1,089,957	2,718	2,718
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.(SK-HYH)	6,656,870	11,850	11,850	3,845,154	18,530	18,530
SK hynix Japan Inc.(SK-HYJ)	666,189	(307)	(307)	518,388	(2,200)	(2,200)
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SK-HYT)	1,930,326	(16,551)	(16,551)	1,290,825	546	546
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SK-HYCL)	1,630,954	53,631	53,631	1,611,836	79,377	79,377
SK hynix Deutschland GmbH(SK-HYD)	356,401	1,718	1,718	225,617	355	355
SK hynix U.K. Ltd.(SK-HYU)	779,432	(2,040)	(2,040)	368,620	3,371	3,371
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.(SK-HYQQL)	254,625	14,375	14,375	218,002	4,917	4,917

(6) 당분기말과 전기말 현재 연결실체에 대한 중요한 비지배지분은 없습니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

연결실체의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 연결중간 재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2016년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3. 유의적인 회계정책

연결실체는 2016년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.

4. 영업부문

연결실체는 반도체 제품의 제조 및 판매의 단일영업부문으로 구성되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업전략을 수립하는 과정에서 검토되는 보고정보에 반도체사업 부문의 성과를 검토하고 있습니다.

(1) 당분기와 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
제품의 판매	8,077,799	21,028,014	4,232,760	11,806,569
용역의 제공	22,286	53,867	10,885	33,720
합 계	8,100,085	21,081,881	4,243,645	11,840,289

(2) 당분기와 전분기 중 매출액의 품목별 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
DRAM	6,262,013	15,996,044	2,918,998	8,478,980
NAND Flash	1,683,190	4,678,746	1,191,994	2,997,327
기 타	154,882	407,091	132,653	363,982
합 계	8,100,085	21,081,881	4,243,645	11,840,289

(3) 당분기와 전분기 중 지역별(법인소재지 기준) 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
국 내	272,769	907,950	263,559	812,892
중 국	2,559,772	6,977,013	1,426,879	4,107,324
대 만	662,243	1,928,781	420,706	1,282,725
아시아(중국, 대만제외)	1,021,771	2,558,695	559,272	1,603,337
미 국	3,161,812	7,575,610	1,384,577	3,442,420
유 럽	421,718	1,133,832	188,652	591,591
합 계	8,100,085	21,081,881	4,243,645	11,840,289

(4) 당분기말과 전기말 현재 지역별 비유동자산(금융상품, 기타수취채권, 관계기업 및 공동기업투자, 이연법인세자산 제외)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
국 내	21,702,767	18,078,337
중 국	2,858,151	2,805,712
대 만	5,849	6,835
아시아(중국, 대만제외)	1,261	1,522
미 국	338,449	364,188
유 럽	9,160	9,374
합 계	24,915,637	21,265,968

(5) 당분기와 전분기 중 단일 외부고객으로부터의 매출액이 연결실체 전체 매출액의 10%를 상회하는 고객 (가)와 (나)로부터 발생한 매출액은 각각 2,707,017백만원(전기: 1,189,485백만원)과 2,580,512백만원(전기: 1,061,999백만원)입니다.

5. 금융상품의 범주별 분류

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)				
구 분	당기손익인식 금융자산	매도가능 금융자산	대여금및 수취채권	합 계
현금및현금성자산	-	-	1,123,119	1,123,119
단기금융상품	2,237,593	-	2,953,910	5,191,503
매출채권	-	-	5,260,576	5,260,576
기타수취채권	-	-	78,009	78,009
기타금융자산	-	-	595	595
매도가능금융자산	-	55,378	-	55,378
합 계	2,237,593	55,378	9,416,209	11,709,180

② 전기말

(단위: 백만원)				
구 분	당기손익인식 금융자산	매도가능 금융자산	대여금및 수취채권	합 계
현금및현금성자산	-	-	613,786	613,786
단기금융상품	1,570,172	-	1,951,721	3,521,893
매출채권	-	-	3,251,652	3,251,652
기타수취채권	-	-	65,101	65,101
기타금융자산	-	-	423	423
매도가능금융자산	-	147,779	-	147,779
합 계	1,570,172	147,779	5,882,683	7,600,634

(2) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	당기손익인식금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	합 계
매입채무	-	745,056	745,056
미지급금	-	1,501,816	1,501,816
기타지급채무(*)	-	1,037,650	1,037,650
차입금	-	4,303,538	4,303,538
합 계	-	7,588,060	7,588,060

② 전기말

(단위: 백만원)			
구 분	당기손익인식금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	합 계
매입채무	-	696,144	696,144
미지급금	-	1,606,417	1,606,417
기타지급채무(*)	-	712,580	712,580
차입금	-	4,335,978	4,335,978
기타금융부채	288	-	288
합 계	288	7,351,119	7,351,407

(*) 당분기말과 전기말 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미지급비용	1,034,172	685,154
비유동:		
임대보증금	3,478	2,554
장기미지급금	-	24,872
소 계	3,478	27,426
합 계	1,037,650	712,580

6. 금융위험관리

(1) 금융위험관리

연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2016년 12월 31일의 연차연결재무제표를 참고하시기 바랍니다. 연결실체의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

① 시장위험

(가) 환율변동위험

연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당분기말 현재 연결실체의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	자 산		부 채	
	외화금액	원화환산	외화금액	원화환산
USD	7,259	8,323,657	4,359	4,998,563
EUR	15	19,704	155	209,370
JPY	4,347	44,358	38,744	395,352

당분기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	10%상승시	10%하락시
USD	332,509	(332,509)
EUR	(18,967)	18,967
JPY	(35,099)	35,099

(나) 이자율위험

연결실체의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

연결실체는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시 향후 3개월간 연결실체의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자비용과 이자수익으로 인한 법인세비용차감전순이익은 각각 5,475백만원 만큼 증가 또는 감소하였을 것입니다.

(다) 가격위험

연결실체는 당분기말 현재 공정가치로 평가하는 매도가능지분상품을 보유하고 있지 않습니다. 따라서 연결실체는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있지 않습니다.

② 신용위험

신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

(가) 매출채권 및 기타수취채권

연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결실체의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있으며, 해외 거래처에 대한 신용위험과 관련하여 신용보험계약을 체결하고 있습니다. 연결실체의 신용위험 노출정도는 거래상대방별 매출채권 등의 장부금액과 동일한 금액입니다.

(나) 기타의 자산

현금및현금성자산, 단기금융상품 및 장·단기대여금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 다수의 금융기관에 현금및현금성자산과 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

③ 유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위한 필요자금을 연결실체가 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

연결실체는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.

(2) 자본관리

연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 차입금 조달 및 상환, 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
부 채 (A)	9,825,955	8,192,496
자 본 (B)	30,904,498	24,023,530
현금및현금성자산 등 (C)(*1)	6,314,622	4,135,679
차입금 (D)	4,303,538	4,335,978
부채비율 (A/B)	32%	34%
순차입금비율 (D-C)/B(*2)	-	1%

(*1) 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합계액입니다.

(*2) 당분기말 현재 순차입금비율은 부(-)의 비율로 산출되어 표시하지 않았습니다.

(3) 공정가치

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열 체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	2,237,593	-	2,237,593	-	2,237,593
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*1)	1,123,119	-	-	-	-
단기금융상품(*1)	2,953,910	-	-	-	-
매출채권(*1)	5,260,576	-	-	-	-
기타수취채권(*1)	78,009	-	-	-	-
기타금융자산(*1)	595	-	-	-	-
매도가능금융자산(*1,2)	55,378	-	-	-	-
소 계	9,471,587	-	-	-	-
금융자산 합계	11,709,180	-	2,237,593	-	2,237,593
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*1)	745,056	-	-	-	-
미지급금(*1)	1,501,816	-	-	-	-
기타지급채무(*1)	1,037,650	-	-	-	-
차입금	4,303,538	-	4,319,311	-	4,319,311
금융부채 합계	7,588,060	-	4,319,311	-	4,319,311

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	1,570,172	-	1,570,172	-	1,570,172
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*1)	613,786	-	-	-	-
단기금융상품(*1)	1,951,721	-	-	-	-
매출채권(*1)	3,251,652	-	-	-	-
기타수취채권(*1)	65,101	-	-	-	-
기타금융자산(*1)	423	-	-	-	-
매도가능금융자산(*1,2)	147,779	-	-	-	-
소 계	6,030,462	-	-	-	-
금융자산 합계	7,600,634	-	1,570,172	-	1,570,172
공정가치로 측정되는 금융부채:					
기타금융부채	288	-	288	-	288
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*1)	696,144	-	-	-	-
미지급금(*1)	1,606,417	-	-	-	-
기타지급채무(*1)	712,580	-	-	-	-
차입금	4,335,978	-	4,366,234	-	4,366,234
소 계	7,351,119	-	4,366,234	-	4,366,234
금융부채 합계	7,351,407	-	4,366,522	-	4,366,522

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

(*2) 동일한 상품(즉 수준 1의 투입변수)에 대한 활성시장에서 공시되는 가격이 없는 지분상품에 해당하여 다른 방법으로 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없으므로, 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'에 따라 원가로 측정하였습니다.

③ 가치평가기법

수준 2의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1과 수준 2 및 수준 3간의 대체는 없습니다.

7. 사용제한 금융상품

당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
단기금융상품:		
중소기업지원관련 사용제한(상생펀드)	227,500	77,500
소비세 이연납부에 대한 예치금	6,123	6,220
소 계	233,623	83,720
기타금융자산:		
직장보육시설자금 담보제공	308	308
당좌개설보증금	11	12
기타	276	104
소 계	595	424
합 계	234,218	84,144

8. 매출채권 및 기타수취채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미수금	9,343	11,571
미수수익	21,388	9,732
단기대여금	2,740	3,145
단기보증금 및 예치금	1,472	1,163
소 계	34,943	25,611
비유동:		
장기미수금	59	60
장기대여금	10,019	6,008
보증금	32,835	33,261
장기성예치금	153	161
소 계	43,066	39,490
합 계	78,009	65,101

(2) 대손충당금의 내역

당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타수취채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	채권액	대손충당금	장부금액	채권액	대손충당금	장부금액
매출채권	5,262,433	(1,857)	5,260,576	3,253,489	(1,837)	3,251,652
유동성 기타수취채권	36,344	(1,401)	34,943	26,982	(1,371)	25,611
비유동성 기타수취채권	44,494	(1,428)	43,066	40,966	(1,476)	39,490
합 계	5,343,271	(4,686)	5,338,585	3,321,437	(4,684)	3,316,753

(3) 당분기와 전분기 중 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	대손상각비	환 입	환출변동	기 말
매출채권	1,837	240	(238)	18	1,857
유동성 기타수취채권	1,371	-	(14)	44	1,401
비유동성 기타수취채권	1,476	53	(3)	(98)	1,428
합 계	4,684	293	(255)	(36)	4,686

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	대손상각비	환 입	환출변동	기 말
매출채권	2,974	-	(1,282)	(23)	1,669
유동성 기타수취채권	1,433	-	(70)	-	1,363
비유동성 기타수취채권	6,143	51	(27)	(95)	6,072
합 계	10,550	51	(1,379)	(118)	9,104

9. 재고자산

당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	취득원가	평가손실총당금	장부금액	취득원가	평가손실총당금	장부금액
제 품	513,405	(98,447)	414,958	429,348	(37,845)	391,503
재공품	1,568,168	(48,798)	1,519,370	1,153,100	(22,607)	1,130,493
원재료	350,909	(36,336)	314,573	264,402	(3,725)	260,677
저장품	281,462	(7,053)	274,409	194,701	(23)	194,678
미착품	34,093	-	34,093	48,847	-	48,847
합 계	2,748,037	(190,634)	2,557,403	2,090,398	(64,200)	2,026,198

10. 기타유동자산 및 기타비유동자산

당분기말과 전기말 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선급금	2,182	1,853
선급비용	223,074	238,831
부가세대급금	158,506	148,756
기 타	4,939	9,913
소 계	388,701	399,353
비유동:		
장기선급금	150,000	-
장기선급비용	549,041	568,907
기 타	-	1,495
소 계	699,041	570,402
합 계	1,087,742	969,755

11. 관계기업 및 공동기업투자

(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)								
구 분	회사명	소재지	주요 영업활동	당분기말			전기말	
				지분율(%)	순자산 지분금액	장부금액	지분율(%)	장부금액
관계기업	Stratio, Inc.(※1)	미 국	반도체 부품 개발 및 제조	9.10	120	2,120	9.10	2,151
	SK China Company Limited (SK China) (※1, 2)	중 국	부동산 투자업 등	11.87	206,095	258,775	-	-
	Gemini Partners Pte. Ltd. (Gemini)	싱가포르	컨설팅	20.00	2,983	4,678	20.00	5,199
	TCL Fund(※1)	홍 콩	투자	11.06	2,216	2,216	11.06	2,219
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(HITECH)	중 국	반도체 부품 제조	45.00	108,670	108,670	45.00	121,447
합 계						376,459		131,016

(※1) 이사선임권을 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류 하였습니다.

(※2) 당분기 중 연결실체가 보유 중인 매도가능금융자산의 현물출자 등을 통하여 신규 취득하였습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)						
구 분	기 초	취 득	지분법손익	지분법자본변동	배 당	기 말
Stratio, Inc.	2,151	-	(23)	(8)	-	2,120
SK China	-	257,169	-	1,607	-	258,776
Gemini	5,199	-	(552)	31	-	4,678
TCL Fund	2,219	-	9	(12)	-	2,216
HITECH	121,447	-	8,593	(6,543)	(14,828)	108,669
합 계	131,016	257,169	8,027	(4,925)	(14,828)	376,459

② 전분기

(단위: 백만원)						
구 분	기 초	취 득	지분법손익	지분법자본변동	배 당	기 말
Stratio, Inc.	2,171	-	(24)	(11)	-	2,136
Gemini	7,976	-	(2,360)	(19)	-	5,597
TCL Fund	-	2,293	(8)	(243)	-	2,042
HITECH	112,462	-	18,992	(6,846)	(20,726)	103,882
합 계	122,609	2,293	16,600	(7,119)	(20,726)	113,657

(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업의 요약 재무상태표는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)				
구 분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채
Stratio, Inc.	1,131	187	1	-
SK China	870,013	1,000,577	58,601	75,148
Gemini	10,706	4,289	81	-
TCL Fund	3,220	16,805	-	-
HITECH	218,608	356,967	95,761	238,324

② 전기말

(단위: 백만원)				
구 분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채
Stratio, Inc.	998	686	27	-
Gemini	13,047	4,467	93	-
TCL Fund	16,388	3,993	329	-
HITECH	184,048	350,094	82,581	181,679

(4) 당분기와 전분기 중 관계기업 및 공동기업의 요약 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	매출액	분기순손익	매출액	분기순손익
Stratio, Inc.	30	(245)	4	(23)
SK China (*)	-	-	-	-
Gemini	-	(1,486)	-	(3,106)
TCL Fund	-	(58)	-	(76)
HITECH	443,803	20,735	426,948	42,221

(*) SK China 취득일 이후의 요약 포괄손익계산서입니다.

12. 매도가능금융자산

당분기와 전분기 중 매도가능금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	147,779	131,354
취득금액	21,798	16,077
처분금액(*)	(114,180)	(2,294)
환율변동	(19)	-
기말장부금액	55,378	145,137

(*) 당분기 중 SKY Property의 지분(장부금액 112,360백만원) 전액을 현물출자하여 관계기업 SK China Company Limited의 지분을 취득하였으며, 관련하여 30,848백만원의 매도가능금융자산처분이익을 인식하였습니다.

13. 유형자산

(1) 당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	18,777,402	16,966,252
취득금액	6,821,718	4,354,917
처분금액	(198,041)	(114,131)
감가상각	(3,408,687)	(3,065,877)
손상차손	-	(3,746)
환율변동 등	(15,234)	(248,832)
기말장부금액	21,977,158	17,888,583

(2) 당분기말 현재 연결실체의 일부 토지와 건물 등은 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.(주석 31 참조)

(3) 금융리스와 운용리스 이용내역

당분기말 현재 연결실체는 ME Semiconductor Rental First L.L.C. 등으로부터 기계 장치 등을 금융리스계약을 통하여 사용하고 있습니다.

당분기말 현재 금융리스 계약에 따른 기계장치 등의 장부금액은 78,868백만원(전기말: 67,245백만원)입니다. 동 기계장치 등은 관련 금융리스부채와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.

당분기말 현재 연결실체는 Macquarie Capital 등으로부터 기계장치를 운용리스계약에 의하여 사용하고 있으며, 기간별 리스료의 지급계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)	
구 분	리스료지급액
1년 이내	186,849
1년 초과	234,680
합 계	421,529

14. 무형자산

(1) 당분기와 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,915,591	1,704,896
취득금액	622,245	375,875
처분금액	(4,911)	(4,992)
상각액	(279,087)	(247,027)
손상차손	(47)	(63)
환율변동 등	(16,847)	(23,023)
기말장부금액	2,236,944	1,805,666

(2) 당분기 중 개발활동과 관련하여 발생한 비용 중 개발비 인식요건을 충족하는 411,424백만원(전분기: 253,286백만원)은 개발비로 자산화하였으며 연구활동과 관련하여 발생한 비용과 개발비 인식요건을 충족하지 못하는 개발활동 관련비용 1,389,797백만원(전분기: 1,279,160백만원)은 경상개발비로 비용인식하였습니다.

15. 투자부동산

(1) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	2,573	2,679
감가상각	(79)	(79)
기말장부금액	2,494	2,600

(2) 당분기 중 발생한 투자부동산의 감가상각비 79백만원(전분기:79백만원)은 전액 매출원가에 포함되어 있습니다.

(3) 당분기 중 투자부동산과 관련하여 발생한 임대수익은 372백만원(전분기:376백만원)입니다.

16. 차입금

(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
단기차입금	183,302	-
유동성장기차입금	300,012	384,124
유동성사채	149,837	320,736
소 계	633,151	704,860
비유동:		
장기차입금	2,283,630	2,095,737
사 채	1,386,757	1,535,381
소 계	3,670,387	3,631,118
합 계	4,303,538	4,335,978

(2) 당분기와 전분기 중 차입금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	4,335,978	3,818,595
신규차입	752,944	2,081,562
차입금상환	(691,642)	(1,593,315)
기 타(*)	(93,742)	(158,071)
기말장부금액	4,303,538	4,148,771

(*) 환율변동효과 및 현재가치할인차금 상각액 등이 포함되어 있습니다.

17. 기타유동부채 및 기타비유동부채

당분기말과 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선수금	7,219	3,781
선수수익	118	228
예수금	29,795	42,622
보증예수금	951	1,539
기 타	3,527	2,328
소 계	41,610	50,498
비유동:		
기타장기종업원급여부채	62,533	61,883
합 계	104,143	112,381

18. 충당부채

(1) 당분기와 전분기 중 충당부채 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사 용	환 입	기 말
판매보증충당부채	2,997	1,803	(809)	-	3,991
반품충당부채	13,317	88,543	(73,382)	-	28,478
소송충당부채	400	4,391	-	(400)	4,391
배출부채	26,108	4,349	(695)	-	29,762
합 계	42,822	99,086	(74,886)	(400)	66,622

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사 용	환 입	기 말
판매보증충당부채	2,936	21,382	(21,130)	-	3,188
반품충당부채	14,736	19,478	(22,735)	-	11,479
소송충당부채	1,523	-	(1,097)	(426)	-
배출부채	6,081	14,016	(1,339)	-	18,758
합 계	25,276	54,876	(46,301)	(426)	33,425

(2) 판매보증충당부채

연결실체는 무상 품질보증수리 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거 경험을 등을 기초로 추정하여 충당부채를 인식하고 있습니다.

(3) 반품충당부채

연결실체는 판매 후 반품이 예상되는 매출액을 합리적으로 추정하여 매출액과 매출 원가에서 각각 차감하고 매출총이익에 해당하는 금액과 반품과 관련하여 발생할 것으로 예상되는 비용의 합계액을 충당부채로 설정하고 있습니다.

(4) 소송충당부채

연결실체는 소송 혹은 분쟁 등과 관련하여 경제적 효익이 내재된 자원이 유출될 가능성이 높고 그 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 그 금액을 충당부채로 계상하고 있습니다.

(5) 배출부채

연결실체는 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 추정하여 충당부채로 인식하고 있습니다.

19. 종업원급여

(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	1,319,330	1,195,047
사외적립자산의 공정가치	(877,716)	(888,559)
합 계	441,614	306,488

(2) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적 평가를 위해 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말(%)	전기말(%)
할인율	3.09 ~ 4.10	3.09 ~ 4.10
미래임금상승률	2.20 ~ 5.48	2.20 ~ 5.48

(3) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초잔액	1,195,047	1,055,340
당기근무원가	114,084	111,909
이자원가	35,191	31,151
관계사전출입액	331	(2,098)
퇴직급여지급액	(25,337)	(23,885)
기 타	14	41
기말잔액	1,319,330	1,172,458

(4) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초잔액	888,559	570,363
이자수익	26,192	16,765
기여금납입액	-	120
관계사전출입액	334	(1,197)
퇴직급여지급액	(24,848)	(15,644)
재측정요소	(12,521)	(6,436)
기말금액	877,716	563,971

(5) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
당기근무원가	38,453	114,084	35,643	111,909
순이자원가	2,958	8,999	4,796	14,386
합 계	41,411	123,083	40,439	126,295

(6) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
예적금	876,344	887,074
기 타	1,372	1,485
합 계	877,716	888,559

한편, 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 실제수익은 각각 13,671백만원과 10,330백만원입니다.

(7) 연결실체는 임금피크제 대상 종업원에 대하여 확정기여형 연금제도를 시행하고 있습니다. 확정기여형 연금제도와 관련하여 당분기 중 비용으로 인식한 금액은 48백만원입니다.

20. 파생상품거래

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타금융부채로 인식하고 있는 파생금융부채의 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유동:		
이자율스왑	-	288

(2) 당분기와 전분기 중 파생상품 거래와 관련하여 금융수익 및 금융비용으로 인식한 평가손익 및 거래손익은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)								
구 분	평가이익		평가손실		거래이익		거래손실	
	3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적
이자율스왑	(188)	-	-	-	492	902	304	913

② 전분기

(단위: 백만원)								
구 분	평가이익		평가손실		거래이익		거래손실	
	3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적
이자율스왑	128	248	-	-	292	876	406	1,218

21. 자본금, 자본잉여금 및 기타자본

(1) 당분기말 현재 지배기업의 수권주식수는 9,000,000천주이고, 1주당 액면금액은 5,000원입니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 보통주 발행주식수, 보통주자본금, 자본잉여금 및 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천주)		
구 분	당분기말	전기말
보통주 발행주식수(*)	731,530	731,530
보통주자본금	3,657,652	3,657,652
자본잉여금:		
주식발행초과금	3,625,797	3,625,797
기 타	517,939	517,939
합 계	4,143,736	4,143,736
기타자본:		
자기주식 취득금액	(771,913)	(771,913)
주식선택권	548	-
합 계	(771,365)	(771,913)
자기주식수	22,001	22,001

(*) 당분기말 현재 과거 이익소각의 영향으로 인하여 상장주식 총수 728,002천주와 발행주식 총수에 차이가 있습니다.

(2) 당분기와 전기 중 지배기업의 유통주식수는 706,002천주로 변동이 없습니다.

22. 기타포괄손익누계액

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
지분법자본변동	1,019	5,944
해외사업장환산외환차이	(185,583)	(85,047)
합 계	(184,564)	(79,103)

(2) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)			
구 분	기 초	증 감	기 말
(부의)지분법자본변동	5,944	(4,925)	1,019
해외사업장환산외환차이	(85,047)	(100,536)	(185,583)
합 계	(79,103)	(105,461)	(184,564)

② 전분기

(단위: 백만원)			
구 분	기 초	증 감	기 말
(부의)지분법자본변동	1,856	(7,119)	(5,263)
해외사업장환산외환차이	(3,456)	(346,782)	(350,238)
합 계	(1,600)	(353,901)	(355,501)

23. 이익잉여금

당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
법정적립금(*1)	108,354	65,994
임의적립금(*2)	235,506	235,506
미처분이익잉여금(*3)	23,707,364	16,765,083
합 계	24,051,224	17,066,583

(*1) 지배기업은 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다.

(*2) 임의적립금은 기술개발준비금으로 구성되어 있습니다.

(*3) 2017년 3월 24일자 주주총회에서 배당금 423,601백만원이 결의되었으며, 당분기 중 전액 지급하였습니다.

24. 판매비와관리비

당분기와 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
급 여	124,651	345,671	90,069	245,218
퇴직급여	6,669	19,956	4,507	20,762
복리후생비	21,311	62,195	20,841	64,037
지급수수료	56,878	170,160	55,039	166,152
감가상각비	24,174	70,119	19,232	60,505
무형자산상각비	104,897	237,846	49,904	217,758
운반보관비	9,780	28,111	7,732	23,357
송무비	8,638	25,380	1,059	4,687
임차료	3,186	10,398	3,529	10,991
세금과공과	4,518	11,946	4,083	14,595
교육훈련비	7,103	17,364	3,254	13,544
광고선전비	15,178	36,557	14,663	30,652
소모품비	18,097	50,133	17,990	40,445
수선비	13,796	20,412	1,453	4,616
여비교통비	3,063	8,262	2,676	7,918
판매수리비	190	1,803	6,820	21,382
판매촉진비	11,887	41,710	8,748	29,309
기 타	7,899	36,786	6,245	25,517
소 계	441,915	1,194,809	317,844	1,001,445
경상개발비 :				
연구개발비 총지출액	638,639	1,801,221	500,453	1,532,446
개발비 자산화	(115,819)	(411,424)	(92,896)	(253,286)
소 계	522,820	1,389,797	407,557	1,279,160
합 계	964,735	2,584,606	725,401	2,280,605

25. 비용의 성격별 분류

당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
제품 및 재공품의 변동	(37,666)	(412,332)	6,109	(50,421)
원재료, 저장품 및 소모품 사용	1,028,672	2,987,097	872,864	2,442,437
종업원급여	802,729	2,250,107	594,401	1,637,241
감가상각 및 무형자산상각	1,281,172	3,598,274	1,093,283	3,271,920
기술료	55,946	163,691	57,159	172,607
지급수수료	333,726	889,567	254,818	721,569
동력 및 수도광열비	251,763	696,641	216,922	619,399
수선비	254,047	665,520	158,889	434,068
외주가공비	228,046	662,541	190,801	565,456
기 타	164,457	325,283	72,443	285,406
합 계(*)	4,362,892	11,826,389	3,517,689	10,099,682

(*) 연결포괄손익계산서상의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

26. 금융수익 및 금융비용

당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
금융수익:				
이자수익	14,632	33,983	6,987	26,185
배당금수익	—	13	—	18
외환차이	202,297	672,703	225,988	584,337
파생상품관련이익	304	902	420	1,124
당기손익인식금융자산평가이익	1,201	2,937	—	690
당기손익인식금융자산처분이익	3,366	8,627	2,267	11,532
매도가능금융자산처분이익	30,945	30,945	—	—
소 계	252,745	750,110	235,662	623,886
금융비용:				
이자비용	32,304	96,330	32,095	96,836
외환차이	126,927	642,441	210,473	592,097
파생상품관련손실	304	913	406	1,218
당기손익인식금융자산평가손실	—	—	242	—
매도가능금융자산처분손실	1	1	—	—
소 계	159,536	739,685	243,216	690,151
순금융수익(비용)	93,209	10,425	(7,554)	(66,265)

27. 기타영업외수익과 기타영업외비용

(1) 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
유형자산처분이익	19,890	29,379	2,084	4,263
기 타	4,582	33,316	8,785	20,606
합 계	24,472	62,695	10,869	24,869

(2) 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
유형자산처분손실	954	6,284	906	5,765
무형자산처분손실	730	3,926	1,719	3,415
매출채권처분손실	1,776	5,401	904	1,521
기부금	3,843	25,179	20,793	24,897
유형자산손상차손	-	-	-	3,746
무형자산손상차손	47	47	26	63
기 타	8,192	13,483	3,178	31,042
합 계	15,542	54,320	27,526	70,449

28. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 법인세비용에는 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항이 포함되어 있습니다.

29. 주당이익

주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적 보통주 1주에 대한 지배기업 소유주지분순이익을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기본주당이익

(단위: 주, 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
지배기업소유주지분 분기순이익	3,054,248	7,420,763	596,774	1,327,109
가중평균유통보통주식수(*)	706,001,795	706,001,795	706,001,795	706,001,795
기본주당이익	4,326 원	10,511 원	845 원	1,880 원

(*) 주당이익을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
발행주식수	728,002,365	728,002,365	728,002,365	728,002,365
자기주식 효과	(22,000,570)	(22,000,570)	(22,000,570)	(22,000,570)
가중평균유통보통주식수	706,001,795	706,001,795	706,001,795	706,001,795

(2) 희석주당이익

(단위: 백만원, 주)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
보통주희석분기순이익	3,054,248	7,420,763	596,774	1,327,109
가중평균희석유통보통주식수(*)	706,046,520	706,010,823	706,001,795	706,001,795
희석주당이익	4,326 원	10,511 원	845 원	1,880 원

(*) 희석주당이익을 계산하기 위한 가중평균희석유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
가중평균유통보통주식수	706,001,795	706,001,795	706,001,795	706,001,795
주식선택권 효과	44,725	9,028	-	-
가중평균희석유통보통주식수	706,046,520	706,010,823	706,001,795	706,001,795

30. 특수관계자 거래

(1) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명
관계기업	Stratio, Inc., SK China Company Limited, Gemini Partners Pte. Ltd., TCL Fund
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
기타특수관계자	연결실체에 유의적인 영향력을 행사하는 SK텔레콤(주)의 종속기업과 SK텔레콤(주)의 지배기업인 SK(주)와 그 종속기업

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요거래 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)									
구 분	회사명	영업수익 등		영업비용 등		자산취득		배당금수익	
		3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd	289	5,755	153,585	442,061	-	-	-	14,828
기타특수관계자	SK텔레콤(주)(*1)	11	224	2,053	93,875	16,740	22,286	-	-
	SK(주)(*2)	278	730	44,501	124,697	21,825	100,347	-	-
	ESSENCORE Limited	189,653	537,469	-	-	-	-	-	-
	SK건설(주)	6,870	15,559	125	351	307,022	641,325	-	-
	SK에너지(주)	1,236	3,723	8,813	42,132	-	-	-	-
	SK네트웍스(주)	-	-	1,102	3,090	-	-	-	-
	에스케이씨솔믹스(주)	-	-	5,098	25,493	168	744	-	-
	충청에너지서비스(주)	-	-	1,600	11,921	-	10	-	-
	행복나래(주)	8	26	128,171	314,324	11,011	23,913	-	-
	SK머티리얼즈(주)	3	3	14,033	36,981	-	-	-	-
	SK실트론(주)	583	583	28,610	28,610	-	-	-	-
	기타	163	590	45,226	122,247	2,818	17,620	-	-
합 계		199,094	564,662	432,917	1,245,782	359,584	806,245	-	14,828

(*1) 영업비용 등에는 배당금 87,660백만원이 포함되어 있습니다.

(*2) 연결실체는 SK(주)와 2012년 3월부터 SK브랜드 사용을 위하여 매출액의 일정비율에 해당하는 금액을 사용료로 지급하기로 약정하였으며, 당분기 중 발생한 SK브랜드사용료는 26,180백만원(전분기 : 28,415백만원)입니다.

② 전분기

(단위: 백만원)									
구 분	회사명	영업수익 등		영업비용 등		자산취득		배당금수익	
		3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	127	416	135,902	427,099	-	17,864	-	20,726
기타특수관계자	SK텔레콤주(※)	9	216	1,974	78,816	5,569	9,824	-	-
	SK주	163	672	32,856	88,005	30,610	106,054	-	-
	ESSENDCORE Limited	146,720	383,413	-	-	-	-	-	-
	SK건설주	219	452	816	21,253	59,371	188,758	-	-
	SK에너지주	1,083	3,501	5,973	37,388	-	-	-	-
	SK네트웍스주	-	-	1,061	3,117	-	-	-	-
	에스케이씨솔믹스주	-	-	8,804	24,298	86	253	-	-
	충청에너지서비스주	-	-	1,540	12,804	-	-	-	-
	행복나래주	12	22	58,545	105,220	4,593	7,303	-	-
	SK머티리얼즈주	-	-	11,335	32,601	-	-	-	-
	기 타	134	312	31,291	84,785	1,235	14,020	-	-
합 계		148,467	389,004	290,097	915,386	101,464	344,076	-	20,726

(※) 영업비용 등에는 배당금 73,050백만원이 포함되어 있습니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채권 등	채무 등
		매출채권 등	미지급금 등
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	266	106,331
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	-	4,633
	SK(주)	5,533	95,129
	ESSENCORE Limited	59,974	-
	SK건설(주)	111	329,123
	SK에너지(주)	441	2,734
	SK네트웍스(주)	-	358
	에스케이씨솔믹스(주)	-	2,892
	충청에너지서비스(주)	-	542
	행복나래(주)	3	32,220
	SK머티리얼즈(주)	3	12,550
	SK실트론(주)(*)	150,329	20,312
	기타	80	45,367
합 계		216,740	652,191

(*) 지배기업은 Wafer 수급 안정성 확보를 위하여 SK실트론(주)와 2019년부터 2023년까지 Wafer 구매계약을 체결하였으며, 당분기 중 구매대금 150,000백만원을 선급하였습니다. 한편, SK실트론(주)는 지배기업이 선급한 150,000백만원을 보증하기 위하여 투자자산 일부를 양도담보로 제공하기로 약정하였습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채권 등	채무 등
		매출채권 등	미지급금 등
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	-	99,328
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	92	4,281
	SK(주)	6,343	98,396
	ESSENCOORE Limited	72,507	-
	SK건설(주)	2,016	530,940
	SK에너지(주)	417	6,544
	SK네트웍스(주)	-	1,143
	에스케이씨솔믹스(주)	-	10,067
	충청에너지서비스(주)	-	1,804
	행복나래(주)	-	9,205
	SK머티리얼즈(주)	3	23,046
	기타	5	45,656
합 계		81,383	830,410

(4) 주요경영진에 대한 보상

연결실체의 주요 경영진은 지배기업의 이사(등기 및 비등기), 이사회 의 구성원, 재무 책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 당분기와 전분기 중 인식한 주요경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	32,418	79,001	15,794	39,730
퇴직급여	2,167	6,621	2,059	6,176
주식보상비용	263	548	-	-
기타	3	9	3	10
합 계	34,851	86,179	17,856	45,916

(5) 당분기와 전분기 중 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	회사명	영업수익 등		영업비용 등	
		3개월	누 적	3개월	누 적
대규모기업집단소속회사	SK케미칼주	-	-	310	870

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	회사명	영업수익 등		영업비용 등	
		3개월	누 적	3개월	누 적
대규모기업집단소속회사	SK케미칼주	-	-	92	140

(6) 당분기말과 전기말 현재 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
대규모기업집단소속회사	SK케미칼주	-	314

② 전기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
대규모기업집단소속회사	SK케미칼주	-	183

31. 우발부채와 약정사항

(1) 당분기말 현재 연결실체와 관련하여 계류 중인 중요한 소송사건 및 클레임 등의 내역은 다음과 같습니다.

① Netlist, Inc.의 특허 침해 소송

Netlist, Inc.는 지배회사와 SK hynix America Inc. 등 지배회사의 종속기업들을 상대로 다수의 특허를 침해했다는 소송을 2016년 8월 31일 및 2017년 6월 14일 미국 캘리포니아 중부지방법원에, 2016년 9월 1일 및 2017년 10월 31일 미국국제무역위원회에, 2017년 7월 11일 독일 뮌헨 지방법원 및 중국베이징 지식재산법원에 각각 제기하여 소송이 진행 중에 있습니다. 당분기말 현재 미국 등 각 지역에서 제기된 Netlist, Inc.의 특허 침해 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태이며, 당분기말 현재 최종결과를 예측할 수 없습니다.

② 소송 및 특허 클레임 등

당분기말 현재 연결실체는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며 향후 자원의 유출가능성이 높고 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

(2) 특허라이선스 계약

연결실체는 당분기말 현재 제품생산과 관련한 다수의 특허라이선스 계약을 체결하고 있습니다. 동 계약에 의한 Royalty는 Lump-sum royalty 및 Running royalty의 형식으로 지급되며, Lump-sum royalty 지급액은 특허라이선스 계약기간에 따라 정액으로 안분된 금액을 비용으로 처리하고 있습니다.

(3) 공업용수공급계약

연결실체는 베올리아워터산업개발(주) ("Veolia")와 2018년 3월까지 공업용수를 공급받는 계약을 체결하고 있습니다. 동 계약에 의하면 연결실체는 계약기간 동안 Base Service Charge ("BSC")와 공급받는 공업용수 사용량에 일정액을 적용하여 계산된 Additional Service Charge ("ASC")를 Veolia에 지급해야 합니다.

(4) HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. ("HITECH")와 후공정서비스계약
 연결실체는 HITECH와 후공정서비스를 공급받는 계약을 체결하고 있으며 서비스 제공 범위는 Package, Package Test, Module 등 입니다. 연결실체는 동 계약에 따라 HITECH 장비 우선 사용권을 보유하고, 후공정서비스 대가로 HITECH에 일정액의 약정수익을 보장하는 가격을 지불하기로 하였습니다.

(5) 당분기말 현재 담보제공자산 등의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)			
구 분(*)	장부금액	담보설정액	비 고
토 지	19,118	1,451,861	시설자금대출 관련 등
건 물	55,546		
기계장치	1,194,238		
합 계	1,268,902	1,451,861	

(*) 상기 담보제공자산 이외에 연결실체의 금융리스자산은 해당 금융리스 계약에 의하여 관련 금융리스 부채의 담보로 제공되어 있습니다.

(6) 당분기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결하고 있는 여신한도 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	금융기관	약정사항	한도금액	
			통 화	금 액
지배기업	하나은행 등	Usance 등 수입금융약정	USD	265
		매입외환 등 수출금융약정	USD	250
		수출·수입 포괄한도약정	USD	960
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SKHYCL)	중국농업은행 등	Usance 등 수입금융약정	RMB	1,300
			USD	232
SK hynix America Inc. (SKHYA) 등 판매법인	씨티은행 등	상환청구권이 없는 매출채권팩토링약정	USD	500
국내종속기업	하나은행 등	무역어음대출	KRW	500
		외상매출채권담보대출	KRW	10,000
		납품대금지급업무대행계약	KRW	15,000

(7) 당분기말 현재 연결실체가 타인에게 제공한 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	금 액	비 고
종업원	8	우리사주관련 금융기관 차입금 지급보증

(8) 당분기말 현재 기표되지 않은 유형자산에 대한 구매 약정액은 968,985백만원(전기말: 293,730백만원)입니다.

(9) 도시바 반도체 사업지분 투자

연결실체는 도시바 반도체 사업의 지분투자와 관련하여 Bain Capital이 포함된 컨소시엄(이하 "Bain 컨소시엄")에 참여하였으며, 2017년 9월 27일의 이사회 결의를 통하여 특수목적법인인 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP에 대해 JPY 266,000백만의 출자 및 BCPE Pangea Cayman2 Limited가 발행한 전환사채 JPY 129,000백만의 취득을 당분기 중 동 출자 및 취득계약을 포함하여 Bain 컨소시엄과 도시바 간의 계약이 체결되었습니다.

32. 영업으로부터 창출된 현금

(1) 당분기와 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
분기순이익	7,422,719	1,331,909
조정항목:		
법인세비용	1,859,600	313,453
퇴직급여	123,083	126,295
감가상각비	3,408,687	3,065,877
투자부동산상각비	79	79
무형자산상각비	279,087	247,027
주식보상비용	548	-
유형자산처분손실	6,284	5,765
무형자산처분손실	3,926	3,415
유형자산손상차손	-	3,746
무형자산손상차손	47	63
이자비용	96,330	96,836
외화환산손실	40,526	77,408
지분법손익	(8,027)	(16,600)
유형자산처분이익	(29,379)	(4,263)
당기손익인식금융자산평가이익	(2,937)	(690)
당기손익인식금융자산처분이익	(8,627)	(11,532)
매도가능금융자산처분이익	(30,945)	-
파생상품관련손익	11	94
이자수익	(33,983)	(26,185)
외화환산이익	(213,079)	(188,256)
기 타	5,430	3,367
운전자본의 변동:		
매출채권의 감소(증가)	(2,105,702)	112,708
기타수취채권의 감소(증가)	(1,591)	45,243
재고자산의 감소(증가)	(532,470)	(97,105)
기타자산의 감소(증가)	(123,189)	79,783

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
매입채무의 증가(감소)	142,577	(14,056)
미지급금의 증가(감소)	(46,469)	(100,605)
기타지급채무의 증가(감소)	316,910	(530,444)
총당부채의 증가(감소)	23,840	8,169
기타부채의 증가(감소)	(7,308)	(3,349)
사외적립자산의 납부	-	(120)
퇴직금의 지급	(13,846)	(15,717)
영업으로부터 창출된 현금	10,572,132	4,512,315

(2) 당분기와 전분기 중 유동성 대체를 제외한 중요한 현금의 유입·유출이 없는 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
SK China Company Limited에 대한 현물출자	143,208	-

33. 주식기준보상

(1) 연결실체는 당분기 중 연결실체의 주요 경영진에게 주식결제형 주식선택권을 부여하였으며, 당분기말 현재 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)								
구 분	총부여수량	소멸수량	행사수량	미행사수량	부여일	약정유효제공기간	행사가능기간	행사가격
1차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2019.03.24	2019.03.25 ~ 2022.03.24	48,400원
2차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2020.03.24	2020.03.25 ~ 2023.03.24	52,280원
3차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2021.03.24	2021.03.25 ~ 2024.03.24	56,460원
합 계	298,800	-	-	298,800				

(2) 공정가치 측정

이항모형을 적용하여 공정가액 접근법에 의한 보상원가를 산정하였으며, 주식결제형 주식기준보상제도의 부여일 현재 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분	1차	2차	3차
기대변동성	23.23%	23.23%	23.23%
부여일 공정가치	10,026원	9,613원	9,296원
배당수익률	1.20%	1.20%	1.20%
무위험이자율(국공채 수익률)	1.86%	1.95%	2.07%

(3) 당분기 중 인식한 주식보상비용은 548백만원 입니다.

4. 재무제표

재무상태표

제 70 기 3분기말 2017.09.30 현재

제 69 기말 2016.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 70 기 3분기말	제 69 기말
자산		
유동자산	11,898,210	7,933,301
현금및현금성자산	776,764	476,917

	제 70 기 3분기말	제 69 기말
단기금융상품	3,719,294	2,487,942
매출채권	4,941,262	2,896,443
기타수취채권	37,425	32,131
재고자산	2,116,207	1,698,723
기타유동자산	307,258	341,145
비유동자산	27,765,547	23,465,792
관계기업 및 공동기업투 자	5,439,803	4,588,062
비유동매도가능금융자 산	51,208	143,590
기타수취채권	30,993	30,858
기타금융자산	319	319
유형자산	19,144,987	16,071,281
무형자산	1,885,342	1,546,733
투자부동산	2,494	2,573
이연법인세자산	513,359	513,359
기타비유동자산	697,042	569,017
자산총계	39,663,757	31,399,093
부채		
유동부채	5,599,302	4,351,661
매입채무	1,070,985	1,144,476
단기미지급금	1,392,306	1,554,621
기타지급채무	929,877	583,984
차입금	507,326	644,765
기타금융부채		288
충당부채	81,243	46,005
당기법인세부채	1,597,399	342,787
기타유동부채	20,166	34,735
비유동부채	4,160,080	3,955,919

	제 70 기 3분기말	제 69 기말
기타지급채무	4,469	27,640
장기차입금	3,669,807	3,571,022
확정급여부채	426,120	297,953
기타비유동부채	59,684	59,304
부채총계	9,759,382	8,307,580
자본		
자본금	3,657,652	3,657,652
자본잉여금	4,183,564	4,183,564
기타자본	(771,365)	(771,913)
이익잉여금	22,834,524	16,022,210
자본총계	29,904,375	23,091,513
자본과부채총계	39,663,757	31,399,093

포괄손익계산서

제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 70 기 3분기		제 69 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	7,974,611	20,827,540	4,074,237	11,408,846
매출원가	3,472,026	9,447,978	2,828,047	7,808,689
매출총이익	4,502,585	11,379,562	1,246,190	3,600,157
판매비와관리비	888,838	2,378,434	663,648	2,085,493
영업이익	3,613,747	9,001,128	582,542	1,514,664
금융수익	198,168	641,176	215,575	582,588
금융비용	118,494	589,601	218,513	593,881
기타영업외수익	25,724	69,960	6,666	21,623
기타영업외비용	13,065	54,178	26,254	63,335

	제 70 기 3분기		제 69 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
법인세비용차감 전순이익	3,706,080	9,068,485	560,016	1,461,659
법인세비용	767,525	1,820,049	94,164	283,401
당기순이익	2,938,555	7,248,436	465,852	1,178,258
법인세차감후 기 타포괄손익	(4,209)	(12,521)	(4,312)	(6,435)
확정급여제도 의 재측정요소	(4,209)	(12,521)	(4,312)	(6,435)
총포괄이익	2,934,346	7,235,915	461,540	1,171,823
주당이익				
기본주당순이 익	4,162	10,267	660	1,669
희석주당순이 익	4,162	10,267	660	1,669

자본변동표

제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	자본				
	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계
2016.01.01 (기초자 본)	3,657,652	4,182,016	(771,913)	13,614,710	20,682,465
당기순이익				1,178,258	1,178,258
확정급여제도의 재측 정요소				(6,435)	(6,435)
총포괄손익 합계				1,171,823	1,171,823
배당금지금				353,001	353,001
주식선택권 부여					0
2016.09.30 (기말자 본)	3,657,652	4,182,016	(771,913)	14,433,532	21,501,287

	자본				
	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계
2017.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,183,564	(771,913)	16,022,210	23,091,513
당기순이익				7,248,436	7,248,436
확정급여제도의 재측정요소				(12,521)	(12,521)
총포괄손익 합계				7,235,915	7,235,915
배당금지금				423,601	423,601
주식선택권 부여			548		548
2017.09.30 (기말자본)	3,657,652	4,183,564	(771,365)	22,834,524	29,904,375

현금흐름표

제 70 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

제 69 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 70 기 3분기	제 69 기 3분기
영업활동현금흐름	9,032,933	2,898,999
영업으로부터 창출된 현금흐름	9,649,291	3,797,285
이자의 수취	20,316	34,530
이자의 지급	(88,856)	(89,989)
법인세의 납부	(565,437)	(880,690)
배당금의 수취	17,619	37,863
투자활동현금흐름	(8,374,452)	(3,210,131)
단기금융상품의 감소	2,931,090	4,352,521
단기금융상품의 증가	(4,157,500)	(3,207,500)
기타금융자산의 감소	1	0
기타수취채권의 감소	9,405	58,806
기타수취채권의 증가	(12,341)	(7,786)
매도가능금융자산의 처분	1,916	2,294
매도가능금융자산의 취득	(21,798)	(12,798)

	제 70 기 3분기	제 69 기 3분기
파생상품거래로 인한 현금 유입	902	876
파생상품거래로 인한 현금 유출	(1,201)	(1,218)
유형자산의 처분	296,144	112,045
유형자산의 취득	(6,244,367)	(4,094,402)
무형자산의 처분	985	1,577
무형자산의 취득	(607,984)	(365,822)
종속기업투자(MMT)의 순 증감	(294,013)	(46,212)
종속기업투자의 취득	(161,731)	(2,512)
관계기업투자의 취득	(113,960)	0
재무활동현금흐름	(372,048)	399,911
차입금의 차입	685,084	2,080,343
차입금의 상환	(633,531)	(1,327,431)
배당금의 지급	(423,601)	(353,001)
현금및현금성자산의 환율변 동효과	13,414	(27,279)
현금및현금성자산의 순증감	299,847	61,500
기초 현금및현금성자산	476,917	1,014,939
기말 현금및현금성자산	776,764	1,076,439

5. 재무제표 주석

제 70 기 3분기 2017년 9월 30일 현재

제 69 기 3분기 2016년 9월 30일 현재

에스케이하이닉스 주식회사

1. 회사의 개요

에스케이하이닉스 주식회사(이하 "당사")는 1996년에 주식을 한국거래소에 상장한 공개법인으로, 1949년 10월 15일에 설립되어 메모리반도체의 제조 및 판매업을 주업으로 하고 있습니다. 당사는 경기도 이천시 부발읍 경춘대로 2091에 본사와 경기도 성남시 등에 사무소를 두고 있으며, 경기도 이천시와 충청북도 청주시에 생산공장을 설치·가동하고 있습니다.

한편, 2017년 9월 30일 현재 당사의 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분	소유주식수(주)	지분율(%)
SK텔레콤(주)	146,100,000	20.07
주식관리협의회(*):		
하나은행	4,707,573	0.65
국민연금공단 및 기타주주	555,194,222	76.26
자기주식	22,000,570	3.02
합 계	728,002,365	100.00

(*) SK텔레콤(주)가 주식관리협의회와 2011년 11월 14일에 체결한 에스케이하이닉스 주식회사 주식매매계약에 의하여 주식관리협의회는 거래종결일(2012년 2월 14일) 이후 잔여 주식을 보유하는 동안 당사의 이사 및 감사의 선임에 관하여 SK텔레콤(주)의 의사에 따라 의결권을 행사하여야 합니다.

또한, 주식관리협의회는 동 주식에 대한 의결권을 행사함에 있어서 직접적인 이해관계가 없는 안전에 대하여 합리적으로 거부할 만한 사유가 없는 한 SK텔레콤(주)의 의사에 따라 의결권을 행사하여야 합니다.

한편, 당분기말 현재 당사의 주식은 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에, 주식에
탁증서는 룩셈부르크 증권거래소에 상장되어 있습니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 중간재무제표
입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으
며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별
적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을
이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표
로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투
자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 원가로
표시한 재무제표입니다.

(2) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이
나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항
에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있
습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이
실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단
은 2016년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추
정의 근거를 사용하였습니다.

3. 유의적인 회계정책

당사는 2016년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.

4. 금융상품의 범주별 분류

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)				
구 분	당기손익인식 금융자산	매도가능 금융자산	대여금및 수취채권	합 계
현금및현금성자산	-	-	776,764	776,764
단기금융상품	901,794	-	2,817,500	3,719,294
매출채권	-	-	4,941,262	4,941,262
기타수취채권	-	-	68,418	68,418
기타금융자산	-	-	319	319
매도가능금융자산	-	51,208	-	51,208
합 계	901,794	51,208	8,604,263	9,557,265

② 전기말

(단위: 백만원)				
구 분	당기손익인식 금융자산	매도가능 금융자산	대여금및 수취채권	합 계
현금및현금성자산	-	-	476,917	476,917
단기금융상품	570,442	-	1,917,500	2,487,942
매출채권	-	-	2,896,443	2,896,443
기타수취채권	-	-	62,989	62,989
기타금융자산	-	-	319	319
매도가능금융자산	-	143,590	-	143,590
합 계	570,442	143,590	5,354,168	6,068,200

(2) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	당기손익인식금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	합 계
매입채무	-	1,070,985	1,070,985
미지급금	-	1,392,306	1,392,306
기타지급채무(*)	-	934,346	934,346
차입금	-	4,177,133	4,177,133
합 계	-	7,574,770	7,574,770

② 전기말

(단위: 백만원)			
구 분	당기손익인식금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	합 계
매입채무	-	1,144,476	1,144,476
미지급금	-	1,554,621	1,554,621
기타지급채무(*)	-	611,624	611,624
차입금	-	4,215,787	4,215,787
기타금융부채	288	-	288
합 계	288	7,526,508	7,526,796

(*) 당분기말과 전기말 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미지급비용	929,877	583,984
비유동:		
임대보증금	4,469	2,928
장기미지급금	-	24,712
소 계	4,469	27,640
합 계	934,346	611,624

5. 금융위험관리

(1) 금융위험관리

당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2016년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 당사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

① 시장위험

(가) 환율변동위험

당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당분기말 현재 당사의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	자 산		부 채	
	외화금액	원화환산	외화금액	원화환산
USD	4,991	5,723,619	2,595	2,976,095
EUR	-	279	144	193,996
JPY	4,311	43,993	34,578	352,838

당분기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세비용 차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	10%상승시	10%하락시
USD	274,752	(274,752)
EUR	(19,372)	19,372
JPY	(30,885)	30,885

(나) 이자율위험

당사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

당사는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시, 향후 3개월 간 당사의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 이자비용과 이자수익으로 인한 법인세비용차감전순이익은 각각 5,160백만원만큼 증가 또는 감소할 것입니다.

(다) 가격위험

당사는 당분기말 현재 공정가치로 평가하는 매도가능지분상품을 보유하고 있지 않습니다. 따라서 당사는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있지 않습니다.

② 신용위험

신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

(가) 매출채권 및 기타수취채권

당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있으며, 해외 거래처에 대한 신용위험과 관련하여 신용보험계약을 체결하고 있습니다. 당사의 신용위험 노출정도는 거래상대방별 매출채권 등의 장부금액과 동일한 금액입니다.

(나) 기타의 자산

현금및현금성자산, 단기금융상품 및 장·단기대여금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액입니다. 한편, 당사는 다수의 금융기관에 현금및현금성자산과 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

③ 유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위한 필요자금을 당사가 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

당사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금, 시장성 유가증권 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.

(2) 자본관리

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 당사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 차입금 조달 및 상환, 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 부채비율과 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
부 채 (A)	9,759,382	8,307,580
자 본 (B)	29,904,375	23,091,513
현금및현금성자산 등(C)(*1)	4,496,058	2,964,859
차입금 (D)	4,177,133	4,215,787
부채비율 (A/B)	33%	36%
순차입금비율 (D-C)/B(*2)	-	5%

(*1) 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합계액입니다.

(*2) 당분기말 현재 순차입금비율은 부(-)의 비율로 산출되어 표시하지 않았습니다.

(3) 공정가치

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열 체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	901,794	-	901,794	-	901,794
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*1)	776,764	-	-	-	-
단기금융상품(*1)	2,817,500	-	-	-	-
매출채권(*1)	4,941,262	-	-	-	-
기타수취채권(*1)	68,418	-	-	-	-
기타금융자산(*1)	319	-	-	-	-
매도가능금융자산(*1,2)	51,208	-	-	-	-
소 계	8,655,471	-	-	-	-
금융자산 합계	9,557,265	-	901,794	-	901,794
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*1)	1,070,985	-	-	-	-
미지급금(*1)	1,392,306	-	-	-	-
기타지급채무(*1)	934,346	-	-	-	-
차입금	4,177,133	-	4,192,905	-	4,192,905
금융부채 합계	7,574,770	-	4,192,905	-	4,192,905

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	570,442	-	570,442	-	570,442
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*1)	476,917	-	-	-	-
단기금융상품(*1)	1,917,500	-	-	-	-
매출채권(*1)	2,896,443	-	-	-	-
기타수취채권(*1)	62,989	-	-	-	-
기타금융자산(*1)	319	-	-	-	-
매도가능금융자산(*1,2)	143,590	-	-	-	-
소 계	5,497,758	-	-	-	-
금융자산 합계	6,068,200	-	570,442	-	570,442
공정가치로 측정되는 금융부채:					
기타금융부채	288	-	288	-	288
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*1)	1,144,476	-	-	-	-
미지급금(*1)	1,554,621	-	-	-	-
기타지급채무(*1)	611,624	-	-	-	-
차입금	4,215,787	-	4,246,042	-	4,246,042
소 계	7,526,508	-	4,246,042	-	4,246,042
금융부채 합계	7,526,796	-	4,246,330	-	4,246,330

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

(*2) 동일한 상품(즉, 수준 1의 투입변수)에 대한 활성시장에서 공시되는 가격이 없는 지분상품에 해당하여 다른 방법으로 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없으므로, 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'에 따라 원가로 측정하였습니다.

③ 가치평가기법

수준 2의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1과 수준 2 및 수준 3 간의 대체는 없습니다.

6. 사용제한 금융상품

당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
단기금융상품:		
중소기업지원관련 사용제한(상생펀드)	227,500	77,500
기타금융자산:		
직장보육시설자금 담보제공	308	308
당좌개설보증금	11	11
소 계	319	319
합 계	227,819	77,819

7. 매출채권 및 기타수취채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미수금	13,780	22,402
미수수익	20,598	9,494
단기대여금	3,047	235
소 계	37,425	32,131
비유동:		
장기대여금	2,374	1,915
보증금	28,619	28,943
소 계	30,993	30,858
합 계	68,418	62,989

(2) 대손충당금의 내역

당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타수취채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	채권액	대손충당금	장부금액	채권액	대손충당금	장부금액
매출채권	4,942,093	(831)	4,941,262	2,897,512	(1,069)	2,896,443
유동성 기타수취채권	38,782	(1,357)	37,425	33,502	(1,371)	32,131
비유동성 기타수취채권	31,389	(396)	30,993	31,257	(399)	30,858
합 계	5,012,264	(2,584)	5,009,680	2,962,271	(2,839)	2,959,432

(3) 당분기와 전분기 중 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	대손상각비	환 입	제 각	기 말
매출채권	1,069	-	(238)	-	831
유동성 기타수취채권	1,371	-	(14)	-	1,357
비유동성 기타수취채권	399	-	(3)	-	396
합 계	2,839	-	(255)	-	2,584

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	대손상각비	환 입	제 각	기 말
매출채권	2,398	-	(1,293)	-	1,105
유동성 기타수취채권	36,294	-	(70)	(34,861)	1,363
비유동성 기타수취채권	5,138	20	(27)	-	5,131
합 계	43,830	20	(1,390)	(34,861)	7,599

8. 재고자산

당분기말과 전기말 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	취득원가	평가손실총당금	장부금액	취득원가	평가손실총당금	장부금액
제품	479,158	(91,952)	387,206	414,807	(34,481)	380,326
재공품	1,349,810	(45,039)	1,304,771	989,543	(22,607)	966,936
원재료	263,007	(30,971)	232,036	199,163	(3,562)	195,601
저장품	175,681	(7,027)	168,654	124,292	-	124,292
미착품	23,540	-	23,540	31,568	-	31,568
합 계	2,291,196	(174,989)	2,116,207	1,759,373	(60,650)	1,698,723

9. 기타유동자산 및 기타비유동자산

당분기말과 전기말 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선금금	337	427
선금비용	203,426	223,465
부가세대금금	98,559	107,341
기 타	4,936	9,912
소 계	307,258	341,145
비유동:		
장기선금금	150,000	-
장기선금비용	547,042	567,522
기 타	-	1,495
소 계	697,042	569,017
합 계	1,004,300	910,162

10. 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자

(1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
종속기업	5,087,832	4,493,260
관계기업 및 공동기업	351,971	94,802
합 계	5,439,803	4,588,062

(2) 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	소재지	주요영업활동	당분기말		전기말	
			지분율(%)	장부금액	지분율(%)	장부금액
에스케이하이이엔지(주)	국 내	사업지원 및 서비스	100.00	7,521	100.00	7,521
에스케이하이텍(주)	국 내	사업지원 및 공사 등	100.00	6,760	100.00	6,760
(주)실리콘화일	국 내	전자·전기부품 개발 및 제조	100.00	30,756	100.00	30,756
행복모아(주)	국 내	사업지원 및 제조	100.00	7,400	100.00	3,000
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)(*1)	국 내	파운드리 사업	100.00	290,172	-	-
SK hynix America Inc.(SK-HYA)	미 국	해외판매법인	97.74	31	97.74	31
SK hynix Deutschland GmbH(SK-HYD)	독 일	해외판매법인	100.00	22,011	100.00	22,011
SK hynix U.K. Ltd.(SK-HYU)	영 국	해외판매법인	100.00	1,775	100.00	1,775
SK hynix Asia Pte. Ltd.(SK-HYS)	싱가포르	해외판매법인	100.00	52,380	100.00	52,380
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.(SK-HYS)(*2)	인 도	해외판매법인	1.00	5	1.00	5
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.(SK-HYH)	홍 콩	해외판매법인	100.00	32,623	100.00	32,623
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.(SK-HYCS)	중 국	해외판매법인	100.00	4,032	100.00	4,032
SK hynix Japan Inc.(SK-HYJ)	일 본	해외판매법인	100.00	42,905	100.00	42,905
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SK-HYT)	대 만	해외판매법인	100.00	37,562	100.00	37,562
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SK-HYQL)	중 국	해외제조법인	90.26	2,520,881	90.26	2,520,881
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SK-HYMC)	중 국	해외제조법인	100.00	238,271	100.00	238,271
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.(SK-HYCW)	중 국	해외판매법인	100.00	237	100.00	237
SK hynix Italy S.r.l.(SK-HYT)	이탈리아	해외연구개발법인	100.00	18	100.00	18
SK hynix memory solutions Inc.(SK-HMS)	미 국	해외연구개발법인	100.00	311,283	100.00	311,283
SK hynix Flash Solution Taiwan(SK-HYFST)	대 만	해외연구개발법인	100.00	7,819	100.00	7,819
SK APTECH Ltd.(SKAPTECH)	홍 콩	지주회사	100.00	166,299	100.00	166,299
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.(SK-HYQCL)(*3)	중 국	해외제조법인	-	-	-	-
Softeq Flash Solutions LLC.(SOFTEQ)	벨라루스	해외연구개발법인	99.90	14,579	99.90	14,579
SK hynix Ventures Hong Kong Ltd.(SKH Ventures)	홍 콩	해외투자법인	100.00	2,512	100.00	2,512
MMT(특정금전신탁)(*4)	국 내	특정금전신탁	100.00	1,290,000	100.00	990,000
합 계				5,087,832		4,493,260

- (*1) 당분기 중 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)를 설립하였습니다.
 (*2) 종속기업인 SK hynix Asia Pte. Ltd.(SKHYS)의 종속기업입니다.
 (*3) 종속기업인 SK APTECH Ltd.(SKAPTECH)의 종속기업입니다.
 (*4) 당분기 중 MMT(특정금융신탁)의 취득 및 처분이 발생하였습니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)							
구 분	회사명	소재지	주요영업활동	당분기말		전기말	
				지분율(%)	장부금액	지분율(%)	장부금액
관계기업	Stratio, Inc. (*1)	미 국	반도체 부품 개발 및 제조	9.10	2,194	9.10	2,194
	SK China Company Limited (*1, *2)	중 국	부동산 투자업 등	11.87	257,169	-	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(HITECH)	중 국	반도체 부품 제조	45.00	92,608	45.00	92,608
합 계					351,971		94,802

- (*1) 이사선임권을 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류 하였습니다.
 (*2) 당분기 중 당사가 보유 중인 매도가능금융자산의 현물출자 등을 통하여 신규 취득하였습니다.

11. 매도가능금융자산

당분기와 전분기 중 매도가능금융자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	143,590	130,645
취득금액	21,798	12,798
처분금액(*)	(114,180)	(2,294)
기말장부금액	51,208	141,149

(*) 당분기 중 SKY Property의 지분(장부금액 112,360백만원) 전액을 현물출자하여 관계기업 SK China Company Limited의 지분을 취득하였으며, 관련하여 30,848백만원의 매도가능금융자산처분이익을 인식하였습니다.

12. 유형자산

(1) 당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	16,071,281	13,853,549
취득금액	6,160,733	3,869,953
처분금액	(275,023)	(114,063)
감가상각	(2,756,754)	(2,376,308)
손상차손	-	(3,746)
기타	(55,250)	-
기말장부금액	19,144,987	15,229,385

(2) 당분기말 현재 일부 토지와 건물 등은 당사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.(주석 29 참조)

(3) 금융리스와 운용리스 이용내역

당분기말 현재 당사는 ME Semiconductor Rental First L.L.C. 등으로부터 기계장치 등을 금융리스계약을 통하여 사용하고 있습니다.

당분기말 현재 금융리스 계약에 따른 기계장치 등의 장부금액은 78,868백만원(전기말: 67,245백만원)입니다. 동 기계장치 등은 금융리스부채와 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.

당사는 보유중인 기계장치 중 일부에 대하여 에스케이하이이엔지(주) 등과 운용리스 계약을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 동 운용리스로 제공된 자산의 장부금액은 35,906백만원(전기말: 40,219백만원)입니다.

당분기말 현재 당사는 Macquarie Capital로부터 기계장치를 운용리스계약에 의하여 사용하고 있으며, 기간별 리스료의 지급계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)	
구 분	리스료지급액
1년 이내	178,157
1년 초과	229,682
합 계	407,839

13. 무형자산

(1) 당분기와 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,546,733	1,299,257
취득금액	607,984	365,822
처분금액	(4,887)	(4,992)
상각액	(264,164)	(226,656)
손상차손	(47)	(63)
기타	(277)	-
기말장부금액	1,885,342	1,433,368

(2) 당분기 중 개발활동과 관련하여 발생한 비용 중 개발비 인식요건을 충족하는 411,424백만원(전분기:253,286백만원)은 개발비로 자산화하였으며 연구활동과 관련하여 발생한 비용과 개발비 인식요건을 충족하지 못하는 개발활동 관련비용 1,398,433백만원(전분기:1,291,026백만원)은 정상개발비로 비용인식하였습니다.

14. 투자부동산

(1) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	2,573	2,679
감가상각	(79)	(79)
기말장부금액	2,494	2,600

(2) 당분기 중 발생한 투자부동산의 감가상각비 79백만원(전분기:79백만원)은 전액 매출원가에 포함되어 있습니다.

(3) 당분기 중 투자부동산과 관련하여 발생한 임대수익은 372백만원(전분기:376백만원)입니다.

15. 차입금

(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
단기차입금	114,670	-
유동성장기차입금	242,818	324,029
유동성사채	149,838	320,736
소 계	507,326	644,765
비유동:		
장기차입금	2,283,050	2,035,641
사 채	1,386,757	1,535,381
소 계	3,669,807	3,571,022
합 계	4,177,133	4,215,787

(2) 당분기와 전분기 중 차입금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	4,215,787	3,432,619
신규차입	685,084	2,080,343
차입금상환	(633,531)	(1,327,431)
기 타(*)	(90,207)	(147,475)
기말장부금액	4,177,133	4,038,056

(*) 환율변동효과 및 현재가치할인차금 상각액 등이 포함되어 있습니다.

16. 기타유동부채 및 기타비유동부채

당분기말과 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선수금	188	217
선수수익	118	228
예수금	19,842	33,572
보증예수금	18	718
소 계	20,166	34,735
비유동:		
기타장기종업원급여부채	59,684	59,304
합 계	79,850	94,039

17. 충당부채

(1) 당분기와 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사 용	환 입	기 말
계약손실충당부채	163	8,329	-	-	8,492
판매보증충당부채	2,988	1,212	(226)	-	3,974
반품충당부채	16,346	98,108	(79,830)	-	34,624
소송충당부채	400	4,391	-	(400)	4,391
배출부채	26,108	4,349	(695)	-	29,762
합 계	46,005	116,389	(80,751)	(400)	81,243

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사 용	환 입	기 말
계약손실충당부채	-	1,601	-	-	1,601
판매보증충당부채	2,821	5,496	(5,226)	-	3,091
반품충당부채	21,528	26,306	(34,993)	-	12,841
소송충당부채	1,523	-	(1,097)	(426)	-
배출부채	6,081	14,016	(1,339)	-	18,758
합 계	31,953	47,419	(42,655)	(426)	36,291

(2) 계약손실충당부채

당사는 해외소재 종속기업인 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.로부터 Wafer반 제품을 구매하고 있으며, 당분기말 현재 동 종속기업이 생산중인 재공품에 대해서 구매 후 추가 가공하여 판매할 경우 예상되는 매출손실을 계약손실충당부채전입액으로 하여 매출원가에 가산하고 충당부채의 과목으로 계상하고 있습니다.

(3) 판매보증충당부채

당사는 무상 품질보증수리 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거 경험을 등을 기초로 추정하여 충당부채로 인식하고 있습니다.

(4) 반품충당부채

당사는 판매 후 반품이 예상되는 매출액을 합리적으로 추정하여 매출액과 매출원가에서 각각 차감하고 매출총이익에 해당하는 금액과 반품과 관련하여 발생할 것으로 예상되는 비용의 합계액을 충당부채로 설정하고 있습니다.

(5) 소송충당부채

당사는 소송 혹은 분쟁 등과 관련하여 경제적 효익이 내재된 자원이 유출될 가능성이 높고 그 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 그 금액을 충당부채로 계상하고 있습니다.

(6) 배출부채

당사는 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 추정하여 중당부채로 인식하고 있습니다.

18. 종업원급여

(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	1,274,742	1,157,053
사외적립자산의 공정가치	(848,622)	(859,100)
합 계	426,120	297,953

(2) 당분기말과 전기말 현재 보험수리적 평가를 위해 사용된 주요 추정은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말(%)	전기말(%)
할인율	4.00	4.00
미래임금상승률	5.48	5.48

(3) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,157,053	1,020,198
당기근무원가	109,918	107,846
이자원가	34,112	30,196
관계사전출입액	(2,175)	(2,233)
퇴직급여지급액	(24,166)	(21,779)
기말장부금액	1,274,742	1,134,228

(4) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	859,100	547,708
이자수익	25,381	16,162
관계사전출입액	112	(1,332)
퇴직급여지급액	(23,450)	(14,274)
재측정요소	(12,521)	(6,435)
기말장부금액	848,622	541,829

(5) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
당기근무원가	36,874	109,918	34,275	107,846
순이자원가	2,853	8,731	4,687	14,034
합 계	39,727	118,649	38,962	121,880

(6) 당분기말과 전기말 현재 사외적립자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
예적금	847,250	857,615
기 타	1,372	1,485
합 계	848,622	859,100

한편, 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 실제수익은 각각 12,860백만원과 9,727백만원입니다.

(7) 당사는 임금피크제 대상 종업원에 대하여 확정기여형 연금제도를 시행하고 있습니다. 확정기여형 연금제도와 관련하여 당분기 중 비용으로 인식한 금액은 48백만원입니다.

19. 파생상품거래

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타금융부채로 인식하고 있는 파생금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
이자율스왑	-	288

(2) 당분기와 전분기 중 파생상품 거래와 관련하여 금융수익 및 금융비용으로 인식한 평가손익 및 거래손익은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)								
구 분	평가이익		평가손실		거래이익		거래손실	
	3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적
이자율스왑	(188)	-	-	-	492	902	304	913

② 전분기

(단위: 백만원)								
구 분	평가이익		평가손실		거래이익		거래손실	
	3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적
이자율스왑	128	248	-	-	292	876	406	1,218

20. 자본금, 자본잉여금 및 기타자본

(1) 당분기말 현재 당사의 수권주식수는 9,000,000천주이고, 1주당 액면금액은 5,000원입니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 보통주 발행주식수, 보통주자본금, 자본잉여금 및 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천주)		
구 분	당분기말	전기말
보통주 발행주식수(*)	731,530	731,530
보통주자본금	3,657,652	3,657,652
자본잉여금:		
주식발행초과금	3,625,797	3,625,797
기 타	557,767	557,767
합 계	4,183,564	4,183,564
기타자본:		
자기주식	(771,913)	(771,913)
주식선택권	548	-
합 계	(771,365)	(771,913)
자기주식수	22,001	22,001

(*) 당분기말 현재 과거 이익소각의 영향으로 인하여 상장주식 총수 728,002천주와 발행주식 총수에 차이가 있습니다.

(2) 당분기와 전기 중 당사의 유통주식수는 706,002천주로 변동이 없습니다.

21. 이익잉여금

당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
법정적립금(*1)	108,354	65,994
임의적립금(*2)	235,506	235,506
미처분이익잉여금(*3)	22,490,664	15,720,710
합 계	22,834,524	16,022,210

(*1) 당사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다.

(*2) 임의적립금은 기술개발준비금으로 구성되어 있습니다.

(*3) 2017년 3월 24일자 주주총회에서 배당금 423,601백만원의 지급이 결의되었으며, 당분기 중 전액 지급하였습니다.

22. 판매비와관리비

당분기와 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
급 여	93,245	258,134	66,607	171,760
퇴직급여	6,311	18,906	4,328	20,185
복리후생비	14,847	43,746	14,800	46,112
지급수수료	51,081	156,039	50,058	150,956
감가상각비	20,596	59,735	15,966	50,445
무형자산상각비	103,239	232,985	46,990	208,132
운반보관비	6,961	20,248	5,473	16,538
송무비	8,567	24,948	924	4,067
임차료	599	2,564	1,068	3,321
세금과공과	1,349	4,035	1,053	5,505
교육훈련비	6,643	16,250	2,994	12,427
광고선전비	14,927	36,262	14,636	30,518
소모품비	17,013	46,798	17,230	37,887
수선비	13,316	19,287	1,129	3,646
여비교통비	2,018	5,422	1,764	4,812
기 타	6,400	34,642	5,858	28,156
소 계	367,112	980,001	250,878	794,467
경상개발비 :				
연구개발비 총지출액	637,545	1,809,857	505,666	1,544,312
개발비 자산화	(115,819)	(411,424)	(92,896)	(253,286)
소 계	521,726	1,398,433	412,770	1,291,026
합 계	888,838	2,378,434	663,648	2,085,493

23. 비용의 성격별 분류

당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
제품 및 재공품의 변동	(504)	(344,716)	(38,782)	(263,056)
원재료, 저장품 및 소모품 사용	1,448,807	4,022,588	1,210,072	3,502,750
종업원급여	690,314	1,916,500	494,059	1,319,708
감가상각 및 무형자산상각	1,055,206	2,934,758	870,037	2,565,192
기술료	55,946	163,691	57,159	172,607
지급수수료	253,737	730,021	222,372	650,713
동력 및 수도광열비	199,308	575,879	180,460	510,604
수선비	203,932	540,582	132,255	345,767
외주가공비	323,040	915,409	267,161	782,728
기 타	131,078	371,700	96,902	307,169
합 계(*)	4,360,864	11,826,412	3,491,695	9,894,182

(*) 포괄손익계산서상의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

24. 금융수익 및 금융비용

당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
금융수익:				
이자수익	13,465	31,421	6,557	24,775
배당금수익	-	17,619	-	37,863
외환차이	151,275	555,347	207,843	514,125
파생상품관련이익	304	902	420	1,124
당기손익인식금융자산평가이익	862	1,794	96	281
당기손익인식금융자산처분이익	1,317	3,148	659	4,420
매도가능금융자산처분이익	30,945	30,945	-	-
소 계	198,168	641,176	215,575	582,588
금융비용:				
이자비용	31,228	92,994	28,212	91,341
외환차이	86,961	495,693	189,895	501,322
매도가능금융자산처분손실	1	1	-	-
파생상품관련손실	304	913	406	1,218
소 계	118,494	589,601	218,513	593,881
순금융수익(비용)	79,674	51,575	(2,938)	(11,293)

25. 기타영업외수익과 기타영업외비용

(1) 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
유형자산처분이익	21,491	36,132	2,293	4,880
종속기업및관계기업투자주식처분이익	1,916	5,987	2,044	8,788
기 타	2,317	27,841	2,329	7,955
합 계	25,724	69,960	6,666	21,623

(2) 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
유형자산처분손실	2,270	15,012	1,676	4,075
무형자산처분손실	705	3,901	1,719	3,415
매출채권처분손실	349	1,218	204	204
기부금	2,865	24,157	20,801	24,460
유형자산손상차손	-	-	-	3,746
무형자산손상차손	47	47	26	63
기 타	6,829	9,843	1,828	27,372
합 계	13,065	54,178	26,254	63,335

26. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 법인세비용에는 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항이 포함되어 있습니다.

27. 주당이익

주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적 보통주 1주에 대한 순이익을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기본주당이익

(단위: 백만원, 주)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
보통주분기순이익	2,938,555	7,248,436	465,852	1,178,258
가중평균유통보통주식수(*)	706,001,795	706,001,795	706,001,795	706,001,795
기본주당이익	4,162 원	10,267 원	660 원	1,669 원

(*) 주당이익을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
발행주식수	728,002,365	728,002,365	728,002,365	728,002,365
자기주식 효과	(22,000,570)	(22,000,570)	(22,000,570)	(22,000,570)
가중평균유통보통주식수	706,001,795	706,001,795	706,001,795	706,001,795

(2) 희석주당이익

(단위: 백만원, 주)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
보통주희석분기순이익	2,938,555	7,248,436	465,852	1,178,258
가중평균희석유통보통주식수(*)	706,046,520	706,010,823	706,001,795	706,001,795
희석주당이익	4,162 원	10,267 원	660 원	1,669 원

(*) 희석주당이익을 계산하기 위한 가중평균희석유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
가중평균유통보통주식수	706,001,795	706,001,795	706,001,795	706,001,795
주식선택권 효과	44,725	9,028	-	-
가중평균희석유통보통주식수	706,046,520	706,010,823	706,001,795	706,001,795

28. 특수관계자 거래

(1) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명
종속기업	SK-HYA외 23개사(*)
관계기업	Stratio, Inc., SK China Company Limited, Gemini Partners Pte. Ltd., TCL Fund
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.
기타특수관계자	당사에 유의적인 영향력을 행사하는 SK텔레콤(주) 및 그 종속기업과 SK텔레콤(주)의 지배기업인 SK(주)와 그 종속기업

(*) 종속기업인 MMT(특정금전신탁)는 제외하였습니다.

(2) 당분기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명	지배기업	비 고
에스케이하이이엔지(주)	당사	국내종속기업
에스케이하이시스템(주)	당사	국내종속기업
(주)실리콘화일	당사	국내종속기업
행복모아(주)	당사	국내종속기업
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)(*)	당사	국내종속기업
SK hynix America Inc.(SK-HYA)	당사	해외판매법인
SK hynix Deutschland GmbH(SK-HYD)	당사	해외판매법인
SK hynix U.K. Ltd.(SK-HYU)	당사	해외판매법인
SK hynix Asia Pte. Ltd.(SK-HYS)	당사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.(SK-HYS)	SK-HYS	해외판매법인
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.(SK-HYH)	당사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.(SK-HYCS)	당사	해외판매법인
SK hynix Japan Inc.(SK-HYJ)	당사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SK-HYT)	당사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SK-HYCL)	당사	해외제조법인
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SK-HYMC)	당사	해외제조법인
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.(SK-HYCW)	당사	해외판매법인
SK hynix Italy S.r.l.(SK-HYT)	당사	해외연구개발법인
SK hynix memory solutions Inc.(SK-HMS)	당사	해외연구개발법인
SK hynix Flash Solution Taiwan(SK-HYFST)	당사	해외연구개발법인
SK APTECH Ltd.(SKAPTECH)	당사	Holding Company
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.(SK-HYQQL)	SKAPTECH	해외제조법인
Softeq Flash Solutions LLC.(SOFTEQ)	당사	해외연구개발법인
SK hynix Ventures Hong Kong Ltd.(SKH Ventures)	당사	해외투자법인

(*) 당분기 중 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)를 설립하였습니다.

(3) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)									
구 분	회사명	영업수익 등		영업비용 등		자산취득		배당금수익	
		3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
종속기업	해외판매법인	7,723,970	19,950,122	53,059	134,004	267,742	1,197,294	-	2,494
	해외제조법인(*1)	5,219	79,115	645,292	1,787,002	4,614	9,956	-	-
	연구개발법인	2,253	2,593	54,528	139,711	-	-	-	297
	국내종속기업	255,318	275,691	156,688	312,665	36,717	82,871	-	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	260	5,726	153,585	442,061	-	-	-	14,828
기타특수관계자	SK텔레콤주(*2)	10	156	1,970	93,661	15,679	21,225	-	-
	SK주(*3)	48	146	54,029	113,819	20,926	90,699	-	-
	SK건설주	59	199	-	-	289,694	606,188	-	-
	SK에너지주	245	946	8,801	42,086	-	-	-	-
	SK네트웍스주	-	-	164	595	-	-	-	-
	에스케이씨솔믹스주	-	-	862	13,564	167	650	-	-
	충청에너지서비스주	-	-	1,600	11,920	-	-	-	-
	행복나래주	5	14	107,530	270,275	10,206	21,409	-	-
	SK머티리얼즈주	-	-	10,241	27,871	-	-	-	-
	SK실트론주	482	482	16,629	16,629	-	-	-	-
	기타	15,161	15,186	20,607	95,999	1,806	5,980	-	-
합 계		8,003,030	20,330,376	1,285,585	3,501,862	647,551	2,036,272	-	17,619

(*1) 해외제조법인에 대한 누적 영업수익 등에는 자산 처분액 75,708백만원(3개월 : 4,006백만원)이 포함되어 있습니다.

(*2) 영업비용 등에는 배당금 87,660백만원이 포함되어 있습니다.

(*3) 당사는 SK주와 2012년 3월부터 SK브랜드 사용을 위하여 매출액의 일정비율에 해당하는 금액을 사용료로 지급하기로 약정하였으며 당분기 중 발생한 SK브랜드 사용료는 25,633백만원(전분기 : 27,878백만원)입니다.

② 전분기

(단위: 백만원)									
구 분	회사명	영업수익 등		영업비용 등		자산취득		배당금수익	
		3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
중속기업	해외판매법인	3,824,038	10,636,049	34,512	108,223	244,639	772,602	-	5,338
	해외제조법인(*1)	2,163	6,957	574,260	1,745,157	7,955	32,699	-	-
	해외연구개발법인	157	157	51,120	138,835	-	-	-	781
	국내중속기업	14,855	40,827	81,320	227,524	-	-	-	11,000
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	126	414	135,902	427,099	-	-	-	20,726
기타특수관계자	SK텔레콤(*2)	9	215	1,934	78,603	4,083	8,338	-	-
	SK(주)	33	202	31,401	78,902	21,198	80,876	-	-
	SK건설(주)	70	210	750	20,950	59,389	188,017	-	-
	SK에너지(주)	220	879	5,960	37,344	-	-	-	-
	SK네트웍스(주)	-	-	424	1,239	-	-	-	-
	에스케이씨솔믹스(주)	-	-	6,103	16,591	88	191	-	-
	충청에너지서비스(주)	-	-	1,539	12,803	-	-	-	-
	행복나래(주)	5	11	48,828	78,486	4,124	5,549	-	-
	기 타	2	4	28,478	84,466	828	6,336	-	-
합 계		3,841,678	10,685,925	1,002,531	3,056,222	342,304	1,094,608	-	37,845

(*1) 해외제조법인에 대한 누적 영업수익 등에는 자산 처분액 4,770백만원(3개월 : 1,590백만원)이 포함되어 있습니다.

(*2) 영업비용 등에는 배당금 73,050백만원이 포함되어 있습니다.

(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)				
구 분	회사명	채권 등		채무 등
		매출채권 등	대여금	미지급금 등
종속기업	해외판매법인	4,816,918	-	255,487
	해외제조법인	24,880	-	425,231
	해외연구개발법인	24	-	14,562
	국내종속기업 (*1)	23,486	2,900	121,036
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	266	-	106,331
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	-	-	4,617
	SK(주)	5,365	-	91,906
	SK건설(주)	22	-	325,499
	SK에너지(주)	66	-	2,734
	SK네트웍스(주)	-	-	9
	에스케이씨솔믹스(주)	-	-	1,483
	충청에너지서비스(주)	-	-	542
	행복나래(주)	2	-	24,212
	SK머티리얼즈(주)	-	-	10,450
	SK실트론(주)(*2)	150,226	-	9,866
	기타	2	-	39,436
합 계		5,021,257	2,900	1,433,401

(*1) 당분기 중 행복모아(주)에 2,900백만원을 대여하였습니다.

(*2) 당사는 Wafer 수급 안정성 확보를 위하여 SK실트론(주)와 2019년부터 2023년까지 Wafer 구매계약을 체결하였으며, 당분기 중 구매대금 150,000백만원을 선급하였습니다. 한편, SK실트론(주)는 당사가 선급한 150,000백만원을 보증하기 위하여 투자자산 일부를 양도담보로 제공하기로 약정하였습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채권 등	채무 등
		매출채권 등	미지급금 등
종속기업	해외판매법인(*)	2,768,314	177,573
	해외제조법인	34,749	533,485
	해외연구개발법인	57	15,387
	국내종속기업	1,310	56,689
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	-	99,328
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	92	4,267
	SK(주)	6,214	94,369
	SK건설(주)	26	530,780
	SK에너지(주)	85	6,544
	SK네트웍스(주)	-	921
	에스케이씨솔믹스(주)	-	8,966
	충청에너지서비스(주)	-	1,804
	행복나래(주)	2	17,807
	SK머티리얼즈(주)	-	8,043
	기 타	2	42,353
합 계		2,810,851	1,598,316

(*) 전기 중 SK hynix America Inc.(SKHYA)으로부터 대여금 51,908백만원을 회수하였습니다.

(5) 주요경영진에 대한 보상

당사의 주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회 의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 당분기와 전분기 중 인식한 주요경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	32,418	79,001	15,794	39,730
퇴직급여	2,167	6,621	2,059	6,176
주식보상비용	263	548	-	-
기타	3	9	3	10
합 계	34,851	86,179	17,856	45,916

(6) 당분기와 전분기 중 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	회사명	영업수익 등		영업비용 등	
		3개월	누적	3개월	누적
대규모기업집단소속회사	SK케미칼(주)	-	-	304	840

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	회사명	영업수익 등		영업비용 등	
		3개월	누적	3개월	누적
대규모기업집단소속회사	SK케미칼(주)	-	-	84	127

(7) 당분기말과 전기말 현재 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
대규모기업집단소속회사	SK케미칼주	-	307

② 전기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
대규모기업집단소속회사	SK케미칼주	-	183

29. 우발부채와 약정사항

(1) 당분기말 현재 당사와 관련하여 계류 중인 중요한 소송사건 및 클레임 등의 내역은 다음과 같습니다.

① Netlist, Inc.의 특허 침해 소송

Netlist, Inc.는 당사와 SK hynix America Inc. 등 당사의 종속기업들을 상대로 다수의 특허를 침해했다는 소송을 2016년 8월 31일 및 2017년 6월 14일 미국 캘리포니아 중부지방법원에, 2016년 9월 1일 및 2017년 10월 31일 미국국제무역위원회에, 2017년 7월 11일 독일 뮌헨 지방법원 및 중국 베이징 지식재산법원에 각각 제기하여 소송이 진행 중에 있습니다. 당분기말 현재 미국 등 각 지역에서 제기된 Netlist, Inc.의 특허 침해 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태이며, 당분기말 현재 최종결과를 예측할 수 없습니다.

② 소송 및 특허 클레임 등

당분기말 현재 당사는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며 향후 자원의 유출가능성이 높고 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

(2) 특허라이선스 계약

당사는 당분기말 현재 제품생산과 관련한 다수의 특허라이선스 계약을 체결하고 있습니다. 동 계약에 의한 Royalty는 Lump-sum royalty 및 Running royalty의 형식으로 지급되며, Lump-sum royalty 지급액은 특허라이선스 계약기간에 따라 정액으로 안분된 금액을 비용으로 처리하고 있습니다.

(3) 공업용수공급계약

당사는 베올리아워터산업개발(주) ("Veolia")와 2018년 3월까지 공업용수를 공급받는 계약을 체결하고 있습니다. 동 계약에 의하면 당사는 계약기간 동안 Base Service Charge ("BSC")와 공급받는 공업용수 사용량에 일정액을 적용하여 계산된 Additional Service Charge ("ASC")를 Veolia에 지급해야 합니다.

(4) HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. ("HITECH")와 후공정서비스계약
당사는 HITECH와 후공정서비스를 공급받는 계약을 체결하고 있으며 서비스 제공 범위는 Package, Package Test, Module 등 입니다. 당사는 동 계약에 따라 HITECH 장비 우선 사용권을 보유하고, 후공정서비스 대가로 HITECH에 일정액의 약정수익을 보장하는 가격을 지불하기로 하였습니다.

(5) 당분기말 현재 당사가 제공한 담보자산 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)			
구 분(*)	장부금액	담보설정액	비 고
건 물	94	1,219,946	시설자금대출 관련 등
기계장치	1,098,451		
합 계	1,098,545	1,219,946	

(*) 상기 담보제공자산 이외에 당사의 금융리스자산은 해당 금융리스 계약에 의하여 관련 금융리스 부채의 담보로 제공되어 있습니다.

(6) 당분기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 여신한도 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만USD)			
금융기관	약정사항	한도금액	
		통 화	금 액
하나은행 등	Usance 등 수입금융약정	USD	265
	매입외환 등 수출금융약정	USD	250
	수출·수입 포괄한도약정	USD	960

(7) 당분기말 현재 당사가 타인에게 제공한 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	금 액	비 고
종업원	8	우리사주관련 금융기관 차입금 지급보증

(8) 당분기말 현재 기표되지 않은 유형자산에 대한 구매 약정액은 870,662백만원(전기말: 261,729백만원)입니다.

(9) 도시바 반도체 사업지분 투자

당사는 도시바 반도체 사업의 지분투자와 관련하여 Bain Capital이 포함된 컨소시엄(이하 "Bain 컨소시엄")에 참여하였으며, 2017년 9월 27일의 이사회 결의를 통하여 특수목적법인인 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP에 대해 JPY 266,000백만의 출자 및 BCPE Pangea Cayman2 Limited가 발행한 전환사채 JPY 129,000백만의 취득을 결정하였습니다. 당분기 중 동 출자 및 취득계약을 포함하여 Bain 컨소시엄과 도시바 간의 계약이 체결되었습니다.

30. 영업으로부터 창출된 현금

(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
분기순이익	7,248,436	1,178,258
조정항목:		
법인세비용	1,820,049	283,401
이자비용	92,994	91,341
이자수익	(31,421)	(24,775)
유형자산 감가상각비	2,756,754	2,376,308
투자부동산 감가상각비	79	79
무형자산상각비	264,164	226,656
유형자산처분손실	15,012	4,075
무형자산처분손실	3,901	3,415
유형자산손상차손	-	3,746
무형자산손상차손	47	63
퇴직급여	118,649	121,880
외화환산손실	24,607	69,020

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
파생상품관련손익	11	94
유형자산처분이익	(36,132)	(4,880)
외화환산이익	(180,786)	(183,362)
매도가능금융자산처분이익	(30,945)	-
종속기업투자주식처분이익	(5,987)	(8,788)
당기손익인식금융상품처분이익	(3,148)	(4,420)
당기손익인식금융상품평가이익	(1,794)	(281)
배당금수익	(17,619)	(37,863)
기 타	1,504	1,657
운전자본의 변동:		
매출채권의 감소(증가)	(1,984,671)	758,157
기타수취채권의 감소(증가)	8,721	9,889
재고자산의 감소(증가)	(499,296)	(287,303)
기타자산의 감소(증가)	(98,692)	74,415
매입채무의 증가(감소)	(81,638)	(101,653)
미지급금의 증가(감소)	(9,882)	(264,281)
기타지급채무의 증가(감소)	266,187	(473,540)
총당부채의 증가(감소)	35,238	4,338
기타부채의 증가(감소)	(11,495)	(4,380)
퇴직금의 지급	(13,556)	(13,981)
영업으로부터 창출된 현금	9,649,291	3,797,285

(2) 당분기와 전분기 중 유동성 대체를 제외한 중요한 현금의 유입·유출이 없는 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
에스케이하이닉스 시스템아이씨주에 대한 영업양도	132,841	-
SK China Company Limited에 대한 현물출자	143,208	-
미수금의 제각	-	34,861

31. 주식기준보상

(1) 당사는 당분기 중 당사의 주요 경영진에게 주식결제형 주식선택권을 부여하였으며, 당분기말 현재 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)								
구 분	총부여수량	소멸수량	행사수량	미행사수량	부여일	약정응역제공기간	행사가능기간	행사가격
1차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2019.03.24	2019.03.25 ~ 2022.03.24	48,400원
2차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2020.03.24	2020.03.25 ~ 2023.03.24	52,280원
3차	99,600	-	-	99,600	2017.03.24	2017.03.24 ~ 2021.03.24	2021.03.25 ~ 2024.03.24	56,460원
합 계	298,800	-	-	298,800				

(2) 공정가치 측정

이항모형을 적용하여 공정가액 접근법에 의한 보상원가를 산정하였으며, 주식결제형 주식기준보상제도의 부여일 현재 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분	1차	2차	3차
기대주가변동성	23.23%	23.23%	23.23%
부여일 공정가치	10,026 원	9,613 원	9,296 원
배당수익률	1.20%	1.20%	1.20%
무위험이자율(국공채 수익률)	1.86%	1.95%	2.07%

(3) 당사가 당분기 중 인식한 주식보상비용은 548백만원 입니다.

32. 영업양도

당사는 당분기 중 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)를 설립하였으며, 2017년 5월 24일의 이사회 결의를 통해 343,295백만원을 유상증자하고, 당사의 파운드리 사업과 관련한 자산 등을 포괄적 양도하였습니다. 양도일(2017년 7월 1일) 현재 영업양도로 수취한 대가와 양도한 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)	
구 분	금 액
I. 양도한 자산	137,409
재고자산	81,812
유형자산	55,250
무형자산	277
기타비유동자산	70
II. 양도한 부채	4,568
기타유동부채	755
기타지급채무	1,125
확정급여부채	2,443
기타비유동부채	245
III. 양도한 순자산금액 (I - II)	132,841
IV. 수취한 양도대가	185,964
V. 차이금액 (IV - III)	53,123

한편, 동 영업양도 거래는 상업적 실질이 없으므로 양도한 순자산 장부금액과 수취한 양도대가의 차이금액을 투자주식의 장부금액에서 조정하였습니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 부문별 연결재무정보

(1) 사업부문별 연결재무정보

당사는 반도체제조업부문의 매출액과 자산총액이 전체부문의 90%를 초과하여 지배적 단일사업 부문으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 지역별 재무 정보

(단위 : 백만원)

구 분	제70기 3분기	제69기	제68기
본국(대한민국)			
1. 매출액			
외부매출액	907,950	1,099,426	1,204,642
지역간내부매출액	20,432,929	16,061,704	18,066,801
계	21,340,879	17,161,131	19,271,443
2. 영업이익	9,014,542	3,020,730	5,082,111
3. 자산	40,192,113	31,527,834	28,904,135
미주			
1. 매출액			
외부매출액	7,575,608	5,397,943	7,549,622
지역간내부매출액	122,994	124,781	165,502
계	7,698,602	5,522,725	7,715,124
2. 영업이익	77,313	38,260	32,267
3. 자산	2,563,367	1,656,389	1,618,975
중국			
1. 매출액			
외부매출액	6,977,013	5,960,235	4,496,357
지역간내부매출액	1,902,197	2,482,175	3,071,138
계	8,879,210	8,442,411	7,567,495
2. 영업이익	119,033	129,972	168,337
3. 자산	5,725,780	5,242,887	5,173,018
아시아			
1. 매출액			
외부매출액	4,487,477	3,897,774	4,435,659
지역간내부매출액	9,749	23,131	33,922
계	4,497,226	3,920,906	4,469,580
2. 영업이익	52	9,771	9,046
3. 자산	1,605,751	911,664	824,125

구 분	제70기 3분기	제69기	제68기
유럽			
1. 매출액			
외부매출액	1,133,832	842,595	1,111,719
지역간내부매출액	14,345	26,101	21,716
계	1,148,177	868,697	1,133,435
2. 영업이익	3,110	2,213	4,214
3. 자산	427,874	237,834	238,111
합계			
1. 매출액			
외부매출액	21,081,881	17,197,975	18,797,998
지역간내부매출액	22,482,213	18,717,894	21,359,078
계	43,564,094	35,915,868	40,157,077
2. 영업이익			
연결조정	41,443	75,799	40,126
계	9,255,492	3,276,746	5,336,100
3. 자산			
연결조정	(9,784,431)	(7,360,582)	(7,080,459)
계	40,730,453	32,216,026	29,677,906

나. 대손충당금 설정현황

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정비율
제70기 3분기	매출채권	5,262,433	1,857	0
	장· 단기 대여금	12,768	10	0
	장· 단기 미수금	10,803	1,401	13
	장· 단기 미수수익	21,387	0	0
	장· 단기 보증금	34,704	397	1
	장기성 외상매출금	0	0	

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정비율
	장단기성 예치금	1,175	1,022	87
	계	5,343,271	4,686	0
제69기 연간	매출채권	3,253,489	1,837	0
	장· 단기 대여금	9,163	10	0
	장· 단기 미수금	13,003	1,371	11
	장· 단기 미수수익	9,732	0	0
	장· 단기 보증금	34,812	389	1
	장기성 외상매출금	0	0	
	장단기성 예치금	1,238	1,077	87
	계	3,321,437	4,684	0
제68기 연간	매출채권	2,631,422	2,975	0
	장· 단기 대여금	9,890	0	0
	장· 단기 미수금	198,208	6,186	3
	장· 단기 미수수익	18,126	0	0
	장· 단기 보증금	36,295	385	1
	장기성 외상매출금	0	0	
	장단기성 예치금	1,262	1,005	80
	계	2,895,204	10,550	0
제67기 연간	매출채권	3,735,845	2,919	0
	장· 단기 대여금	10,710	6	0
	장· 단기 미수금	874,772	6,424	1
	장· 단기 미수수익	28,337		0
	장· 단기 보증금	33,487	326	1
	장기성 외상매출금			
	장단기성 예치금	1,271	946	74
	계	4,684,422	10,621	0

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 대손충당금 변동 현황

(단위 : 백만원)

구 분	제70기 3분기	제69기	제68기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	4,684	10,550	10,621
2. 순대손처리액(①-②±③)	-	306	6
① 대손처리액(상각채권액)	-	306	6
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	2	(5,560)	(65)
4. 기말 대손충당금 잔액합계	4,686	4,684	10,550

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

- 거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정

구분		설정 기준
매출채권	1)정상채권	-과거 경험률을 바탕으로 설정
	2)장기채권	-거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정 -담보 설정금액 有 => 회수가능성이 불확실한 경우 담보 미설정 부분 100% 설정 -담보 설정금액 無 => 회수가능성이 불확실한 경우 100% 설정

* 연결대상회사 매출채권 총당금 설정 제외

(4) 당 보고기간말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분		6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	일반	5,262,433	0	0	0	5,262,433
	특수관계자	0	0	0	0	0
	계	5,262,433	0	0	0	5,262,433
구성비율		100.0%	0.0%	0%	0.0%	100.0%

다. 재고자산 현황 등

(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제70기 3분기	제69기	제68기	비고
반도체	제품	414,958	391,503	613,382	-
	재공품	1,519,370	1,130,493	848,199	-
	원재료	314,573	260,677	222,742	-
	저장품	274,409	194,678	164,156	-
	미착품	34,093	48,847	74,898	-
	합 계	2,557,403	2,026,198	1,923,376	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷ 기말자산총계× 100]		6.3%	6.3%	6.5%	-
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷ {(기초재고+기말재고)÷ 2}]		5.4회	5.5회	6.1회	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 재고자산의 실사내역

실사내역	실사 일자	입회자	비고
제품	2017-01-01	삼정회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-
제품	2016-01-01	삼정회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-
제품	2015-01-01	삼정회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			-
원부자재			-

(3) 장기체화재고 등 내역

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 2017년 3분기말 현재 재고자산에 대한 평가 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가충당금	당기말잔액	비고
제 품	513,405	513,405	(98,447)	414,958	-
재공품	1,568,168	1,568,168	(48,798)	1,519,370	-
원재료	350,909	350,909	(36,336)	314,573	-
저장품	281,462	281,462	(7,053)	274,409	-
미착품	34,093	34,093	-	34,093	-
합 계	2,748,037	2,748,037	(190,634)	2,557,403	-

라. 공정가치

(1) 공정가치 평가방법

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

(2) 공정가치 평가내역

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	2,237,593	-	2,237,593	-	2,237,593
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
현금및현금성자산(*1)	1,123,119	-	-	-	-
단기금융상품(*1)	2,953,910	-	-	-	-
매출채권(*1)	5,260,576	-	-	-	-
기타수취채권(*1)	78,009	-	-	-	-
기타금융자산(*1)	595	-	-	-	-
매도가능금융자산(*1,2)	55,378	-	-	-	-
소 계	9,471,587	-	-	-	-
금융자산 합계	11,709,180	-	2,237,593	-	2,237,593
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*1)	745,056	-	-	-	-
미지급금(*1)	1,501,816	-	-	-	-
기타지급채무(*1)	1,037,650	-	-	-	-
차입금	4,303,538	-	4,319,311	-	4,319,311
금융부채 합계	7,588,060	-	4,319,311	-	4,319,311

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	1,570,172	-	1,570,172	-	1,570,172
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*1)	613,786	-	-	-	-
단기금융상품(*1)	1,951,721	-	-	-	-
매출채권(*1)	3,251,652	-	-	-	-
기타수취채권(*1)	65,101	-	-	-	-
기타금융자산(*1)	423	-	-	-	-
매도가능금융자산(*1,2)	147,779	-	-	-	-
소 계	6,030,462	-	-	-	-
합 계	7,600,634	-	1,570,172	-	1,570,172
공정가치로 측정되는 금융부채:					
기타금융부채	288	-	288	-	288
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*1)	696,144	-	-	-	-
미지급금(*1)	1,606,417	-	-	-	-
기타지급채무(*1)	712,580	-	-	-	-
차입금	4,335,978	-	4,366,234	-	4,366,234
소 계	7,351,119	-	4,366,234	-	4,366,234
합 계	7,351,407	-	4,366,522	-	4,366,522

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융 자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

(*2) 동일한 상품(즉 수준 1의 투입변수)에 대한 활성시장에서 공시되는 가격이 없는 지분 상품에 해당하여 다른 방법으로 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없으므로, 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'에 따라 원가로 측정하였습니다.

③ 가치평가기법

수준 2의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1과 수준 2 및 수준 3간의 대체는 없습니다.

마. 채무증권 발행실적 등

[연결 기준이며, 개별 기준은 연결 기준과 동일]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면 총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2012년 09월 04일	200,000	3.72	A (NICE신평/한기평/한신평)	2017년 09월 04일	상환완료 (17.09.04)	신한금융투자
SK하이닉스(주)	회사채	사모	2012년 05월 30일	550,000	5.35	A (한신평)	2019년 05월 30일	일부상환	삼성증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 08월 26일	210,000	2.27	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2020년 08월 26일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 08월 26일	140,000	2.63	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2022년 08월 26일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 11월 25일	70,000	2.26	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2018년 11월 25일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 11월 25일	100,000	2.56	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2020년 11월 25일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2015년 11월 25일	10,000	2.75	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2022년 11월 25일	미상환	한국투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 02월 19일	70,000	1.74	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2018년 02월 19일	미상환	엔에이치투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 02월 19일	180,000	2.22	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2021년 02월 19일	미상환	엔에이치투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 02월 19일	80,000	2.53	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 02월 19일	미상환	엔에이치투자증권, 케이비투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 05월 27일	80,000	1.73	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2018년 05월 27일	미상환	엔에이치투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2016년 05월 27일	150,000	2.30	AA- (NICE신평/한기평/한신평)	2021년 05월 27일	미상환	엔에이치투자증권
합 계	-	-	-	1,840,000	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2017년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제213회 무보증원화 공모사채	2012년 09월 04일	2017년 09월 04일	200,000	2012년 08월 23일	NH농협투자증권(주)SI팀 (02-750-5524)
재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%이하 유지			
	이행현황	이행(36%)			
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하			
	이행현황	이행(6.8%)			
자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지			
	이행현황	이행(0.084조원)			
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2017.09.05 제출			

※ 동 사채에 대한 재무비율, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황, 이행상황보고서 제출현황은 반기 주기로 제출되는 이행상황보고서와 동일함.

(작성기준일 : 2017년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제214-1회 무보증원화 공모사채	2015년 08월 26일	2020년 08월 26일	210,000	2015년 08월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제214-2회 무보증원화 공모사채	2015년 08월 26일	2022년 08월 26일	140,000	2015년 08월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행(36%)
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하
	이행현황	이행(6.8%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행(0.084조원)
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2017.09.05 제출

※ 동 사채에 대한 재무비율, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황, 이행상황보고서 제출현황은 반기 주기로 제출되는 이행상황보고서와 동일함.

(작성기준일 : 2017년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제215-1회 무보증원화 공모사채	2015년 11월 25일	2018년 11월 25일	70,000	2015년 11월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제215-2회 무보증원화 공모사채	2015년 11월 25일	2020년 11월 25일	100,000	2015년 11월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제215-3회 무보증원화 공모사채	2015년 11월 25일	2022년 11월 25일	10,000	2015년 11월 13일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행(36%)
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하
	이행현황	이행(6.8%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행(0.084조원)
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2017.09.05 제출

※ 동 사채에 대한 재무비율, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황, 이행상황보고서 제출현황은 반기 주기로 제출되는 이행상황보고서와 동일함.

(작성기준일 : 2017년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제216-1회 무보증원화 공모사채	2016년 02월 19일	2018년 02월 19일	70,000	2016년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제216-2회 무보증원화 공모사채	2016년 02월 19일	2021년 02월 19일	180,000	2016년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제216-3회 무보증원화 공모사채	2016년 02월 19일	2023년 02월 19일	80,000	2016년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행(36%)
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하
	이행현황	이행(6.8%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행(0.084조원)
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2017.09.05 제출

※ 동 사채에 대한 재무비율, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황, 이행상황보고서 제출현황은 반기 주기로 제출되는 이행상황보고서와 동일함.

(작성기준일 : 2017년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제217-1회 무보증원화 공사채	2016년 05월 27일	2018년 05월 27일	80,000	2016년 05월 17일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제217-2회 무보증원화 공모사채	2016년 05월 27일	2021년 05월 27일	150,000	2016년 05월 17일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지
	이행현황	이행(36%)
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100% 이하
	이행현황	이행(6.8%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총액 2조원에 해당하는 금액 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행(0.084조원)
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2017.09.05 제출

※ 동 사채에 대한 재무비율, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한현황, 이행상황보고서 제출현황은 반기 주기로 제출되는 이행상황보고서와 동일함.

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
잔액	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	150,000	70,000	210,000	430,000	140,000	90,000	-	1,090,000
	사모	-	450,000	-	-	-	-	-	450,000
	합계	150,000	520,000	210,000	430,000	140,000	90,000	-	1,540,000

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. 감사인의 감사의견 등

1. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

가. 연결감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
제70기 3분기(당기)	삼정회계법인	-	-
제69기(전기)	삼정회계법인	적정	-
제68기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

나. 당해 사업연도의 연결감사(검토)절차 요약

검토대상 재무제표

본인은 별첨된 에스케이하이닉스 주식회사와 그 종속기업의 요약 분기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 요약 분기연결재무제표는 2017년 9월 30일 현재의 요약 연결재무상태표, 2017년과 2016년 9월 30일로 종료하는 3개월 및 9개월 보고기간의 요약 연결포괄손익계산서와 9개월 보고기간의 요약 연결자본변동표 및 요약 연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 요약 분기연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약 분기연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

본인의 책임은 상기 요약 분기연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약 분기연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 한국의 분·반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적절차, 기타의 검토절차에 의해수행됩니

다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

검토의견

본인의 검토결과 상기 요약 분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

기타사항

본인은 2016년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2017년 2월 17일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2016년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

2. 감사인의 감사의견 등

가. 감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
제70기 3분기(당기)	삼정회계법인	-	-
제69기(전기)	삼정회계법인	적정	-
제68기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

나. 당해 사업연도의 감사(검토)절차 요약

검토대상 재무제표

본인은 별첨된 에스케이하이닉스 주식회사의 요약 분기재무제표를 검토하였습니다. 동 요약 분기재무제표는 2017년 9월 30일 현재의 요약 재무상태표, 2017년과 2016년 9월 30일로 종료하는 3개월 및 9개월 보고기간의 요약 포괄손익계산서와 9개월 보고기간의 요약 자본변동표 및 요약 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보

로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 요약 분기재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약 분기재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

본인의 책임은 상기 요약 분기재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약 분기재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 한국의 분·반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적절차, 기타의 검토절차에 의해수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

검토의견

본인의 검토결과 상기 요약 분기재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

기타사항

본인은 2016년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2017년 2월 17일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시 목적으로 첨부한 2016년 12월 31일 현재의 재무상태표는 위의 감사받은 재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

다. 감사용역 체결현황

(단위: 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간
제70기 3분기 (당기)	삼정회계법인	- 분반기 검토 (연결, 별도) - 재무제표감사 (연결, 별도)	950	7,538(주1)
제69기(전기)	삼정회계법인	- 분반기 검토 (연결, 별도) - 재무제표감사 (연결, 별도)	705	10,256
제68기(전전기)	삼정회계법인	- 분반기 검토 (연결, 별도) - 재무제표감사 (연결, 별도)	695	10,034

(주1) 표기의 시간은 제70기 3분기(17.01.01~17.09.30)에 해당하는 소요 시간임

라. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제70기 3분기 (당기)	2017년 8월 3일	이전가격 문서화 용역	2017.08~2018.12	150	-
	2017년 7월 19일	지속경영 프로그램 자문	2017.07~2017.08	100	-
제69기(전기)	2016년 4월 25일	세무 자문 용역	2016.04~2017.03	170	-
	2016년 3월 31일	이전가격 문서화 용역	2016.03~2017.03	60	
	2016년 2월 2일	세무 자문 용역	2016.02~2016.12	20	
제68기(전전기)	2015년 03월 31일	이전가격 문서화 용역	2015.03~2016.03	60	-

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시 작성기준에 따라 분/반기보고서에 본 항목을 기재하지 않습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요

본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 1인의 기타비상무이사, 6인의 사외이사 등 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 2개의 소위원회가 있습니다.

(1) 이사회의 권한 내용

당사의 이사회는 법령과 회사 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의하며, 또한 이사 및 경영진의 직무집행을 감독할 수 있는 권한이 있습니다.

1. 상법상의 결의사항

- (1) 주주총회의 소집
- (2) 영업보고서의 승인
- (3) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인
- (4) 대표이사의 선임 및 해임
- (5) 공동대표의 결정
- (6) 지점의 설치, 이전 또는 폐지
- (7) 신주의 발행
- (8) 사채의 모집
- (9) 준비금의 자본전입
- (10) 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행
- (11) 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인
- (12) 위원회의 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임
- (13) 주식매수선택권의 부여 및 취소
- (14) 감사위원회를 제외한 위원회의 결의에 대한 수정 결의
- (15) 소규모 주식교환
- (16) 소규모합병 및 소규모분할합병
- (17) 회사 자산 및 매출액의 10분의 1 이하 규모의 영업양도의 결정
- (18) 회사의 최대주주(그의 특수관계인 포함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회への 보고
- (19) 지배인의 선임 및 해임

2. 회사 경영에 관한 중요사항

- (1) 주주총회에 부의할 의안
- (2) 사업의 계획과 운영에 관한 사항
- (3) 회사의 예산·결산
- (4) 회사 자기자본 1.5%에 해당하는 금액 또는 1,000억원 중 많은 금액 이상의 신규투자 계획, 차입 (1년 이내의 단기 차입 제외), 채무의 보증, 출자, 자산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항 (단, 자기 자본이라 함은 유가증권시장 공시규정상 자기자본을 의미함)
- (5) <삭제 2012.3.5>
- (6) 해외증권의 발행
- (7) <삭제 1999.4.9>
- (8) 각 위원회 규정 및 대표이사 위임사항의 제정, 개정 및 폐지
- (9) <삭제 2012.3.5>
- (10) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 이사회 승인사항으로 정한 자본금 또는 자본 총계 중 큰 금액의 5% 이상

이거나 50억원 이상에 해당하는 다음의 행위

단, 감사위원회에 3인 이상의 사외이사가 포함되고 사외이사 수가 위원 총수의 3분의 2 이상인 경우 감사위원회에 그 의결을 위임함

가. 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 자금, 유가증권, 자산을 제공 또는 거래

나. 분기 거래 합계액을 기준으로 동일인 및 동일인 친족이 20% 이상을 출자한 회사 또는 그 자회사를 상대방으로 하거나 동 회사를 위하여 상품·용역을 제공 또는 거래

(11) 회사 경영기초이념의 실행을 위한 회사 경영관리 체계의 정립 및 수정

(12) 10억원 이상의 기부. 단, 태풍, 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인한 긴급구호와 "사회복지공동모금회법"에 따른 기부는 선집행후 사후보고 할 수 있음

3. 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

(2) 사외이사 현황

(성명, 학력 및 경력, 최대주주등과의 이해관계, 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 등)

[기준일 : 2017년 9월 30일]

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고
김두경	서울공대 응용수학과 학사 존스홉킨스대 경제학 석사 한국은행 금융시장실장, 발권국장 등 전국은행연합회 상무이사 한국금융연수원 전문자문교수	해당사항 없음	-	2015. 3. 20 재선임
박영준	서울대 전기공학 학/석사 메사추세츠주립대학교 전기공학 박사 미국 IBM 연구원 금성반도체 책임연구원 서울대 전기·정보공학부 교수(現)	해당사항 없음	-	2015. 3. 20 재선임
김대일	서울대 경제학 학사 시카고대경제학 석/박사 라이스대 경제학과 교수 한국개발연구원 연구위원 서울대 경제학부 교수(現)	해당사항 없음	-	2015. 3. 20 재선임
이창양	서울대 정치학 학사 서울대 행정대학원 석사 하버드대 정책학 석/박사 행정고시 29회 산업자원부 산업정책과장 KAIST 경영대학 교수(現)	해당사항 없음	-	2015. 3. 20 재선임
최종원	서울대 경제학 학사 서울대 행정대학원 행정학 석사 미국 미시간대 정책학 박사 KDI 연구위원 공정거래위원회 비상임위원 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원장 서울대 행정대학원 교수(現)	해당사항 없음	-	2017. 3. 24 재선임
신창환	고려대 전기전자전파공학 학사 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사 IBM 마이크로일렉트로닉스 근무 Xilinx 근무 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 (現)	해당사항 없음	-	2017. 3. 24 선임

(3) 이사회 운영규정의 주요내용

구 성	주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성함	
개최시기	정기 이사회	매분기 종료 후 45일 이내에 개최함
	임시 이사회	필요에 따라 수시로 개최함
소집권자	이사회 의장	
소집절차	회의일 2일전까지 각 이사에게 개최 시기, 장소 및 안건을 통지함. 단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통지할 수 있다.	
결의방법	이사 과반수의 출석과 과반수의 찬성으로 함. 그러나, 법령 또는 정관으로 그 비율을 높게 정한 경우에는 법령 또는 정관의 규정을 따름	
부의사항	상법, 정관 및 이사회 규정에서 정하는 회사에 관한 중요사항	
위 임	다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 이사회내 위원회에 위임할 수 있음 1. 주주총회 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회 설치 및 폐지와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 위원회에 위임할 수 없음을 명시한 사항 전항에 의하여 이사회가 이사회내 위원회에 위임할 사항은 해당 위원회 규정에서 정한다.	
의 사 록	이사회 의사에 관하여 의사록을 작성함 (의사록에는 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명함)	

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 참석					
				김두경 (출석률: 100%)	박영준 (출석률: 90%)	김대일 (출석률: 90%)	이창양 (출석률: 100%)	최종원 (출석률: 90%)	신창환 (출석률: 100%)
1	17.01.25	1. 제69기(2016년) 재무제표(안)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	
		2. 제69기(2016년) 영업보고서(안)	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	
2	17.02.22	1. 제69기 정기주주총회 소집(안)	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	
		2. 이사회 규정 등 개정(안)	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	
3	17.03.22	1. SK건설과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		2. SK텔레콤 등과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
		3. SK(주)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	
4	17.04.26	1. 한국고등교육재단 등에 대한 기부금 출연(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. SK이노베이션과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. SK텔레콤과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	17.05.12	1. 의결 안건 없음	-	-	-	-	-	-	-

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 참석					
				김두경 (출석률: 100%)	박영준 (출석률: 90%)	김대일 (출석률: 90%)	이창양 (출석률: 100%)	최종원 (출석률: 90%)	신창환 (출석률: 100%)
6	17.05.19	1. TMC 지분 인수를 위한 Loan 제공 협약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	17.05.24	1. Foundry 사업 영업양도, 부속계약 체결 및 출자(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8	17.07.26	1. 수정경영계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성
		2. 우시생산업의 유상증자(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성
		3. SK텔레콤과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성
		4. SK China와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성
9	17.09.27	1. SK 건설과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. TMC 지분 인수를 위한 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
10	17.10.25	1. SKHYOL과의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. 국토교통부 공공실버주택사업 기부금 출연(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 신창환 사외이사의 경우, 제69기 정기 주주총회(17.03.24)에서 신규 선임됨.

다. 이사회내 위원회

(1) 이사회내의 위원회 구성현황

[2017년 9월 30일 현재]

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고
감사위원회	사외이사 5명	김두경(위원장) 김대일 이창양 최종원 신창환	"2. 가. 감사위원회"에 관한 사항 참조	-
사외이사후보추천위원회	사외이사 2명 사내이사 1명	박영준(위원장) 최종원 박성욱	"라. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 참조	-

(2) 이사회내의 위원회 활동내역

(가) 감사위원회

"2. 가. 감사위원회 설치여부, 구성방법 등"에 관한 사항 참조

(나) 사외이사후보추천위원회

"라. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 참조

라. 이사의 독립성

본 보고서 작성일 현재 당사의 이사는 총 10인으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 6명입니다. 사외이사 선임에 있어 상법 및 관계법상의 자격 기준과 이사직무수행 적합성을 위한 전문성 및 독립성 등에 기반하여 투명하고 공정한 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사와 추천을 통해 주주총회에서 선임하고 있습니다.

(1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 경영참고사항 비차· 공시 시(2017. 02. 22) 이사 후보에 대한 인적사항 공시
[2017년 9월 30일 현재]

성 명 (생년월일)	주요 약력	추천인	회사와의 거래내역	비 고
박 성 욱 (1958.01.08)	하이닉스반도체 HSA담당 이사 상무 하이닉스반도체 메모리 연구소장 전무 SK하이닉스 부사장 SK하이닉스 사장 SK하이닉스 대표이사 부회장 (現)	이사회	없음	이사회 의장/ 사외이사후보추천위 원회 위원
김 준 호 (1957.08.28)	법무부 부장검사 SK(주) 윤리경영실장 부사장 SK에너지(주) CMS사장 겸 SK(주) 윤리경영부문장 SK텔레콤(주) GMS 사장 SK하이닉스 시스템아이씨 대표이사 사장 (現)	이사회	없음	
이 석 희 (1965.06.23)	Intel 근무 KAIST 교수 SK하이닉스 미래기술연구원장 SK하이닉스 DRAM개발부문장/부사장 SK하이닉스 사업총괄/경영지원총괄 사장 (現)	이사회	없음	
박 정 호 (1963.05.17)	SK텔레콤(주) 사업개발부문장 SK C&C(주) 대표이사 사장 SK(주) 대표이사 사장 SK텔레콤(주) 대표이사 사장 (現)	이사회	없음	
김 두 경 (1949.10.10)	서울공대 응용수학과 학사 존스홉킨스대 경제학 석사 한국은행 금융시장실장, 발권국장 등 전국은행연합회 상무이사 한국금융연수원 전문자문교수	사외이사 후보추천 위원회	없음	감사위원회 위원
박 영 준 (1952.11.17)	서울대 전기공학 학/석사 메사추세츠주립대학교 전기공학 박사 미국 IBM 연구원 금성반도체 책임연구원 서울대 전기정보공학부 교수 (現)	사외이사 후보추천 위원회	없음	사외이사후보추천위 원회 위원
김 대 일 (1962.08.18)	서울대 경제학 학사 시카고대경제학 석/박사 라이스대 경제학과 교수 한국개발연구원 연구위원 서울대 경제학부 교수 (現)	사외이사 후보추천 위원회	없음	감사위원회 위원
이 창 양 (1962.09.20)	서울대 정치학 학사 서울대 행정대학원 석사 하버드대정책학 석/박사 행정고시 29회 산자부 산업정책과장 KAIST 경영대학 교수 (現)	사외이사 후보추천 위원회	없음	감사위원회 위원

성 명 (생년월일)	주요 약력	추천인	회사와의 거래내역	비 고
최 종 원 (1958.10.28)	서울대 경제학 학사 서울대 행정대학원 행정학 석사 미국 미시간대 정책학 박사 KDI 연구위원 공정거래위원회 비상임위원 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원장 서울대 행정대학원 교수(現)	사외이사 후보추천 위원회	없음	감사위원회 위원/ 사외이사후보추천위 원회 위원
신 창 환 (1979.11.23)	고려대 전기전자전파공학 학사 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사 IBM 마이크로일렉트로닉스 근무 Xilinx 근무 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 (現)	사외이사 후보추천 위원회	없음	감사위원회 위원

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

(가) 사외이사후보추천위원회 설치목적 및 권한사항

[설치목적]

관계법령, 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하고 심사함.

[권한]

① 사외이사 후보의 추천, 심사, 선정

(나) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

[2017년 9월 30일 현재]

성 명	사외이사 여부	비 고
박영준	○	- 사외이사 과반수 충족 (상법 제542조의8항 충족)
최종원	○	
박성욱	X	

(다) 사외이사후보추천위원회 활동내역

개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사의 성명	
			박영준(출석률: 100%)	최종원 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부	
17.02.22	1. 제69기 정기주주총회에 대한 사외이사 후보추천(안)	가결	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직의 현황

지원조직	구성	주요담당업무
이사회사무국	직원 3명 (팀장 1명 포함)	- 이사회 및 소위원회 지원 - 이사직무활동 지원

(2) 사외이사 교육실적

교육일시	교육내용	교육주체
2017.05.22 11:00	이사회 Workshop - NAND 사업전망 및 경쟁력 강화 방안 - IT전략 및 운영 현황	이사회사무국
2017.11.10 14:30	이사회 Workshop - 공유인프라기반 Deep Change - To-Be Model Update	이사회사무국

2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하여 운영하고 있으며, 주주총회의 결의에 의하여 선임된 감사위원이 되는 사외이사 5인(김두경, 김대일, 이창양, 최종원, 신창환)으로 구성되어 있습니다.

가. 감사위원회 설치여부, 구성방법 등

- 설치 여부 : 감사에 갈음하는 이사회내 위원회로서 감사위원회를 설치(정관 제48조)
- 권한과 책임 : 회계 및 업무에 대한 감사, 외부감사인 선임 등
- 구성 방법 : 3인 이상의 이사로 구성(단 위원 총수의 2/3 이상을 사외이사로 구성)
위원장은 호선에 의하여 선임
- 회의 : 정기 위원회(매 분기 종료 후 45일 이내) 및 임시 위원회(필요에 따라 수시로)

나. 감사위원회의 인적사항

[2017년 9월 30일 현재]

성명	주요경력	결격요건 여부	비고
김 두 경	서울공대 응용수학과 학사 존스홉킨스대 경제학 석사 한국은행 금융시장실장, 발권국장 등 전국은행연합회 상무이사 한국금융연수원 전문자문교수	해당사항 없음	위원장
김 대 일	서울대 경제학 학사 시카고대 경제학 석/박사 라이스대 경제학과 교수 한국개발연구원 연구위원 서울대 경제학부 교수(現)	해당사항 없음	-
이 창 양	서울대 정치학 학사 서울대 행정대학원 석사 하버드대 정책학 석/박사 행정고시 29회 산자부 산업정책과장 KAIST 경영대학 교수(現)	해당사항 없음	-
최 종 원	서울대 경제학 학사 서울대 행정대학원 행정학 석사 미국 미시간대 정책학 박사 KDI 연구위원 공정거래위원회 비상임위원 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원장 서울대 행정대학원 교수(現)	해당사항 없음	
신 창 환	고려대 전기전자전파공학 학사 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사 IBM 마이크로일렉트로닉스 근무 Xilinx 근무 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 (現)	해당사항 없음	

다. 감사위원회의 위원의 독립성

본 보고서 제출일 현재 당사는 감사위원회 5인 전원을 사외이사로 구성하고 있으며, 5인 중 최소 1인 이상의 회계 또는 재무전문가를 선임하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치를 아래와 같이 마련하고 있습니다.

- 감사위원회 규정 제3조

- ③ 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.
- ④ 위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내

용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제12조(부의사항)

3. 감사에 관한 사항

- (1) 업무· 재산 조사
- (2) 자회사의 조사
- (3) 이사의 보고 수령
- (7) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령
- (8) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령

- 감사위원회 규정 제13조 (관계인의 출석)

- ① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 경영진, 재무담당임원, 내부감사부서의 장 및 외부감사인 등을 회의에 참석하도록 요구할 수 있다.
- ② 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제14조의7 (의견교환)

위원회는 감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하며 감사인과 회사의 내부통제제도 및 회사 재무제표의 정확성 등에 관하여 의견을 교환할 수 있다.

- 감사위원회 규정 제16조 (내부감사부서의 설치)

- ① 위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 위원회를 보조하는 전담 지원부서를 설치· 운영 하거나 회사의 내부감사부서를 활용할 수 있다.
- ② 전담 지원부서 또는 내부감사부서의 장은 위원회의 명을 받아 회사 또는 자회사의 업무 또는 재산상태 등을 조사할 수 있다.

라. 감사위원회의 주요활동내역

회사	일자	의 안	기결여부	사외이사의 성명				
				김두경 (출석률 :100%)	김대일 (출석률 :75%)	이창양 (출석률 :100%)	최종원 (출석률 : 87%)	신창환 (출석률 : 100%)
				찬반여부				
1	17.01.23	1. 2016년 내부회계관리제도 운영실태	보고	-	불참	-	-	
		2. 2016년 내부감사실적 및 2017년 업무 계획	보고	-	불참	-	-	
		3. SK-HYCL과의 거래(안)	가결	찬성	불참	찬성	찬성	
		4. 내부감사부서 책임자 임명에 대한 동의의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	
		5. 외부감사인 선임 승인(안)	가결	찬성	불참	찬성	찬성	
2	17.02.20	1. 2016년 회계연도 회계감사 결과	보고	-	-	-	-	
		2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
		1. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래한도(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	

회차	일자	의안	가결여부	사외이사의 성명				
				김두경 (출석률 :100%)	김대일 (출석률 :75%)	이창양 (출석률 :100%)	최종원 (출석률 : 87%)	신창환 (출석률 : 100%)
				찬반여부				
3	17.03.15	2. 제69기 정기주주총회에 제출할 의안 및 서류의 적법성 조사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
		3. 감사보고서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
		4. 내부감시장치에 대한 의견서(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	
4	17.04.24	1. 내부감사 실적 및 향후 계획	보고	-	-	-	-	-
5	17.06.26	1. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래 한도(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. SK(주)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		3. Essencore Ltd.와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	17.07.24	1. 2017년 상반기 재무결산 실적	보고	-	불참	-	불참	-
		2. 2017년 상반기 내부감사 실적 및 하반기 업무 계획	보고	-	불참	-	불참	-
		3. 외부회계감사 업무 수행 계획	보고	-	불참	-	불참	-
7	17.09.25	1. 계열회사(SK증권) 대상 내부거래 한도(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2. SK(주)와의 거래(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8	17.10.23	1. 내부감사 실적 및 향후 계획	보고	-	-	-	-	-

※ 신창환 사외이사의 경우, 제69기 정기 주주총회(17.03.24)에서 신규 선임됨.

마. 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

구분	상세
성명	신승국 (전무)
생년월일	1962년11월3일
학력사항	-. 연세대학교 대학원 상법학 석사 (1985년~1987년) -. 미국 밴더빌트대 법과대학원 법학박사 (J.D.)
주요경력	-. 2017년 1월~ : SK하이닉스 지속경영본부장(現) -. 2014년 1월~ : SK하이닉스 대외협력본부장 -. 2006년 2월 ~ : SK에너지 법무실장 / CR전략실장 -. 2000년 8월 ~ : SK텔레콤 법무팀장 / 법무실장 -. 1988년 7월 ~ : SK(舊유공) 법제부 입사
주요자격	-. 미국 뉴욕주 변호사

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관에 의해 주주의 의결권을 1주마다 1개로 정하고 있으며, 집중투표제나 서면

투표제, 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다. 또한 본 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 등에 관한 사항

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
에스케이텔레콤(주)	최대주주	보통주	146,100,000	20.07	146,100,000	20.07	유상증자 참여/구주지분 인수
최신원	특별관계자	보통주	11,000	0.00	0	0.00	17.07.05 11,000주 장내 매도
박성욱	특별관계자	보통주	1,502	0.00	1,502	0.00	-
김준호	특별관계자	보통주	8,940	0.00	0	0.00	17.08.30 8,940주 장내 매도
박정호	특별관계자	보통주	1,090	0.00	1,090	0.00	-
이석희	특별관계자	보통주	42	0.00	42	0.00	-
계		보통주	146,122,574	20.07	146,102,634	20.07	-
		우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주 상세

(1) 최대주주 및 지분율

당사 최대주주는 SK텔레콤주식회사 (영문명 : SK Telecom Co., Ltd.)이며, 그 소유주식수는 146,100,000주(20.07%)입니다.

(2) 최대주주(법인)의 기본정보

가) 대표자

[기준일 : 2017년 9월 30일]

성명	직위	상근여부	출생년도
박정호	대표이사/사장	상근	1963년

나) 기본정보

[기준일 : 2017년 9월 30일]

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
SK텔레콤 주식회사	54,101	박정호	0.00	-	-	SK(주)	25.22
		-	-	-	-	-	-

(3) 최대주주(법인)의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2017.03.24	박정호	-	-	-	-	-
2017.03.28	박정호	0.00	-	-	-	-
2017.03.30	박정호	0.00	-	-	-	-

※ 박정호 대표이사는 '17년 3월 24일 주주총회 및 이사회를 통해 대표이사로 선임되었으며, '17년 3월 28일과 30일 각각 500주의 주식을 취득함

(4) 최대주주(법인)의 최근 결산기 재무현황

[기준일 : 2017년 9월 30일]

(단위 : 백만원)

구 분	
자산총계	31,923,826
부채총계	14,447,741
자본총계	17,476,085
매출액	13,022,697
영업이익	1,226,178
당기순이익	1,996,959

(5) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 에스케이텔레콤 주식회사는 1984년 3월 19일에 한국이동통신서비스 주식회사로 설립되었으며, 1989년 10월 유가증권시장에 최초 상장되었습니다. 이후 1997년 1월 선경그룹 계열사로 편입되었으며, 이후 3월에 SK텔레콤(주)로 사명이 변경되었습니다.

보고서 작성 기준일 현재, 영위하고 있는 주요 사업은 (가)이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업, (나)전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업과 (다)커머스사업, 플랫폼 서비스, 인터넷포털 서비스 등의 기타사업입니다.

(6) 최대주주(법인)의 최대주주(법인) 기본 정보

가) 대표자

[기준일 : 2017년 9월 30일]

성명	직위	상근여부	출생년도
최태원	대표이사/회장	상근	1960년
장동현	대표이사/사장	상근	1963년

나) 기본 정보

[기준일 : 2017년 9월 30일]

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
SK(주)	26,530	최태원	23.40	-	-	최태원	23.40
		장동현	-	-	-	-	-

* 대표이사과 최대주주의 '최태원'은 동일인이며, 지분율은 보통주 기준으로 기재하였음

(7) 최대주주(법인)의 최대주주(법인) 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2017.03.24	장동현	-	-	-	-	-

* 박정호 전 대표이사는 '17년 3월 23일 부로 대표이사 및 사내이사직 사임

* 조대식 전 대표이사는 '17년 3월 24일 부로 대표이사직 사임 (사내이사직 유지)

(8) 최대주주(법인)의 최대주주(법인) 최근 결산기 재무현황

[기준일 : 2017년 9월 30일]

(단위 : 백만원)

구 분	
자산총계	107,421,757
부채총계	61,961,540
자본총계	45,460,217
매출액	68,793,747
영업이익	4,428,007
당기순이익	4,158,340

다. 최대주주 변동내역

최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 09월 30일)

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고
-	(주)한국외환은행	37,742,000	8.2	-
2009년 01월 17일	(주)한국외환은행	37,742,000	7.3	일반 공모증자에 의한 당사 발행주식 증가로 보유주식수에는 변동이 없으나 보유 지분율은 변동함.
2009년 05월 19일	(주)한국외환은행	37,742,000	6.4	일반 공모증자에 의한 당사 발행주식 증가로 보유주식수에는 변동이 없으나 보유 지분율은 변동함.
2010년 03월 16일	한국정책금융공사	32,412,935	5.5	변경 전 최대주주의 지분매각
2010년 03월 19일	미래에셋자산운용투자자문(주)	35,362,056	6.0	장내 매수/매도
2010년 05월 04일	미래에셋자산운용투자자문(주)	44,041,030	7.46	장내 매수/매도
2010년 08월 03일	한국정책금융공사	32,412,935	5.50	변경 전 최대주주의 지분매각
2010년 10월 11일	국민연금공단	35,894,454	6.08	장내 매수/매도
2011년 01월 10일	국민연금공단	47,786,668	8.10	장내 매수/매도
2011년 04월 11일	국민연금공단	53,774,325	9.11	장내 매수/매도
2011년 07월 08일	국민연금공단	47,838,426	8.08	장내 매수/매도
2011년 10월 07일	국민연금공단	54,202,391	9.15	장내 매수/매도
2012년 02월 15일	에스케이텔레콤(주)	146,100,000	21.05	유상증자 참여 및 구주 지분 인수
2012년 02월 23일	에스케이텔레콤(주)	146,105,000	21.05	특별관계자 추가
2012년 04월 02일	에스케이텔레콤(주)	146,119,894	21.05	계열편입에 따른 특별관계자 추가
2012년 06월 22일	에스케이텔레콤(주)	146,127,934	21.05	특별관계자 추가
2013년 05월 09일	에스케이텔레콤(주)	146,115,374	20.57	특별관계자 제외 및 추가
2014년 01월 06일	에스케이텔레콤(주)	146,119,374	20.57	장내 매수
2014년 03월 27일	에스케이텔레콤(주)	146,124,334	20.57	특별관계자 제외 및 추가
2015년 02월 24일	에스케이텔레콤(주)	146,126,442	20.07	장내 매수
2016년 03월 28일	에스케이텔레콤(주)	146,127,532	20.07	특별관계자 추가
2017년 03월 24일	에스케이텔레콤(주)	146,122,574	20.07	특별관계자 제외 및 추가
2017년 07월 05일	에스케이텔레콤(주)	146,111,574	20.07	특별관계자 제외
2017년 08월 30일	에스케이텔레콤(주)	146,102,634	20.07	특별관계자 제외

※ 위 지분율은 당사가 공시한 최대주주등소유주식변동신고서상 지분율을 적용하였기에, 최대주주가 별도 공시한 의결권 귀속 지분과는 상이함.

2. 주식의 분포

가. 5% 이상 주주의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일)

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	에스케이텔레콤(주)	146,102,634	20.07	(주1)
	국민연금공단	75,496,297	10.37	-
우리사주조합		-	-	-

(주1) 상기 에스케이텔레콤(주)의 보유내역은 주식관리협회의 구주지분 44,250,000주 인수 및 제3자 배정 유상증자 참여 주식 101,850,000주와 특별관계자의 보유주식 2,634주를 합산한 것임. (최대주주인 에스케이텔레콤(주)이 별도 공시한 의결권 귀속 지분과는 상이함.)

나. 소액주주 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일)

(단위 : 주)

구분	주주		보유주식		비고
	주주수	비율	주식수	비율	
소액주주	169,514	99.95	460,483,393	63.25	발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주

3. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	<p>제10조 (주식의 발행 및 배정) <개정 2017.3.24></p> <p>① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식. 본 제 2호에 의한 신주 발행은 아래 각 목의 경우를 포함하되 이에 한정되지 아니함. <ul style="list-style-type: none"> 가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 나. 자금조달, 기술도입 기타 경영상 필요로 국내외 금융기관(여기서 '금융기관' 이라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항의 전문투자자를 의미하되, 동항 제4호의 주권상장법인, 동법 시행령 제10조 제3항 제
------------------	---

	<p>16호 및 제17호의 법인, 단체 또는 개인은 포함하지 아니한다), 제휴법인, 전략적 투자자 또는 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>다. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우</p> <p>라. 회사가 “ 경영상 필요로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 제1항 제2호 가목 내지 다목의 자 ” 에게 신주를 발행하는 경우</p> <p>마. 은행 등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우</p> <p>3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식</p> <p>② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.</p> <p>1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식</p> <p>2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식</p> <p>3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식</p> <p>4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식</p> <p>③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.</p> <p>④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.</p> <p>⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.</p> <p>⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.</p> <p>⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권 증서를 발행하여야 한다.</p>		
결 산 일	12월 31 일	정기주주총회	3월중
주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 1월 31일 까지		
주권의 종류	일,오,일십,오십,일백,오백,일천,일만주권 (8종)		
명의개서대리인	하나은행 증권대행부 (서울특별시 영등포구 여의도동 43-2)		
주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	홈페이지게재<개정 2012.03.23>

4. 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장

(단위 : 원, 천주)

종 류		'17년 9월	'17년 8월	'17년 7월	'17년 6월	'17년 5월	'17년 4월
보통주	최고주가	86,300	68,600	73,000	69,200	57,900	54,000
	최저주가	68,100	61,400	64,600	56,100	54,200	48,850
	평균주가	77,300	66,386	68,876	61,867	55,953	50,873
거래량	최고일거래량	11,035	6,665	9,660	6,519	4,767	5,609
	최저일거래량	2,304	1,843	1,599	2,007	1,542	1,587
	월간거래량	4,498	3,624	4,031	4,018	2,940	2,868

※ 주가는 일별 종가 기준임.

나. 해외증권시장

[증권거래소명 : 룩셈부르크]

(단위 : USD, DR)

종 류			'17년 9월	'17년 8월	'17년 7월	'17년 6월	'17년 5월	'17년 4월
주가 (종가 기준)	최고	USD	76.26	61.03	65.46	60.77	51.61	47.40
		원화환산	87432.09	68780.81	73347.93	69581.65	57725.79	54059.70
	최저	USD	60.25	53.73	57.12	50.14	47.50	42.57
		원화환산	69076.63	60553.71	64002.96	57410.30	53128.75	48551.09
거래량	최고(일)		40	0	0	0	545	500
	최저(일)		40	0	0	0	0	0
	월간평균		1.9	0	0	0	36	26
환율			1,146.50	1,127.00	1,120.50	1,145.00	1,118.50	1,140.50

※ 환율의 경우 매월 말 고시기준율을 기준으로 하였음.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식		
박성욱	남	1958년 01월	부회장	등기임원	상근	대표이사 사외이사후보 추천위원회 위원	한국과학기술원(KAIST) 재료공학 박사 하이닉스반도체 메모리 연구소장 전무 SK하이닉스 부사장 SK하이닉스 사장 SK하이닉스 대표이사 부회장(現)	1,502	-	선임(09.03.26) 중임(12.02.14, 15.03.20)	-
김준호	남	1957년 08월	사장	등기임원	상근	사내이사	고려대 법학 학사 법무부 부장검사 SK 윤리경영실장 부사장 SK에너지(주) CMS 사장 겸 SK(주) 윤리경영부문장 SK텔레콤 GMS 사장 SK하이닉스 시스템아이씨 대표이사 사장 (現)	-	-	선임(13.03.22) 중임(16.03.18)	-
이석희	남	1965년 06월	사장	등기임원	상근	사내이사 사업총괄 경영지원총괄	스탠포드대 재료공학 박사 Intel 근무 KAIST 교수 SK하이닉스 미래기술연구원장 SK하이닉스 DRAM개발부문장 SK하이닉스 사업총괄/경영지원총괄 사장 (現)	42	-	선임(17.03.24)	-
박정호	남	1963년 05월	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	조지워싱턴대 경영학 석사 SK텔레콤(주) 사업개발부문장 SKC&C(주) 대표이사 사장 SK(주) 대표이사 사장 SK텔레콤(주) 대표이사 사장(現)	1,090	-	선임(17.03.24)	-

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식		
김두경	남	1949년 10월	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원회 위원	서울공대 응용수학과 학사 존스홉킨스대 경제학 석사 한국은행 금융시장실장, 발권국장 등 전국은행연합회 상무이사 한국금융연수원 전문자문교수	-	-	선임(12.02.14) 중임(15.03.20)	-
박영준	남	1952년 11월	이사	등기임원	비상근	사외이사 사외이사후보 추천위원회 위원	서울대 전기공학 학/석사 메사추세츠주립대학교 전기공학 박사 미국 IBM 연구원 금성반도체 책임연구원 서울대 전기정보공학부 교수(現)	-	-	선임(12.02.14) 중임(15.03.20)	-
김대일	남	1962년 08월	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원회 위원	서울대 경제학 학사 시카고대경제학 석/박사 라이스대 경제학과 교수 한국개발연구원 연구위원 서울대 경제학부 교수(現)	-	-	선임(12.02.14) 중임(15.03.20)	-
이창양	남	1962년 09월	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원회 위원	서울대 정치학 학사 서울대 행정대학원 석사 하버드대정책학 석/박사 행정고시 29회 산업자원부 산업정책과장 KAIST 경영대학 교수(現)	-	-	선임(12.02.14) 중임(15.03.20)	-
최종원	남	1958년 10월	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원회 위원 사외이사후보 추천위원회 위원	서울대 경제학 학사 서울대 행정대학원 행정학 석사 미국 미시간대 정책학 박사 KDI 연구위원 공정거래위원회 비상임위원 기획재정부 공공기관 경영평가단 단장 서울대 행정대학원장 서울대 행정대학원 교수(現)	-	-	선임(14.03.21) 중임(17.03.24)	-
신창환	남	1979년 11월	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원회 위원	고려대 전기전자전파공학 학사 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스 박사 IBM 마이크로일렉트로닉스 근무 Xilinx 근무 서울시립대 공과대 전자전기컴퓨터공학부 교수 (現)	-	-	선임(17.03.24)	-

※ 임기 만료일은 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회 종료시임.

(2) 등기임원의 겸직 현황

[기준일: 2017년 9월 30일]

겸직임원		겸직회사		비 고
성 명	직 위	회 사 명	직 위	
박 성 욱	대표이사	SK hynix Semiconductor China Ltd.	대표이사	-
		SK hynix memory solutions Inc.	이 사	-
김 준 호	사내이사	SK hynix Semiconductor China Ltd.	이 사	-
		에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)	대표이사	-
박 정 호	기타비상무이사	SK 텔레콤	대표이사	-
최 종 원	사외이사	두산건설(주)	사외이사	-

(3) 미등기 임원 현황

[기준일: 2017년 9월 30일]

직위 (상근여부)	등기임원 여부	성명	성별	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수		비고
							보통주	우선주	
회장 (상근)	미등기임원	최태원	남	1960.12	Univ. of Chicago 대표이사 회장	회장	-	-	-
사장 (상근)	미등기임원	정태성	남	1960.11	Univ. of Wisconsin - Madison 삼성전자	NAND개발사업부부장	-	-	-
부사장 (상근)	미등기임원	송현종	남	1965.11	Massachusetts Institute of Technology 미래전략본부	마케팅부부장	3,000	-	-
부사장 (상근)	미등기임원	이상선	남	1961.09	고려대 청주FAB센터	제조/기술부부장	4,000	-	-
부사장 (상근)	미등기임원	진교원	남	1962.09	서울대 NAND개발사업부	품질보증본부장	112	-	-
부사장 (상근)	미등기임원	현준엽	남	1963.1	서울대 기업문화본부	기업문화센터장	3,520	-	-
부사장 (상근)	미등기임원	홍성주	남	1962.11	한국과학기술원 DRAM개발사업부	미래기술연구부장	6,842	-	-
전무 (상근)	미등기임원	길병승	남	1963.06	경찰대 SK건설	H-TF장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	김정환	남	1962.09	한양대 SK텔레콤	역량개발실 담당임원	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	김진국	남	1964.07	연세대 DRAM기술본부	DRAM개발사업부부장	2,000	-	-
전무 (상근)	미등기임원	김진웅	남	1964.02	한국과학기술원 NAND개발본부	사업총괄 담당임원	1,343	-	-
전무 (상근)	미등기임원	박정식	남	1963.12	홍익대 P&T센터	P&T본부장	112	-	-
전무 (상근)	미등기임원	신승국	남	1962.11	Vanderbilt University 대외협력본부	지속경영본부장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	오기영	남	1960.05	SOPHIA UNIVERSITY 생산기술센터	기술혁신그룹장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	오종훈	남	1964.08	서울대 DRAM제품본부	DRAM설계본부장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	이명영	남	1962.02	연세대 재무본부	재무기획본부장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	이상래	남	1965.07	Boston University SC사업기획본부파견	미래전략본부장	2	-	-
전무 (상근)	미등기임원	이재성	남	1966.09	연세대 NAND Solution개발본부	FW그룹장	-	-	-
전무	미등기임원	이재형	남	1965.09	서강대	NAND개발전략실장	-	-	-

직위 (상근여부)	등기임원 여부	성명	성별	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수		비고
							보통주	우선주	
(상근)					Intel				
전무 (상근)	미등기임원	임동규	남	1964.04	서울대 미래기술연구원	공정센터장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	임종필	남	1960.11	고려대 SCM본부	기업문화센터부 담당임원	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	조광보	남	1966.12	Univ. of Southern California CIS사업부	CIS사업부장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	최근민	남	1960.09	Tohoku University 이천FAB센터	Tech혁신센터장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	최정달	남	1964.07	경북대 미래기술연구원	NAND소자기술품장	-	-	-
전무 (상근)	미등기임원	한우중	남	1959.01	고려대 DRAM제품본부	메모리시스템연구소장	400	-	-
상무 (상근)	미등기임원	강선국	남	1969.02	인하대 미주총괄	DRAM상품기획실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	강유중	남	1970.12	Vanderbilt University 미래전략본부	경영전략실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	곽노정	남	1965.11	고려대 제조/기술부문	Diffusion기술그룹장	1,103	-	-
상무 (상근)	미등기임원	권원택	남	1962.1	광운대 제조/기술부문	이천FAB센터장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	권재순	남	1969.12	충북대 제조/기술부문	DMI그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김광욱	남	1962.08	경북대 우시FAB센터	구매본부장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김남석	남	1967.02	서울대 P&T센터	PKG기술개발그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김대영	남	1962.09	부산대 기술역량센터	역량개발실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김도근	남	1964.03	한국과학기술원 (주)삼진	NAND개발전략실 담당임원	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김상근	남	1962.01	동아대 제조/기술부문	설비Infra본부장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김상덕	남	1968.02	서울대 공정센터	DRAM공정개발그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김석	남	1970.11	연세대 마케팅부문	DRAM마케팅그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김성한	남	1968.12	서울대 SCM본부	건설기획실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김영래	남	1966.01	연세대 마케팅부문	NAND마케팅그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김영식	남	1967.12	연세대 공정센터	Photo기술그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김영일	남	1965.1	Univ. of Denver DRAM개발사업부문	윤리경영실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김영호	남	1961.05	고려대 SCM본부	구매본부 담당임원	328	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김용주	남	1968.1	한양대 DRAM개발사업부문	APD그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김정기	남	1964.01	서강대 대외협력본부	Communication실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김종호	남	1967.01	고려대 마케팅부문	마케팅본부장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김종환	남	1972.09	서울대 미래기술연구원	DRAM Core TF장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김주선	남	1966.06	성균관대 마케팅부문	영업본부장	-	-	-
상무					고려대				

직위 (상근여부)	등기임원 여부	성명	성별	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수		비고
							보통주	우선주	
(상근)	미등기임원	김태찬	남	1963.06	CIS사업부	CIS Solution그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김태훈	남	1963.02	경북대 제조/기술부문	기술안전그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김현곤	남	1962.07	한국과학기술원 DRAM제품본부	제품기술그룹장	9	-	-
상무 (상근)	미등기임원	김형수	남	1965.02	한국과학기술원 미래기술연구원	Tech. Talent실장	500	-	-
상무 (상근)	미등기임원	마금선	남	1968.11	Indiana State University 대외협력본부	법무실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	문유진	남	1967.05	한양대 기업문화본부	노사협력실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	민경현	남	1966.01	New York University 대외협력본부	특허실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박근우	남	1966.04	한국과학기술원 NAND개발본부	NAND설계그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박성계	남	1967.06	한국과학기술원 미래기술연구원	NAND Core TF장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박일	남	1971.01	Purdue University SOLAB	메모리시스템연구소 담당임원	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박찬진	남	1970.05	서울대 네우스텍	Data Science실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	박철규	남	1966.06	경북대 품질보증본부	DRAM품질보증그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	백현철	남	1965.03	고려대 이천FAB센터	DRAM PTE그룹 담당임원	630	-	-
상무 (상근)	미등기임원	사택진	남	1961.11	고려대 재무본부	세무관리실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	송창록	남	1969.01	서울대 미래기술연구원	정보화본부장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	신현상	남	1967.08	한국과학기술원 공정센터	공정기술그룹 담당임원	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	심대용	남	1969.06	서울대 DRAM제품본부	DVAGroup장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	안규옥	남	1962.09	중앙대 재무본부	수익성분석실장	9	-	-
상무 (상근)	미등기임원	안근옥	남	1959.08	단국대 NAND개발본부	Hercules 수율TF장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	안명규	남	1968.1	한국과학기술원 NAND개발사업부문	Hercules 수율TF 담당임원	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	안현	남	1967.06	서울대 NAND개발사업부문	혁신전략실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	양중섭	남	1964.12	한국과학기술원 NAND개발사업부문	Solution제품그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	양현조	남	1963.11	연세대 공정센터	MASK기반기술그룹장	508	-	-
상무 (상근)	미등기임원	오종진	남	1965.02	경희대 SCM본부	구매2실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	원국	남	1966.12	Univ. of Helsinki 마케팅부문	마케팅전략그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	위보령	남	1964.06	한국과학기술원 마케팅부문	DRAM개발기획그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	유진산	남	1963.06	고려대 이천FAB센터	ThinFilm기술그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	윤건상	남	1962.1	성균관대 DRAM제품본부	고객솔루션그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	윤석훈	남	1966.11	충남대 제조/기술부문	M14 Phase2 PJT장	-	-	-
상무					아주대				

직위 (상근여부)	등기임원 여부	성명	성별	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수		비고
							보통주	우선주	
(상근)	미등기임원	이기정	남	1965.1	미래기술연구원	AT그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이기화	남	1968.12	충북대 P&T센터	N-TEST기술그룹장	119	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이두희	남	1967.07	연세대 기업문화본부	총무실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이병기	남	1972.02	한국과학기술원 공정센터	공정기술그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이상철	남	1965.02	아주대 SCM본부	경영정보실장	50	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이석규	남	1963.12	서울대 미래기술연구원	DMR그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이성동	남	1965.03	서강대 P&T센터	이천P&T 그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이승범	남	1964.07	동국대 삼성SDI	CIS마케팅/영업그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이정훈	남	1964.06	연세대 미래기술연구원	DRAM소자기술그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이창수	남	1967.02	Tohoku University DRAM개발사업부문	제품기술그룹 담당임원	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이철호	남	1960.09	광운대 기업문화본부	현장경영실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이한주	남	1965.11	성균관대 생산기술센터	생산정보실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	이희기	남	1964.07	인하대 품질보증본부	Solution품질보증그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	임성빈	남	1963.06	울산대 생산기술센터	M&T기술혁신그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	장승호	남	1970.11	서강대 NAND개발사업부문	NAND개발전략실 담당임원	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	장재영	남	1968.1	Univ. of Colorado - Boulder NAND Solution개발본부	SoC그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	장종태	남	1964.1	고려대 기업문화본부	청주지원본부장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	장혁준	남	1967.06	Indiana University - Bloomington 재무본부	재무기획실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	장희현	남	1963.01	연세대 NAND개발본부	NAND소자기술그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	전영호	남	1961.04	광운대 청주FAB센터	NAND Core TF 담당임원	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	전용주	남	1962.1	전북대 NAND개발사업부문	Solution제품그룹 담당임원	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	전윤석	남	1964.12	University of Utah 미래기술연구원	Obelisk TF장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	전준현	남	1966.05	경북대 DRAM제품본부	VPD그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	정우진	남	1966.11	연세대 윤리경영실	HR실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	정의상	남	1965.03	고려대 제조/기술부문	ME그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	정재관	남	1960.09	영남대 이천FAB센터	DRAM PTE그룹장	2,144	-	-
상무 (상근)	미등기임원	정종호	남	1964.03	광운대 DRAM기술본부	Alius 공정PJT장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	정진욱	남	1970.04	경북대 DRAM개발사업부문	Etch 기술그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	정철우	남	1965.04	성균관대 DRAM개발사업부문	DRAM PM그룹장	-	-	-
상무					연세대				

직위 (상근여부)	등기임원 여부	성명	성별	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수		비고
							보통주	우선주	
(상근)	미등기임원	정태우	남	1965.05	DRAM기술본부	NAND공정개발그룹 담당임원	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	조돈구	남	1963.1	건국대 P&T센터	D-TEST기술그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	조주환	남	1968.01	광운대 DRAM제품본부	TCD그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	차선용	남	1967.08	한국과학기술원 DRAM기술본부	Alius TF장	400	-	-
상무 (상근)	미등기임원	차성근	남	1964.01	연세대 재무본부	IR실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최봉호	남	1962.09	연세대 이천FAB센터	DRAM Core TF 담당임원	9	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최석문	남	1966.04	Univ. of Michigan Ann Arbor 기업문화본부	G-SCM TF장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최수환	남	1968.05	한국과학기술원 마케팅부문	NAND상품기획실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최정산	남	1967.01	연세대 품질보증본부	고객품질그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최준기	남	1968.02	송실대 제조/기술부문	C&C기술그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	최준배	남	1969.01	Fairleigh Dickinson University 미래전략본부	경영기획실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	피승호	남	1966.04	한국과학기술원 미래기술연구원	NAND공정개발그룹장	569	-	-
상무 (상근)	미등기임원	한영수	남	1969.11	아주대 NAND개발사업부문	Solution제품그룹 담당임원	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	허용진	남	1961.02	건국대 청주FAB센터	청주FAB센터장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	홍권	남	1965.11	고려대 기술역량센터	구매1실장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	홍상후	남	1963.02	성균관대 NAND개발본부	NAND제품그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	홍성권	남	1967.07	한국과학기술원 CIS사업부	CIS기술개발그룹장	-	-	-
상무 (상근)	미등기임원	황성용	남	1969.12	고려대 SK네트웍스	지속경영본부 담당임원	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	김성동	남	1967.03	서울대 미래기술연구원	DMR그룹 담당임원	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	김중호	남	1969.02	Georgia Institute of Technology DRAM제품본부	시스템솔루션그룹 담당임원	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	김태훈	남	1970.02	Arizona State University 미래기술연구원	Obelisk TF 담당임원	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	나한주	남	1963.05	서강대 NAND개발사업부문	Solution제품그룹 담당임원	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	박경	남	1968.07	고려대 한국전자통신연구원	메모리시스템연구소 담당임원	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	박종민	남	1968.08	한국과학기술원 NAND개발본부	NAND설계그룹 담당임원	180	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	유승건	남	1963.06	성균관대 NAND개발본부	NAND제품그룹 담당임원	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	이상원	남	1967.01	고려대 NAND Solution개발본부	SoC그룹 담당임원	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	이창렬	남	1967.02	한국과학기술원 미래기술연구원	DRAM소자기술그룹 담당임원	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	임의철	남	1969.08	성균관대 삼성전자	메모리시스템연구소 담당임원	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	임찬	남	1966.01	연세대 미래기술연구원	NAND Core TF 담당임원	-	-	-
연구위원					한국과학기술원				

직위 (상근여부)	등기임원 여부	성명	성별	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수		비고
							보통주	우선주	
(상근)	미등기임원	임창문	남	1966.06	공정센터	공정기술그룹 담당임원	6,000	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	장경식	남	1967.07	포항공과대 DRAM기술본부	Alius TF 담당임원	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	장세익	남	1966.03	포항공과대 공정센터	NAND공정개발그룹 담당임원	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	전홍신	남	1967.08	서강대 DRAM기술본부	HBM사업그룹 담당임원	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	정성용	남	1972.12	Ohio State University 미래기술연구원	NAND소자기술그룹 담당임원	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	정성웅	남	1967.08	한국과학기술원 미래기술연구원	공정기술그룹 담당임원	242	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	조명관	남	1966.05	포항공과대 NAND개발본부	NAND소자그룹 담당임원	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	채동혁	남	1973.1	서울대 미래기술연구원	NAND Core TF 담당임원	-	-	-
연구위원 (상근)	미등기임원	현창석	남	1967.02	연세대 미래기술연구원	DRAM Core TF 담당임원	-	-	-
기술위원 (상근)	미등기임원	이동준	남	1964.03	인하대 MEMC Korea	M&T기술혁신그룹 담당임원	-	-	-
기술위원 (상근)	미등기임원	이병호	남	1970.05	한국과학기술원 제조/기술부문	DMI그룹 담당임원	-	-	-

(나) 미등기 임원의 변동

[기준일: 제출일 현재]

구분	직명 (상근여부)	등기임원 여부	성명	성별	생년월일	약력	담당업무	소유주식수		비고
								보통주	우선주	
퇴임	연구위원 (상근)	미등기임원	임용희	남	1969.01	Purdue University NAND Solution개발본부	SoC그룹 담당임원	-	-	-

나. 직원의 현황

(기준일: 2017년 09월 30일)

(단위: 천원)

사업부문	성별	직 원 수					평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	비고
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자		합 계				
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)					
-	남	13,855	-	66	-	13,921	10.74	975,232,366	75,035	-
-	여	9,322	-	35	3	9,357	11.30	448,408,309	49,162	-
합 계		23,177	-	101	3	23,278	10.96	1,423,640,676	64,366	-

※ '직원수'는 기준일 본사 재직자(휴직자 포함) 기준이며, 사내이사/사외이사/기타비상무이사 제외 기준임.

※ '연간급여총액'은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준임.

※ '1인당 평균급여액'은 당기 평균인원(22,118명)을 기준으로 계산함.

다. 노동조합의 현황

(기준일: 2017년 9월 30일)

구 분	관 련 내 용	비 고
가입대상	이천 7,349명 / 청주 4,907명	-
가입인원	이천 7,177명 / 청주 4,876명	-
근로시간 면제자	이천 10명 / 청주 6명	-
소속된 연합단체	한국노총 금속노련	-
기 타	-	-

2. 임원의 보수 등

가. 이사·감사 전체의 보수 현황

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
등기임원	10	12,000	-

(2) 이사·감사 전체 지급금액

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
10	3,624	385	-

(3) 유형별 지급금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	3,291	889	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	1	58	58	-
감사위원회 위원	5	275	58	-
감사	-	-	-	-

※ 인원수는 2017. 9. 30 현재 기준임

※ 보수총액 및 1인당 평균보수액은 당기 누적 총액 기준임

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 당기 평균 인원수로 나누어 계산함

※ 등기이사 보수총액의 경우, '17. 3. 24. 부로 신규 선임된 이석희 사내이사의 보수를
선임 시점 이후부터 일할 계산하여 반영함

나. 이사·감사의 개인별 보수 현황

※ 자본시장법 개정으로 인해 임원등의 보수 기재 회수가 연 2회로 축소함에 따라, 분기보고서에는 관련 내용을 기재하지 않는 것으로 함. (제159조 제2항 및 제160조).

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사	1	2,882	-
사외이사	-	-	-
감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
계	1	2,882	-

<표 2>

(기준일 : 2017년 09월 30일)

(단위 :)

부여 받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의 종류	변동수량			미행사 수량	행사기간	행사 가격
					부여	행사	취소			
박성욱	등기임원	2017년 03월 24일	자기주식교부	보통주	99,600	-	-	99,600	2019년 3월 25일부터 2022년 3월 24일까지	48,400
박성욱	등기임원	2017년 03월 24일	자기주식교부	보통주	99,600	-	-	99,600	2020년 3월 25일부터 2023년 3월 24일까지	52,280
박성욱	등기임원	2017년 03월 24일	자기주식교부	보통주	99,600	-	-	99,600	2021년 3월 25일부터 2024년 3월 24일까지	56,460

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단의 개요

- 명 칭 : 에스케이 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률)

나. 관련법령상의 규제내용 등

- "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 上 상호출자제한 및 채무보증제한기업집단
 - 지정시기 : 1987년
 - 규제내용 요약
 - 상호출자의 금지 및 계열사 채무보증 금지 등
 - 대규모내부거래 이사회 결의 및 공시
 - 기업집단 현황 등에 관한 공시
 - 비상장사의 중요사항 공시

다. 기업집단에 소속된 회사 (2017.09.30 기준 계열사 : 101개사)

업종	상장 여부	회사명	법인등록번호
지주회사 (1)	상장사 (1)	SK주)	110111-0769583
	상장사 (6)	SK이노베이션(주)	110111-3710385
		SKQ주)	130111-0001585
		(주)부산도시가스	180111-0039495
		SK에미칼(주)	130111-0005727
		SK가스(주)	110111-0413247
		SK머티리얼즈(주)	190111-0006971
		SK E&S(주)	110111-1632979
		SK에너지(주)	110111-4505967
		SK종합화학(주)	110111-4505975
		SK루브리컨츠(주)	110111-4191815
		SK인천석유화학(주)	120111-0666464
		SK트레이딩인터내셔널(주)	110111-5171064

업종	상장 여부	회사명	법인등록번호
에너지/화학 (40)	비상장사 (34)	(주)대한송유관공사	110111-0671522
		SK모바일에너지(주)	161511-0076070
		SK배터리시스템즈(주)	160111-0337801
		울산아로마틱스(주)	110111-4499954
		한국백슬렌(유)	230114-0003328
		유베이스매뉴팩처링아시아(주)	230111-0168673
		코원에너지서비스(주)	110111-0235617
		충청에너지서비스(주)	150111-0006200
		영남에너지서비스(주)	175311-0001570
		전북에너지서비스(주)	214911-0004699
		위례에너지서비스(주)	110111-4926006
		나래에너지서비스(주)	135711-0092181
		전남도시가스(주)	201311-0000503
		강원도시가스(주)	140111-0002010
		파주에너지서비스(주)	110111-4629501
		보령LNG터미널(주)	164511-0021527
		SK더블유(주)	154311-0026200
		미쓰이케미칼앤에스케이씨폴리우레탄(주)	230111-0233880
		금호미쓰이화학(주)	110111-0612980
		엔티스(주)	130111-0021658
		이니츠(주)	230111-0212074
		SK유화(주)	135811-0120906
		SK어드밴스드(주)	230111-0227982
		당진에코파워(주)	165011-0035072
		SK에어가스(주)	230111-0134111
		SK트리캠(주)	164711-0060753
		SK쇼와덴코(주)	175611-0018553
		SKC하이테크앤마케팅(유)	161514-0001344
	상장사 (4)	SK텔레콤(주)	110111-0371346
		SK하이닉스(주)	134411-0001387
		(주)아이리버	110111-1637383
		SKC솔믹스(주)	134711-0014631
		SK텔링크(주)	110111-1533599
		SK플래닛(주)	110111-4699794
		SK브로드밴드(주)	110111-1466659
		SK커뮤니케이션즈(주)	110111-1322885

업종	상장 여부	회사명	법인등록번호
정보통신/전기전자 (21)	비상장사 (17)	피에스앤마케팅(주)	110111-4072338
		네트웍오앤에스(주)	110111-4370708
		엔트릭스(주)	110111-5770105
		원스토어(주)	131111-0439131
		SK테크엑스(주)	110111-5990547
		홈앤서비스(주)	110111-6420460
		(주)실리콘화일	110111-2645517
		SK하이닉스시스템IC(주)	150111-0235586
		SK텔레시스(주)	110111-1405897
		SKC인프라서비스(주)	134111-0414065
		SK매직(주)	110111-5125962
		SK인포섹(주)	110111-2007858
		(주)에이앤티에스	110111-3066861
건설/물류/서비스 (31)	상장사 (3)	SK네트웍스(주)	130111-0005199
		SK디앤디(주)	110111-3001685
		(주)에스엠코어	110111-0128680
	비상장사 (28)	SK건설(주)	110111-0038805
		SK나리타임(주)	110111-0311392
		내트럭(주)	110111-3222570
		서비스탑(주)	160111-0281090
		서비스에이스(주)	110111-4368688
		(주)엔에스오케이	110111-3913187
		에프앤유신용정보(주)	135311-0003300
		SK엠앤서비스(주)	110111-1873432
		(주)헬로네이처	110111-4867898
		SK하이스텍(주)	134411-0037746
		SK하이이엔지(주)	134411-0017540
		행복모아(주)	150111-0226204
		SK네트웍스서비스(주)	135811-0141788
		카라이프서비스(주)	160111-0306525
		SK핀크스(주)	224111-0003760
		목감휴게소서비스(주)	110111-6257954
		SK매직서비스(주)	134811-0039752
		대전맑은물(주)	110111-4273960
		SK티엔에스(주)	110111-5833250
		SK해운(주)	110111-6364212

업종	상장 여부	회사명	법인등록번호
		SK신택(주)	131411-0232597
		지허브(주)	230111-0205996
		비엔엠개발(주)	110111-5848712
		행복나래(주)	110111-2016940
		SK임업(주)	134811-0174045
		SK엔카닷컴(주)	110111-5384146
		에프에스케이엘앤에스(주)	131111-0462520
		(주)포인트코드	110111-1888548
금융 (1)	상장사 (1)	SK증권(주)	110111-0037112
기타 (7)	상장사 (2)	(주)나노엔텍	110111-0550502
		SK바이오랜드(주)	110111-1192981
	비상장사 (5)	제주유나이티드FC(주)	224111-0015012
		SK와이번스(주)	120111-0217366
		SK플라즈마(주)	131111-0401875
		SK바이오팜(주)	110111-4570720
		SK바이오텍(주)	160111-0395453

(*) 사명 변경 : SK(주) (舊 SK C&C(주)), 엔티스(주) (舊 SK사이텍(주)), SK인포섹(주) (舊 인포섹(주)),
SK배터리시스템즈(주) (舊 SK컨티넨탈이모션코리아(주)), 카라이프서비스(주) (舊 스피드모터스(주)),
나래에너지서비스(주) (舊 하남에너지서비스(주)), 비엔엠개발(주) (舊 엠케이에스개런티(유)),
미쓰이케미칼앤에스케이씨폴리우레탄(주) (舊 에스엠피씨(주)),
SK에어가스(주) (舊 SKC에어가스(주)), SK바이오랜드(주) (舊 (주)바이오랜드),
파주에너지서비스(주) (舊 피엠피(주)), SK엠앤서비스(주) (舊 엠앤서비스(주))
SK매직서비스(주) (舊 매직서비스(주)), SK마리타임(주) (舊 SK해운(주)),
(주)엔에스오케이 (舊 (주)네오에스네트웍스)

라. 관계회사간 출자현황

[2017년 09월 30일 기준]

(보통주 기준)

피투자회사 \\ 투자회사	SK이노베이션	대한송유관공사	SK모바일에너지	행복나래	SK배터리시스템즈	SK에너지	네트릭	제주유나이티드FC	SK종합화학	울산아로마틱스
SK(주)	33.4%									
SK이노베이션		41.0%	100.0%	45.0%	100.0%	100.0%			100.0%	
SK에너지							100.0%	100.0%		
SK종합화학										50.0%
SK루브리컨츠										
SK텔레콤				45.0%						
SK브로드밴드										
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										
SKC솔믹스										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK마리타임										
SK케미칼										
SK신텍										
SK가스				5.0%						
SK디앤디										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	33.4%	41.0%	100.0%	95.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%

피투자회사 \\ 투자회사	SK루브리컨츠	유베이스매뉴팩처링아시아	SK인천석유화학	SK트레이딩 인터내셔널	SK텔레콤	SK커뮤니케이션즈	SK와이브스	에프앤유신용정보	PS&마케팅	네트웍오앤에스
SK(주)					25.2%					
SK이노베이션	100.0%		100.0%	100.0%						
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠		70.0%								
SK텔레콤						100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%
SK브로드밴드										
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										
SKC솔믹스										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										

피투자회사 \\ 투자회사	SK루브리컨츠	유베이스매뉴 팩처링아시아	SK인천석유화학	SK트레이딩 인터내셔널	SK텔레콤	SK커뮤니케이션즈	SK와이브스	에프앤유신용정보	PS&마케팅	네트웍오앤에스
SK건설										
SK마리타임										
SK에미칼										
SK신타										
SK가스										
SK디앤디										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	100.0%	70.0%	100.0%	100.0%	25.2%	100.0%	100.0%	50.0%	100.0%	100.0%

피투자회사 \\ 투자회사	서비스에이스	서비스탑	아이리버	엔트릭스	SK테크엑스	원스토어	나노엔텍	SK브로드밴드	홈앤서비스	SK텔링크
SK(주)										
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤	100.0%	100.0%	45.9%	100.0%	100.0%	65.5%	28.5%	100.0%		85.9%
SK브로드밴드									100.0%	
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										
SKC솔믹스										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK마리타임										
SK에미칼										
SK신타										
SK가스										
SK디앤디										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	100.0%	100.0%	45.9%	100.0%	100.0%	65.5%	28.5%	100.0%	100.0%	85.9%

피투자회사 \\ 투자회사	엔에스오케이	SK플래닛	SK엠앤서비스	헬로네이처	SK하이닉스	SK하이신타	실리콘화일	SK하이이엔지	행복모아	SK하이닉스 시스템IC
SK(주)										
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤		98.1%			20.1%					
SK브로드밴드										

피투자회사 \ 투자회사	엔에스오케이	SK플래닛	SK엠펜서비스	헬로네이처	SK하이닉스	SK하이닉스	실리콘화일	SK하이이엔지	행복모아	SK하이닉스 시스템IC
SK텔링크	100.0%									
SK플래닛			100.0%	100.0%						
SK하이닉스						100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
SK E&S										
SKC										
SKC솔믹스										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK마리타임										
SK에미칼										
SK신텍										
SK가스										
SK디앤디										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	100.0%	98.1%	100.0%	100.0%	20.1%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

피투자회사 \ 투자회사	SK E&S	부산도시가스	충청에너지 서비스	영남에너지 서비스	전남도도시가스	전북에너지 서비스	강원도시가스	위례에너지 서비스	파주에너지 서비스	보령LNG터미널
SK(주)	100.0%									
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤										
SK브로드밴드										
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S		67.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.2%	100.0%	50.0%
SKC										
SKC솔믹스										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK마리타임										
SK에미칼										
SK신텍										
SK가스										
SK디앤디										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	100.0%	67.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	95.2%	100.0%	50.0%

피투자회사 투자회사	코원에너지 서비스	나래에너지 서비스	SKC	SKC솔믹스	SK더블유	SK바이오랜드	SKC하이테크앤 마케팅	SK텔레시스	SKC인프라 서비스	미쓰이케미칼앤드 SKC폴리우레탄
SK(주)			41.0%							
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤										
SK브로드밴드										
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S	100.0%	100.0%								
SKC				57.7%	100.0%	27.9%	100.0%	79.4%		50.0%
SKC솔믹스										
SK텔레시스									100.0%	
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK마리타임										
SK케미칼										
SK신타										
SK가스										
SK디앤디										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	100.0%	100.0%	41.0%	57.7%	100.0%	27.9%	100.0%	79.4%	100.0%	50.0%

피투자회사 투자회사	SK네트웍스	SK네트웍스 서비스	SK핀크스	카라이프서비스	목감휴게소 서비스	SK매직	SK매직서비스	SK건설	대전말은물	SK티엔에스
SK(주)	39.1%							44.5%		
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤										
SK브로드밴드										
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										
SKC솔믹스										
SK텔레시스										
SK네트웍스		86.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
SK매직							100.0%			
SK건설									32.0%	100.0%
SK마리타임										
SK케미칼	0.02%							28.2%		
SK신타										
SK가스										

파투자회사 \\ 투자회사	SK네트웍스	SK네트웍스 서비스	SK핀크스	카라이프서비스	목감휴게소 서비스	SK매직	SK매직서비스	SK건설	대전맑은물	SK티엔에스
SK디앤디										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	39.2%	86.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	72.7%	32.0%	100.0%

파투자회사 \\ 투자회사	SK마리타임	SK해운	SK증권	엔티스	이니츠	SK플라즈마	SK신택	SK유화	SK가스	SK디앤디
SK(주)	99.9%		10.0%							
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤										
SK브로드밴드										
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										
SKC솔믹스										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK마리타임		57.2%								
SK에미칼				50.0%	66.0%	100.0%	100.0%	100.0%	45.6%	
SK신택									10.0%	
SK가스										31.0%
SK디앤디										
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	99.9%	57.2%	10.0%	50.0%	66.0%	100.0%	100.0%	100.0%	55.5%	31.0%

파투자회사 \\ 투자회사	비엔엠개발	지허브	SK어드밴스드	당진에코파워	SK바이오팜	SK바이오텍	SK임업	SK인포섹	SK엔카닷컴	FSK L&S
SK(주)					100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	60.0%
SK이노베이션										
SK에너지										
SK종합화학										
SK루브리컨츠										
SK텔레콤										
SK브로드밴드										
SK텔링크										
SK플래닛										
SK하이닉스										
SK E&S										
SKC										

피투자회사 \\ 투자회사	비엔엠개발	지허브	SK어드밴스드	당진에코파워	SK바이오팜	SK바이오텍	SK임업	SK인포섹	SK엔카닷컴	FSK L&S
SKC솔믹스										
SK텔레시스										
SK네트웍스										
SK매직										
SK건설										
SK마리타임										
SK에미칼										
SK신텍										
SK가스		100.0%	45.0%	51.0%						
SK디앤디	100.0%									
SK머티리얼즈										
에스엠코어										
계열사 계	100.0%	100.0%	45.0%	51.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	50.0%	60.0%

피투자회사 \\ 투자회사	SK머티리얼즈	SK에어가스	SK트리켄	SK쇼와덴코	에스엠코어	포인트코드
SK(주)	49.1%				26.7%	
SK이노베이션						
SK에너지						
SK종합화학						
SK루브리컨츠						
SK텔레콤						
SK브로드밴드						
SK텔링크						
SK플래닛						
SK하이닉스						
SK E&S						
SKC						
SKC솔믹스						
SK텔레시스						
SK네트웍스						
SK매직						
SK건설						
SK마리타임						
SK에미칼						
SK신텍						
SK가스						
SK디앤디						
SK머티리얼즈		80.0%	65.0%	51.0%		
에스엠코어						68.9%

피투자회사 \ 투자회사	SK머티리얼즈	SK에어가스	SK트리캠	SK쇼와덴코	에스엠코어	포인트코드
계열사 계	49.1%	80.0%	65.0%	51.0%	26.7%	68.9%

마. 해외계열사 현황

[2017년 09월 30일 기준]

No.	해외계열사명
1	SK Gas America Ltd.
2	SK Gas International Pte. Ltd.
3	SK Gas Trading LLC
4	SK Gas USA Inc.
5	Avrasya Tuneli Isletme Insaat Ve Yatirim A.S.
6	SK Holdco PTE. LTD.
7	BT RE Investments, LLC
8	Hi Vico Construction Company Limited
9	Irunex Construction and Management Co., Ltd.
10	Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.
11	Mesa Verde RE Ventures, LLC
12	SBC General Trading & Contracting Co. W.L.L.
13	SK E&C BETEK Corp.
14	SK E&C Consultores Ecuador S.A.
15	SK E&C India Private Ltd.
16	SK E&C Jurong Investment Pte. Ltd.
17	SK E&C Saudi Company Limited
18	SK Engineering&Construction(Nanjing)Co.,Ltd.
19	SK International Investment Singapore Pte. Ltd.
20	SKEC Anadolu LLC
21	SKEC(Thai) Limited
22	Sunlake Co., Ltd.
23	Thai Woo Ree Engineering Co., Ltd
24	SK Networks (Liaoning) Logistics Co., Ltd
25	Daiyang-SK Networks Metal SAN. VE TIC. Ltd. STI.

No.	해외계열사명
26	Dandong Lijiang Estate Management co.,LTD
27	SK Networks(Dandong) Energy Co.,Ltd.
28	Liaoning SK Industrial Real Estate Development Co., Ltd.
29	Novoko B.V.
30	P.T. SK Networks Indonesia
31	POSK(Pinghu) Steel Processing Center Co.,Ltd.
32	Shenyang SK Bus Terminal Co., Ltd.
33	Shenyang SK Networks Energy Co., Ltd.
34	Sichuan sinoeco recycle Co.,. Ltd.
35	SK (Guangzhou) Metal Co., Ltd.
36	SK (GZ Freezone) Co.,Ltd.
37	SK BRASIL LTDA
38	SK Networks (Xiamen) Steel Processing Center Co., Ltd.
39	SK Networks Deutschland GmbH
40	SK Networks HongKong Ltd.
41	SK Networks Japan Co., Ltd.
42	SK Networks Middle East FZE
43	SK Networks Resources Australia (Wyong) Pty Ltd.
44	SK Networks Resources Australia Pty Ltd.
45	SK Networks Resources Canada Ltd.
46	SK Networks Resources Pty Ltd.
47	SK Networks Trading Malaysia Sdn Bhd
48	SK Networks(Shanghai) Co.,Ltd.
49	SK Networks(China) Holdings Co.,Ltd.
50	PT. Surya Bara Pratama
51	Springvale SK Kores Pty Ltd.
52	IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY, S.A.
53	PT. Patra SK

No.	해외계열사명
54	SK Energy Lubricants (Tianjin) Co., Ltd.
55	SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd.
56	SK Lubricants Americas, Inc.
57	SK Lubricants Europe B.V.
58	SK Lubricants Japan Co., Ltd.
59	SK Lubricants Rus Limited Liability Company
60	SK Life Science, Inc.
61	SK Bio-pharm Tech(Shanghai) Co., Ltd
62	Solmics Shanghai International Trading Co., Ltd.
63	Solmics Taiwan Co., Ltd.
64	SKC (Jiangsu) High Tech Plastics
65	SKC Europe GmbH
66	SKC International Shanghai Trading Co., Ltd.
67	SKC, Inc.
68	SKC Hi-Tech&Marketing(Suzhou) Co., Ltd.
69	SKC Hi-Tech&Marketing Taiwan Co., Ltd.
70	SKC Hi-Tech&Marketing Japan Co., Ltd.
71	SKC Hi-Tech&Marketing Polska SP.Z.O.O
72	SKC Hi-Tech&Marketing USA LLC
73	Asia Bitumen Trading Pte Ltd.
74	Chongqing SK Asphalt Co., Ltd.
75	Hefei SK Baoying Asphalt Co., Ltd.
76	Netruck Franz Co., Ltd.
77	Ningbo SK Baoying Asphalt Co., Ltd.
78	Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd.
79	SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd.
80	SK Energy Hong Kong Ltd.
81	SK Energy Road Investment Co., Ltd.

No.	해외계열사명
82	SK Energy Road Investment(HK) Co., Ltd.
83	Moche energy SAC.
84	SK E&P America, Inc.
85	SK E&P Company
86	SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd.
87	SK Permian, LLC
88	SK Plymouth, LLC
89	SK USA, Inc.
90	CAILIP Gas Marketing, LLC
91	China Gas-SK E&S LNG Trading Ltd.
92	DewBlaine Energy, LLC
93	PT SK E&S Nusantara
94	SK E&S Americas, Inc.
95	SK E&S Australia Pty Ltd.
96	SK E&S Hong Kong Co., Ltd
97	SK E&S LNG, LLC
98	Fajar Energy International Pte., Ltd
99	Prism Energy International Pte., Ltd.
100	Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd.
101	SABIC SK Nexlene Company Pte.Ltd.
102	FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd.
103	Shanghai-GaoQiao SK Solvent Co., Ltd.
104	SK GC Americas, Inc.
105	SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.
106	SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.
107	SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.
108	SK Global Chemical Investment Hong Kong Ltd.
109	SK Global Chemical Japan Co., Ltd.

No.	해외계열사명
110	SK Global Chemical Singapore Pte.Ltd.
111	SK Golden Tide Plastics (Yantai) Co., Ltd.
112	SK Hualun Specialty Chemical Co., Ltd.
113	SK-SWW (Chongqing) Chemical Co., Ltd.
114	Zhejiang Shenxin SK Packaging Co., Ltd.
115	Huizhou SK TCL Taidong Chemical Co.,Ltd.
116	SK Primacor Americas LLC
117	SK Primacor Europe, S.L.U.
118	Beijing SK Magellan Capital Advisors Co., Ltd.
119	CFC-SK El Dorado Capital Partners, Ltd.
120	CFC-SK El Dorado Management Company, Ltd.
121	Dogus SK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.S.
122	Gemini Partners Pte. Ltd
123	Hermed Capital
124	Hermed Capital Health Care (RMB) GP Limited
125	Hermed Capital Health Care Fund L.P.
126	Hermed Capital Health Care GP Ltd
127	Hermed Equity Investment Management (Shanghai) Co., Ltd.
128	Prostar Capital Ltd.
129	Prostar Capital Management Ltd.
130	Prostar Asia Pacific Energy Infrastructure SK Fund L.P.
131	SK GI Management
132	Solaris GEIF Investment
133	Solaris Partners Pte. Ltd
134	Ningde Sky Beverage Co., Ltd.
135	Shanghai SKY Real Estate Development Co.,Ltd.
136	SK Beijing Investment Management Limited
137	SK Bio Energy HongKong Co.,Limited

No.	해외계열사명
138	Sky Yunjian Investment Management Limited
139	SK China Company, Ltd.
140	SK China Investment Management Company Limited
141	SK China(Beijing) Co.,Ltd.
142	SK Industrial Development China Co., Ltd.
143	SK International Agro-Products Logistics Development Co., Ltd.
144	SK International Agro-Sideline Products Park Co.,Ltd.
145	SK International Supply Chain Management Co., Ltd.
146	SK Property Investment Management Company Limited
147	SKY Property Mgmt(Beijing) Co.Ltd.
148	SK Auto Service Hong Kong Ltd.
149	SK (Shenyang) Auto Rental Co.,Ltd
150	SK (Beijing) Auto Rental Co.,Ltd
151	SK (Qingdao) Auto Rental Co.,Ltd
152	SK (Suzhou) Auto Rental Co.,Ltd
153	SK (Guangzhou) Auto Rental Co.,Ltd
154	SK Investment Management Co. Ltd.
155	Skyline Auto Financial Leasing Co, Ltd.
156	SK Financial Leasing Co, Ltd.
157	SKY Property Management Ltd.
158	SK China Real Estate Co., Ltd
159	SK China Creative Industry Development Co., Ltd
160	SKY Investment Co., Ltd
161	SK S.E. Asia Pte. Ltd.
162	SK MENA B.V.
163	SK C&C India Pvt., Ltd.
164	SK C&C Beijing Co., Ltd.
165	SK C&C Chengdu Co., Ltd

No.	해외계열사명
166	S&G Technology
167	ESSENCORE Limited
168	Essencore Microelectronics (ShenZhen) Limited
169	ShangHai YunFeng Encar Used Car Sales Service Ltd.
170	SK computer and communication L.L.C.
171	Hudson Energy NY, LLC
172	Plutus Capital NY, Inc.
173	PT Sinar Timuran Green Energi
174	SK Chemicals America, Inc.
175	SK Chemicals GmbH
176	SK Pharma Beijing Co., Ltd
177	SK Chemicals (Suzhou) Co., Ltd
178	SK Chemicals (Qingdao) Co., Ltd.
179	ST Green Energy Pte, Ltd
180	SE(Jiangsu) Electronic Materials Co., LTD
181	SK Telesys Corp.
182	TechDream Co. Limited
183	Atlas Investment Ltd.
184	Axess II Holdings
185	CYWORLD China Holdings
186	Global Opportunities Breakaway Fund
187	Global opportunities Fund
188	Harbinger China Dragon Fund
189	SK Global Healthcare Business Group Ltd.
190	SK Healthcare China Holding Co.
191	SK Healthcare Co.,Ltd.
192	SK Latin America Investment S.A.
193	SK Medical(Beijing) Co. Ltd

No.	해외계열사명
194	SK MENA Investment B.V.
195	SK Technology Innovation Company
196	SK Telecom (China) Holding Co.,Ltd.
197	SK Telecom Americas, Inc.
198	SK Telecom China Co.,Ltd.
199	SK Telecom China Fund 1 L.P.
200	SK Telecom Smart City Management Co., Ltd
201	SK Telecom Venture Capital, LLC
202	SK Telecom Vietnam PTE.,Ltd.
203	SKCREGC(Sichuan)Smart City Management Co.
204	SKTA Innopartners, LLC
205	Tianlong-Suzhou
206	Tianlong-Xian
207	ULand Company Limited
208	Westly Capital Partners Fund II
209	YTK Investment Ltd.
210	SK Healthcare(Wuxi) Co., Limited
211	SK Telecom Innovation Fund, L.P.
212	Fitech Global Opportunities Limited
213	Immersive Capital, L.P.
214	12CM Global PTE. LTD.
215	Celcom Planet Sdn Bhd
216	Dogus Planet Inc.
217	PT XL Planet
218	11street (Thailand) Co., Ltd.
219	Shopkick GmbH
220	Shopkick, Inc.
221	Shopkick Management Company, Inc.

No.	해외계열사명
222	Planet11 Ecommerce Solutions India Private Limited
223	SK Planet Global Holdings Pte. Ltd.
224	SK Planet Global Pte. Ltd.
225	SK Planet, Inc.
226	SK Planet Japan K.K.
227	SKP America, LLC
228	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd.
229	SK APTECH Ltd.
230	SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.
231	SK hynix America Inc.
232	SK hynix Asia Pte. Ltd.
233	SK hynix Deutschland GmbH
234	SK hynix Flash Solution Taiwan Ltd.
235	SK hynix Italy S.r.l
236	SK hynix Japan Inc.
237	SK hynix memory solutions Inc.
238	SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.
239	SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.
240	SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.
241	SK hynix Semiconductor India Private Ltd.
242	SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.
243	SK hynix Semiconductor(China) Ltd.
244	SK hynix Semiconductor(Shanghai) Co., Ltd.
245	SK hynix U.K Ltd.
246	SK hynix Ventures Hong Kong Limited
247	Softeq Flash Solutions LLC.
248	Great Shale LNG Transport S.A.
249	MILESTONE LNG TRANSPORT S.A.

No.	해외계열사명
250	OCEAN MARITIME HONGKONG LIMITED
251	S&Y Shipping S.A.
252	SK B&T PTE. LTD.
253	SK shipping Europe Plc.
254	SK shipping Hongkong Ltd.
255	SK shipping Japan Co., Ltd.
256	SK shipping Singapore Pte. Ltd.
257	Dalian Sea Oil Petroleum Chemicals Co.,Ltd
258	HBNG Logitics Co., Ltd.
259	Chongqing Happynarae Co., Ltd.
260	SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.
261	Bergaya International Pte, Ltd.
262	SK Energy Americas Inc.
263	SK Energy Europe, Ltd.
264	SK Energy International Pte, Ltd.
265	SK Terminal B.V.
266	Dongguan Iriver Electronics Co., Ltd.
267	groovers Japan Co., Ltd.
268	Irriver China Co., Ltd.
269	Irriver Enterprise Ltd.
270	Irriver Inc.
271	S.M. LIFE DESIGN COMPANY JAPAN INC.
272	Bioland Biotec Co.,Ltd
273	Bioland Haimen Co.,Ltd
274	Beijing Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.
275	Foshan Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Co., Ltd.
276	MCNS Polyurethanes Europe Sp. zo.o.
277	MCNS Polyurethanes Malaysia Sdn Bhd

No.	해외계열사명
278	MCNS Polyurethanes Mexico, S. de R.L. de C.V
279	MCNS Polyurethanes USA Inc.
280	Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.
281	PT. MCNS Polyurethanes Indonesia
282	SMPC Europe Sp. zo.o.
283	Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd.
284	Tianjin Cosmo Polyurethanes Co., Ltd.
285	MCNS Polyurethanes India Pvt. Ltd.
286	SK Materials (Jiangsu) Co., Ltd.
287	SK Materials (Xian) Co., Ltd.
288	SK Materials Japan Co., Ltd.
289	SK Materials Taiwan Co., Ltd.
290	SK Securities Investment Asia Limited
291	SMC US, INC
292	SK TNS Myanmar Co.,Ltd
293	SK BIOTEK IRELAND LIMITED
294	Nanoentek USA Inc.
295	FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd.

바. 계열회사 등 관리조직 현황

[SK하이이엔지, SK하이텍, 실리콘화일, SK하이닉스시스템아이씨]

당사는 상기 계열회사들과 특별약정을 체결하고 있으며, 경영기획실에서 당사를 대표하여 대주주로서의 역할을 담당하고 있습니다. 각 계열회사의 경영상 의사결정은 자체적인 이사회 의결을 원칙으로 하되, 경영계획, 이사 및 경영진 임면 등 주요 경영 사항과 관련해서는 특별약정에 의거하여 당사와 사전 협의하도록 하고 있습니다. 당사의 경영기획실은 회사를 대표하여 이들 계열회사들에 상기 특별약정에 의거한 대주주로서의 의사표시를 하고 있습니다. 한편, 당사와 동 계열회사간의 용역 서비스 계약 및 도급계약은 다른 일반 계약과 상이하지 않게 진행하고 있습니다.

[SKHYA(미주), SKHYCS(상해), SKHYT(대만), SKHYD(독일), SKHYU(영국), SKHYJ(일본), SKHYS(싱가폴), SKHYS(인도), SKHYH(홍콩), SKHYCW(우시)]

당사의 상기 판매법인들은 "Distribution Agreement"에 의해 당사의 해외 법인으로서 판매 행위를 대행하며, 이에 법인 운영에 필요한 운영전반에 대해 본사의 지원을 보장 받습니다. 판매법인은 본사조직으로 구성, 운영되며 각 기능상의 소속본부에서 각 업무를 관장 합니다.

사. 회사와 계열사간 임원 겸직 현황

[기준일: 2017년 9월 30일]

겸직임원		겸직 계열회사		비 고
성 명	직 위	회 사 명	상근여부	
박 성 욱	대표이사	SK hynix Semiconductor China Ltd.	비상근	-
		SK hynix memory solutions Inc.	비상근	-
김 준 호	이 사	SK hynix Semiconductor China Ltd.	비상근	-
		에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)	상 근	-
박 정 호	이 사	SK텔레콤	상 근	-

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일)

(단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
				수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
							수량	금액						
에스케이하이엔지 주식회사	2001년 07월 05일	경영참가	7,399	500,689	100.00	7,521	-	-	0	500,689	100.00	7,521	54,265	4,805
에스케이하이텍 주식회사	2008년 03월 15일	경영참가	5,840	277,203	100.00	6,760	-	-	0	277,203	100.00	6,760	37,050	2,334

법인명	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
				수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
							수량	금액						
(주)실리콘화일	2008년 08월 12일	경영참가	76,904	8,444,276	100.00	30,756	-	-	0	8,444,276	100.00	30,756	34,438	1,710
행복모아 주식회사	2016년 10월 12일	경영참가	3,000	600,000	100.00	3,000	880,000	4,400	0	1,480,000	100.00	7,400	2,988	-12
SK hynix Semiconductor America Inc.(SK-HYA)	1983년 03월 15일	경영참가	1,231,196	6,285,587	97.74	31	-	-	0	6,285,587	97.74	31	1,584,043	117,848
SK hynix Semiconductor Deutschland GmbH(SK-HYD)	1989년 03월 01일	경영참가	80,956	-	100.00	22,011	-	-	0	-	100.00	22,011	83,388	1,747
SK hynix UK Ltd.(SK-HYU)	2013년 11월 05일	경영참가	1,775	186,240,200	100.00	1,775	-	-	0	186,240,200	100.00	1,775	146,327	374
SK hynix Semiconductor Asia Pte.Ltd.(SK-HYS)	1991년 09월 12일	경영참가	137,532	196,303,500	100.00	52,380	-	-	0	196,303,500	100.00	52,380	337,506	1,929
SK hynix Semiconductor HongKong Ltd.(SK-HYH)	1995년 04월 27일	경영참가	223,233	170,693,661	100.00	32,623	-	-	0	170,693,661	100.00	32,623	932,437	20,019
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.(SK-HYCS)	2006년 06월 29일	경영참가	6,357	-	100.00	4,032	-	-	0	-	100.00	4,032	46,177	6,073
SK hynix Semiconductor Japan Inc.(SK-HYJ)	1996년 09월 16일	경영참가	81,587	20,000	100.00	42,905	-	-	0	20,000	100.00	42,905	251,274	867
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.(SK-HYT)	1996년 09월 16일	경영참가	13,330	35,725,000	100.00	37,562	-	-	0	35,725,000	100.00	37,562	310,933	2,676
SK hynix Semiconductor Indian Subcontinent Private Ltd.(SK-HYS)	2007년 03월 29일	투자	5	270	1.00	5	-	-	0	270	1.00	5	886	60
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.(SK-HYCL)	2005년 06월 30일	경영참가	1,966,060	-	90.26	2,520,881	-	-	0	-	90.26	2,520,881	3,476,086	123,753
SK hynix Semiconductor (Wuxi) Ltd.(SK-HYMC)	2006년 04월 17일	경영참가	47,384	-	100.00	238,271	-	-	0	-	100.00	238,271	270,693	663
Hitech Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(HITECH)	2009년 11월 17일	경영참가	90,150	-	45.00	92,608	-	-	0	-	45.00	92,608	525,649	38,676
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.(SK-HYCW)	2010년 07월 29일	경영참가	237	-	100.00	237	-	-	0	-	100.00	237	633	-78
SK hynix Italy(SK-HYIT)	2012년 05월 11일	경영참가	18	-	100.00	18	-	-	0	-	100.00	18	3,232	339
SKHMS(SK Hynix Memory Solutions Inc.)	2012년 08월 20일	경영참가	311,284	128	100.00	311,284	-	-	0	128	100.00	311,284	72,346	-3,928
SK hynix Semiconductor Flash Solution Taiwan (SK-HYFST)	2013년 08월 29일	경영참가	7,819	-	100.00	7,819	-	-	0	-	100.00	7,819	8,644	319
SK APTEch	2013년 09월 02일	경영참가	166,299	157,000,000	100.00	166,299	-	-	0	157,000,000	100.00	166,299	166,556	-17
Soiteq Flash Solutions LLC.	2014년 06월 03일	경영참가	14,579	-	99.90	14,579	-	-	0	-	99.90	14,579	4,888	198
STRATIO,INC.	2015년 02월 12일	투자	2,194	1,136,013	9.12	2,194	-	-	0	1,136,013	9.12	2,194	1,635	-33
Sky Property	2013년 12월 27일	투자	112,360	5,745	15.00	112,360	-	-	0	5,745	15.00	112,360	625,011	-53,635
Keyssa,Inc.	2016년 02월 25일	투자	6,174	1,521,838	2.29	6,174	-	-	0	1,521,838	2.29	6,174	34,031	-23,875
Exnodes, Inc.	2016년 03월 17일	투자	716	-	-	716	-	-	0	-	-	716	1,582	-693
SK hynix Ventures Hong Kong Limited	2016년 03월 09일	투자	2,512	2,100,000	100.00	2,512	-	-	0	2,100,000	100.00	2,512	2,441	-22
NetSpeed Systems,Inc.	2016년 05월 26일	투자	3,083	2,893,071	6.07	3,083	-	-	0	2,893,071	6.07	3,083	9,953	-3,883
MEMS DRIVE,INC.	2016년 10월 20일	투자	2,246	188,451	2.94	2,246	-	-	0	188,451	2.94	2,246	8,253	-5,565
특정금전신탁	2008년 11월 17일	투자	21,847	201,600,000	7.93	0	-	-	0	201,600,000	7.93	0	1,405,327	-470,296
인텔렉추얼디스커버리	2011년 05월 13일	투자	4,000	800,000	7.05	4,000	-	-	0	800,000	7.05	4,000	42,653	4,068

법인명	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황	
				수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
							수량	금액						
에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)	2017년 05월 11일	경영참가	343,295	-	-	-	20,000,000	290,172	0	20,000,000	100.00	290,172	-	-
SK CHINA	2017년 08월 18일	경영참가	257,169	-	-	-	4,754,868	257,169	0	4,754,868	11.87	257,169	-	-
RENO SUB-SYSTEM, INC	2017년 09월 01일	투자	2,246	-	-	-	1,190,476	2,246	0	1,190,476	2.68	2,246	-	-
합 계				-	-	3,726,641	-	347,695	0	-	-	4,074,336	-	-

※ 최근 사업연도 재무현황은 2016년 말 실적이며 특정금전신탁은 가장 최근 자료인 2012년 9월말 기준 재무제표상 금액을 반영함

※ '출자증서' 및 '전환사채'의 형태로 출자된 타법인의 경우 수량을 '-'으로 표기함

※ 당사는 2017년 2분기 중 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)를 설립하고, 동년 5월 24일 이사회 결의를 통해 343,295백만원의 유상증자와 함께 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)에 대한 당사의 파운드리 사업 관련 자산 등의 포괄적 양도를 진행함. 동 영업양도 거래는 상업적 실질이 없으므로, 양도한 순자산 장부금액과 수취한 양도대가의 차이금액을 투자주식의 장부금액에서 조정함

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 자산양수도 등

가. 자산양수도 내역

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	거래일자	거래일자 기준	거래금액	거래내용	비 고
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2017년 1월	매각일자	63,427	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2017년 5월	매각일자	170	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2017년 6월	매각일자	700	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2017년 7월	매각일자	606	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2017년 8월	매각일자	1,339	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2017년 9월	매각일자	110	매각	생산 효율화 목적
HITECH Semiconductor(Wuxi) CO.,Ltd.	공동기업	2017년 2월	매각일자	39	매각	생산 효율화 목적
HITECH Semiconductor(Wuxi) CO.,Ltd.	공동기업	2017년 4월	매각일자	126	매각	생산 효율화 목적
HITECH Semiconductor(Wuxi) CO.,Ltd.	공동기업	2017년 8월	매각일자	223	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2017년 2월	매각일자	601	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2017년 3월	매각일자	1,846	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2017년 3월	매각일자	1,719	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2017년 5월	매각일자	265	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2017년 6월	매각일자	2,973	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2017년 7월	매각일자	1,659	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(CHONGQING) Ltd.	해외법인	2017년 8월	매각일자	292	매각	생산 효율화 목적
SK hynix America Inc.	해외법인	2017년 1월	매각일자	125	매각	생산 효율화 목적
SK hynix America Inc.	해외법인	2017년 7월	매각일자	44	매각	생산 효율화 목적
SK hynix America Inc.	해외법인	2017년 8월	매각일자	44	매각	생산 효율화 목적
SK hynix America Inc.	해외법인	2017년 9월	매각일자	44	매각	생산 효율화 목적
에스케이하이닉스 시스템아이씨	국내법인	2017년 7월	매각일자	55,650	자산양도	사업 효율화 목적
ESSENCOORE Limited	해외관계사	2017년 7월	매각일자	9,403	매각	생산 효율화 목적
ESSENCOORE Limited	해외관계사	2017년 8월	매각일자	5,071	매각	생산 효율화 목적
ESSENCOORE Limited	해외관계사	2017년 9월	매각일자	383	매각	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2017년 3월	매입일자	1,262	매입	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2017년 4월	매입일자	2,910	매입	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2017년 5월	매입일자	78	매입	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2017년 6월	매입일자	1,091	매입	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2017년 7월	매입일자	3,152	매입	생산 효율화 목적
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	2017년 8월	매입일자	1,462	매입	생산 효율화 목적

※ SK hynix Semiconductor(China) Ltd.처분손익은 분기말 환율 적용 : 1분기 162.27, 2분기 167.79, 3분기 172.35

※ 법인간 매매금액 산정 기준

- FMV (공정거래가격) : 구매실에서 중고장비거래 업체에 시장가 문의
- 부대비용 / 운송비 / 보험료 등은 당사 구매조직에서 산정

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 · 변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 · 변경사항

신고일자	제 목	신고 내용 / 신고사항의 진행사항
2015.08.25	장래사업 경영계획 (공정공시)	2014년 이후 10년간 금일 준공하는 이전 M14를 포함하여 신규 공장 세 개 건설함. 이전 M14 건설 및 장비투자에 총 15조원 투자할 계획임. 향후 이전/청주에 각각 1개씩 신규공장건설 및 장비투자에 추가로 31조원 투자할 계획이며, 상당기간이 소요되는 부지조성 및 인프라 확보에 우선 착수하고 fab 건설 및 장비투자 시기는 향후 시장 및 수요상황을 고려하여 결정할 예정임.
2016.12.22	신규 시설투자 등	2015년 8월 25일 공시한 장래사업 경영계획(공정공시)에 따라, 청주에 신규 클린룸 건설을 통한 중장기 경쟁력 강화 목적으로 2017년 8월부터 2019년 6월까지 2.2조 원을 투자할 계획임
2016.12.22	신규 시설투자 등 (자율공시)	공정 미세화에 따른 공정수 증가 및 장비 대형화에 따라 공정 전환을 위해 지속적인 공간 확보 필요성이 대두되어, 우시FAB의 중장기 경쟁력 유지를 위한 클린룸 확장 투자를 2017년 7월부터 2019년 4월까지 약 9,500억 원을 집행할 계획임
2017.5.24	기타경영사항(자율공시)	지난 4월 27일자 조회공시 요구에 대한 미확정 답변 공시에 이어, 당사 파운드리 사업의 본원적 경쟁력을 강화를 위해 신설 법인에 파운드리 사업부의 영업을양도하기로 결정하였음을 공시
2017. 7. 14	조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(부인)	지난 1월 16일 미국 씨게이트와의 합작법인 추진 보도에 대한 미확정 답변 이후 6개월 내에 재공시할 것으로 답변한 바 있으며, 이에 따라 양사가 만족할 수 있는 방안을 찾기가 어려워 협의를 종결하기로 결정하였음을 답변
2017. 7. 26	[정정] 장래사업-경영계획(공정공시)	지난 1월 26일 공시했던 연간 투자 계획에 대한 정정 공시로, 시장 환경 변화에 적극적으로 대응하고 사업경쟁력 강화와 미래성장 기반 확보를 위해 당사는 해외법인을 포함한 2017년 시설투자 계획을 당초 약 7조원에서 약 9.6조원으로 변경함
2017.9.27	타법인 주식 및 출자 증권 취득결정	지난 6월 21일 도시바 반도체 사업 지분 인수 관련 자율공시 이후, 해당 사업의 지분 인수를 위한 특수목적법인(SPC)인 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP 에 대한 투자를 결의하였으며 Bain Capital 이 조성할 펀드에 JPY 266,000,000,000 을 Limited Partner 자격으로 투자 예정
2017.9.27	타법인 주식 및 출자 증권 취득결정	상기 공시와는 별개의 투자 관련 사항으로, 도시바 반도체 사업 관련하여 또 다른 특수목적법인(SPC)인 BCPE Pangea Cayman2 Limited 가 발행할 JPY 129,000,000,000 의 전환사채를 인수할 예정이며, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보가 가능함

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고
제 69기 정기주주총회 (2017.03.24)	제69기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	정관 변경의 건	원안대로 승인	
	사내이사 선임의 건(후보:이석희)	원안대로 승인	
	기타비상무이사 선임의 건(후보:박정호)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보:최종원)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보:신창환)	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:최종원)	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:신창환)	원안대로 승인	
	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	
	주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인	
제 68기 정기주주총회 (2016.03.18)	제68기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건 (후보: 김준호)	원안대로 승인	
	사내이사 선임의 건 (후보: 박정호)	원안대로 승인	
	이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	
	임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건	원안대로 승인	
제 67기 정기주주총회 (2015.03.20)	제67기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안대로 승인	
	이사보수 한도 승인의 건	원안대로 승인	
제 66기 정기주주총회 (2014.03.21)	제66기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-
	사내이사 선임의 건(후보: 임형규)	원안대로 승인	
	사외이사 선임의 건(후보: 최종원)	원안대로 승인	
	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 최종원)	원안대로 승인	
	이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 (이사보수한도 : 120억원)	
	임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건	원안대로 승인	

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건

(1) Netlist, Inc.("Netlist") 특허권 침해 소송

Netlist, Inc.는 지배회사와 SK hynix America Inc. 등 지배회사의 종속기업들을 상대로 다수의

특허를 침해했다는 소송을 2016년 8월 31일 및 2017년 6월 14일 미국 캘리포니아 중부지방법원에, 2016년 9월 1일 및 2017년 10월 31일 미국국제무역위원회에, 2017년 7월 11일 독일 뮌헨 지방법원 및 중국베이징 지식재산법원에 각각 제기하여 소송이 진행 중에 있습니다. 당분기말 현재 미국 등 각 지역에서 제기된 Net-list, Inc.의 특허 침해 소송은 소송가액이 확정되지 않은 상태이며, 당분기말 현재 최종결과를 예측할 수 없습니다.

(2) SanDisk Corporation의 영업비밀 침해 소송

2014년 3월 13일에 SanDisk Corporation은 지배기업 및 종속기업인 SK hynix America Inc.와 SK hynix memory solutions Inc.를 상대로 SanDisk Corporation과 Toshiba Corporation이 공동 소유한 영업비밀을 침해했다는 소송을 미국 캘리포니아 산타클라라 지방법원에 제기하여 소송이 진행 중이었습니다. 한편, 2015년 8월 4일, 지배기업은 SanDisk Corporation이 지배기업 및 종속기업을 상대로 제기한 소송을 모두 취하하는 것으로 SanDisk Corporation과 합의하여 동 소송은 종결되었습니다.

(3) 통상임금 관련 소송

2014년 8월 1일 지배기업의 종업원 일부는 지배기업을 상대로 정기상여금, 고정시간외수당, 교대근무수당 등 각종 수당이 통상임금에 해당하므로 이를 반영하여 연장근로수당 등의 임금을 추가 지급할 것을 요청하는 통상임금 관련 소를 수원지방법원 여주지원에 제기하였습니다. 이와 관련하여 지배기업은 2014년 9월 5일 답변서를 제출하였고, 이후 수 차례에 걸쳐 변론이 진행되었습니다. 한편, 2015년 11월 12일 정기상여금 등의 수당이 통상임금에 포함되지 않는다는 법원의 판결이 있었으며 이후 원고가 항소를 포기하여 동 소송은 종결되었습니다.

(4) 기타의 소송 및 특허 클레임 등

상기 소송 외에, 연결실체는 지식재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며 향후 자원의 유출가능성이 높고 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 계상하고 있습니다. 그러나 당기말 현재 이러한 우발상황의 최종결과를 예측할 수 없으며 이로 인한 영향은 중요할 수 있습니다.

나. 채무보증 현황

당기말 현재 연결실체가 타인에게 제공한 지급보증 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	금 액	비 고
종업원	8	우리사주관련 금융기관 차입금 지급보증

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황

제재조치일		조치기관	조치대상자	조치내용		사유 및 근거 법령		조치에 대한 이행현황	재발방지를 위한대책
연도	날짜			내용	금액(만원)	사유	근거법령		
2015	5/18~29	고용노동부	사업주	벌금	1,000	M10 검찰합동단속 실시	산안법 제23조, 24조 등	안전 및 보건상의 조치에 따른 시설 및 체계 개선 완료	타시설 횡전개 실시
	6/12	고용노동부	사업주	과태료	240	M10 검찰합동단속 실시(공정안전보고서 작성 미이행)	산안법 제49조의2	공정안전보고서 작성 관련 업무 개선	교육 강화
	6/13	고용노동부/안전보건공단	사업주	과태료	18,133	M14 특별감독 실시	산안법 제13조, 14조, 30조, 48조	안전 및 보건상의 조치에 따른 시설 및 체계 개선 완료	타시설 횡전개 실시
	6/15	검노합동점검	사업주	과태료	55,638	M10 검찰합동단속 실시	산안법 제23조, 24조 등	안전 및 보건상의 조치에 따른 시설 및 체계 개선 완료	타시설 횡전개 실시
	6/23	한강유역환경청	사업주	과태료	480	신규지정 유독물 수입세부 실적 미보고	화학물질관리법 제49조	수입실적보고 완료	수입신고 창구일원화(이천), 사업장별 Cross Check 실시
	7/22	한강유역환경청	사업주	과태료	32,280	화학물질 수입확인 증명서 미신고 (x 193건)	화학물질관리법 제9조	국제배송차단. 수입시스템 1차 개선, 구성원교육 및 홍보	시스템2차 개선추진, 구성원교육, 홍보
	7/27	한강유역환경청	사업주	과태료	9,600	유해화학물질 시설공사 및 관리 용역 발주 도급신고 미이행 (x 16건)	화학물질관리법 제31조	도급신고 완료	신규 계약 사전알람시스템을 통한 도급신고 대상여부 사전 파악
2016	3/30	고용노동부	사업주	과태료	320	관리책임자 업무수행(위험성 평가) 총괄관리 미실시	산안법 제13조	안전보건관리책임자 직무(정기 위험성평가 보고/결재) 자료 제출	위험성평가 결재/보고 실시
	7/6	고용노동부	사업주	과태료	16	15년도 관리감독자 4명 교육 미실시	산안법 제31조 제1항	관리감독자 교육 미이수자 대상 교육 이수 완료	교육 미이수자 대상 교육 재실시
	9/19	고용노동부	사업주	과태료	400	PSM 이행상태 점검 (공정안전보고서 내용 미이행 7건)	산안법 제49조의 2 제7항	미이행 7개 항목 개선완료 후 자료 제출	PSM 자체감사 강화
	11/15	고용노동부	사업주	과태료	800	M14 Phase2 공사 발주 시 안전관리비 미계상	산안법 제30조의 제1항	발주서에 안전관리비 포함 및 과태료 납부	발주서에 안전관리비 포함
	3/8	수원지방법원	사업주	벌금	500	산업안전보건법 위반	산안법 제29조	벌금 납부	법령에 따른 안전관리 강화

2017	6/13	중대산업사고 예방센터 (총청권)	사업주	과태료	96	공정안전보고서 내용 (규칙/지침)이행 불일치	산안법 제49조	시정지시 조치결과서 제출 및 과태료 납부	법규/지침 이행여부 관리 강화
------	------	----------------------	-----	-----	----	-----------------------------	----------	---------------------------	------------------

당사는 국제기준에 걸맞은 공정경쟁을 도모하기 위하여 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있으며 임직원 준법 강화를 위해 여러 프로그램들을 운영 중에 있습니다. 또한 당사는 환경안전 관련 법규 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에 대한 교육을 시행하고 있습니다.

4. 녹색경영 현황

가. 배출권거래제 관리업체 지정

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(환경부 고시 제 2014-162호)에 따라 2014년 9월 12일 배출권 할당대상업체로 지정되었으며, 매년 할당된 온실가스 배출량을 달성하기 위해 배출권거래제 TF를 조직하여 이에 체계적으로 대응하고 있습니다.

「저탄소 녹색성장 기본법」 제44조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2016년 온실가스 배출량은 3,092,066톤 CO₂e (tCO₂e)입니다.

5. 합병 등의 사후 정보

가. 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)에 대한 Foundry사업 양도

- (1) 양도영업 : Foundry 사업과 관련된 자산 등의 포괄적 양도
- (2) 양도가액 : 약 185,964 백만 원
- (3) 양도목적/배경 : Foundry 사업의 책임 경영을 통한 수익성 및 사업가치 제고
- (4) 양도일정 :
 - 이사회 의결일 : 2017년 5월 24일
 - 거래종결일 : 2017년 7월 1일 (자산/영업 양도 시점)
- (5) 거래상대방 정보

회사명	에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)
소재지	충청북도 청주시 흥덕구 대신로 215
대표이사	김준호

※ 에스케이하이닉스 시스템아이씨(주)는 '17년 5월 12일 부로 설립되었으며, 에스케이하이닉스 주식회사의 100% 출자 자회사임.

※ 양도사업부문 자산총액 약 1,221억원 / 매출액 약 3,917억원 ('16년 말 기준)
(당사 전체 자산총액 및 매출액의 각 0.4% / 2.3%) ('16년 말 기준)

* 상세한 내용은 2017년 5월 24일에 공시된 특수관계인에 대한 영업양도 및 특수관계인에 대한 출자 공시(공정거래위원회)를 참고하시기 바랍니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음